

2025 年度 永續報告書

精材科技股份有限公司
Xintec Inc.



永續環境
ENVIRONMENT



社會共榮
SOCIAL



公司治理
GOVERNANCE

INNOVATION
FOR A BETTER
SUSTAINABLE FUTURE

關於本報告書

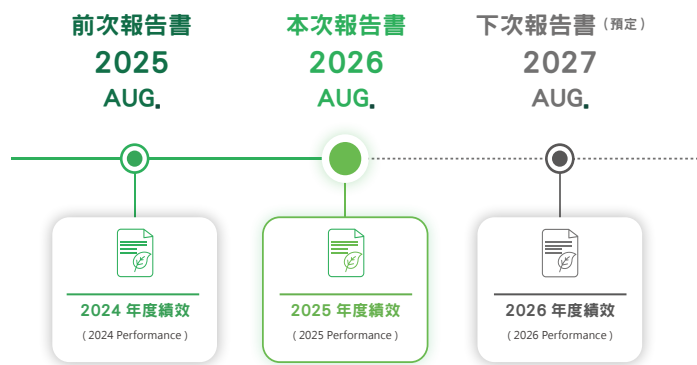
透明、完整且可信賴的永續資訊揭露，是精材公司與所有利害關係人建立長期信任的基礎。本報告書依循 GRI、TCFD、SASB 等國際標準編製，致力於完整呈現公司對環境、社會與治理的承諾與績效。感謝您閱讀精材科技股份有限公司（以下簡稱「本公司」、「精材公司」、「精材」或「我們」）2025 年度永續報告書。自 2015 年首次發布永續報告以來，本報告書今年進入第十年，記錄精材公司在這段旅程中每一年的付出與成長。

每一份報告書對我們而言，不只是數字的整理，更是一次對自身行動的省思。2025 年，全球半導體產業在地緣政治變局、供應鏈重組及氣候法規加速收緊的環境下，面臨前所未有的挑戰。精材公司選擇在這樣的時代背景下，更堅定地將永續思維融入每個業務決策與每一條生產線——因為我們相信，唯有把對環境的責任與對人的關懷視為核心競爭力，企業的成長才能真正經得起時間的考驗。

本年度報告書在延續既有揭露框架的基礎上，新增以下幾項強化：首先，我們深化了 TCFD 氣候相關財務揭露的情境分析敘述；其次我們進一步強化了 Scope 3 溫室氣體排放的前置盤查工作，為未來申請科學基礎減碳目標（SBTi）認證奠定基礎。這些改變，既回應了國際框架的演進方向，也是公司對自身永續實踐持續深化的具體行動。

報告期間與發行週期

本報告書為年度報告，主要揭露精材公司於 2025 年度（2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日）在永續發展各面向的績效與作為。為符合 GRI 永續性報導準則之報導原則，部分關鍵績效資訊亦回溯至 2024 年度及 2023 年度，以呈現趨勢變化。



報告範疇與邊界

本報告書之揭露範圍涵蓋精材科技股份有限公司所有營運據點及合併財務報表所含全部實體。

本公司主要廠區均位於台灣桃園中壢，集中管理有助於確保各廠區的環境、安全及人員管理標準一致。

類 型	地 點
 總 公 司	 桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓
Line A	 桃園市中壢區吉林路 25 號
Line B	 桃園市中壢區自強二路 1 號
	 桃園市中壢區自強一路 8 號
Line C	 桃園市中壢區中國路 188 號

報告資料邊界依據對精材公司營運具有重大影響的永續主題與管理方針進行界定。

針對外部邊界，本公司亦考量外部利害關係人（包括客戶、投資人、供應商、社區居民、政府機關及媒體）可能受到的潛在影響，並在報告中完整呈現。

相較於前一報告期間，本公司組織邊界與法律實體維持一致，無新增廠區或合併實體；第七章所提及之新廠二期（Line C）為現有廠址內之產能擴充，屬既有報告邊界範圍內之設施，不影響組織邊界定義。

依循標準與準則

本報告書之編製依循以下國內外永續相關標準與框架，確保揭露資訊的完整性、可比較性與可信賴性：

發布單位	依循項目
全球永續性報告協會 (GRI)	GRI 準則 (2021 年版) - 本公司依循核心揭露項目 (GRI 2) 及所有重大主題之主題準則
金融穩定委員會 (FSB)	氣候相關財務揭露建議 (TCFD) 一涵蓋治理、策略、風險管理及指標目標四大支柱
永續會計準則理事會 (SASB)	半導體業 (Semiconductors) 適用指標
聯合國	永續發展目標 (SDGs) - 本公司選定 10 項最相關 SDG，並於各章節揭露對應行動與績效
臺灣證券交易所	上市上櫃公司永續發展實務守則
證券櫃檯買賣中心	上櫃公司編製與申報永續報告書作業辦法及其附表
AccountAbility	AA 1000 AccountAbility Principles: 2018-利害關係人包容、重大性、回應性及影響性原則

報告書品質保證與第三方保證

本公司高度重視永續資訊的可信度。為確保報告內容的準確性與完整性，我們建立了內部資料蒐集、查核與審核的多層次流程。各部門資料提供人員進行初稿填報，部門主管進行核實確認，ESG 執行委員會進行整體彙整與一致性審查，最終由 ESG 指導委員會及董事會審核通過。在外部確信方面，本公司委託英國標準協會 (BSI) 依照 AA1000AS V3 (2018) AA 1000AP V3 (2018) 中度保證等級之第 1 應用類型進行第三方保證獨立確信，確認本報告書內容的真實性、平衡性與可比較性。BSI 獨立確信聲明書詳見本報告書附表四。

聯絡我們

精材公司持續與各界利害關係人保持密切溝通，並誠摯感謝所有關注精材公司的夥伴所提供的寶貴回饋與建議。您的指導與鼓勵是我們持續進步的動力。

如果您對於本報告書或精材公司的永續作為有任何建議或指教，歡迎透過以下方式與我們聯繫：

《地址：臺灣 32062 桃園市中壢區吉林路 23 號 9F

《電話：+886-3-4331818

《企業永續信箱：ESG@xintec.com.tw



Contents

關於本報告書	01
董事長致詞	05
2025 年度獲獎與外部肯定	06

1 企業永續營運

1.1 永續發展願景與使命	11
1.2 ESG 指導 / 執行委員會組織架構	12
1.3 利害關係人鑑別與溝通	13
1.4 重大主題鑑別流程	14
1.5 2025 年度重大主題列表	18
1.6 與聯合國永續發展目標 (SDGs) 之連結	20

2 公司治理

2.0 重大主題管理方針	22
2.1 公司簡介	23
2.2 永續經營目標與策略	24
2.3 公司治理方針	25
2.4 功能性委員會	29
2.5 薪酬制度	30
2.6 企業誠信經營	32
2.7 法規遵循	34
2.8 精材公司參與之公協會	34

3 永續發展策略 風險管理與財務績效

3.0 重大主題管理方針	36
3.1 財務績效	40
3.2 稅務管理	41
3.3 市場及產銷概況	41
3.4 風險管理	43
3.5 傾聽客戶聲音，共創卓越未來	45
3.6 資訊安全管理	46

4 安全職場文化

4.0 重大主題管理方針	49
4.1 職業安全衛生管理系統	50
4.2 危害辨識、風險評估及事故調查	51
4.3 職業健康服務	52
4.4 工作者參與、諮商與溝通	53
4.5 職業安全衛生訓練	54
4.6 安全防護措施與化學品管理	56
4.7 緊急應變計畫與演練	57
4.8 承攬商安全衛生管理	57
4.9 職業傷害與職業病統計	58
4.10 2025 年度目標達成與未來展望	58

5 永續供應鏈管理

5.0 重大主題管理方針	60
5.1 供應商類型	61
5.2 供應商評選與績效評鑑管理	61
5.3 責任商業聯盟（RBA）管理	63
5.4 有害物質管理與綠色採購	63
5.5 衝突礦產管理（責任礦產採購）	64
5.6 在地採購優化	65
5.7 供應鏈韌性與風險管理	65
5.8 供應鏈碳管理規劃	66
5.9 目標規劃與未來展望	67

6 創新研發

6.0 重大主題管理方針	69
6.1 研發管理策略與投入	70
6.2 核心技術平台	70
6.3 專利佈局與智慧財產管理	70
6.4 永續導向的研發策略	71
6.5 未來展望與研發承諾	71

7 環境永續發展承諾與實踐

7.0 重大主題管理方針	73
7.1 環境永續願景與環境管理系統	76
7.2 氣候變遷治理與 TCFD	77
7.3 能源管理	82
7.4 溫室氣體排放管理	84
7.5 水資源管理	87
7.6 廢棄物管理	88
7.7 物料管理與有害物質管理	90
7.8 環境永續短中長期目標	91

8 員工關懷與人才發展

8.0 重大主題管理方針	93
8.1 人力資本結構與多元共融	95
8.2 人才招聘、流動與育嬰友善	97
8.3 員工幸福：薪酬、福利與日常關懷	99
8.4 人才培育與學習發展	101
8.5 勞資關係、人權與申訴機制	103
8.6 短中長期目標展望	105

9 社會參與與公益共好

9.1 社會參與理念與政策	107
9.2 2025 年度社會公益績效總覽	108
9.3 各項公益作為詳述	109
9.4 展望：讓善意持續流動	111
附表一：GRI 準則對照索引 / GRI 合規聲明	114
附表二：SASB 半導體業資訊揭露清單	115
附表三：產業別加強揭露永續指標	116
附表四：BSI 獨立確信聲明書	117

董事長致詞



對應聯合國永續發展目標 | 【SDG 8 尊嚴就業與經濟成長】【SDG 13 氣候行動】【SDG 17 永續發展夥伴關係】

回顧 2025 年，全球經濟環境仍面臨高度不確定性，地緣政治風險、通膨壓力與供應鏈重組持續影響企業營運。在此挑戰下，本公司憑藉穩健的經營策略與市場應變能力，全年合併營業收入達新台幣 72.4 億元，較 2024 年成長 2.5%，每股淨利為新台幣 4.99 元，展現全體同仁在艱難環境中堅守崗位、持續精進的成果，也反映了公司多年來在技術差異化與客戶多元化策略上積累的深厚底蘊。持續精進營運績效的同時，我們亦將永續發展納入核心策略，積極推動環境 (E)、社會 (S) 及公司治理 (G) 各面向的具體行動。

在環境面 (E)，我們於 2025 年如期達成年度「123 專案」一節減碳 1%、廢棄物減量 2%、用水降低 3% 的年度環境管理目標。本專案不僅已連續多年達標，更重要的是，今年我們將再生能源購置量提升至約 298.8 萬度，較 2024 年增加 57% 以上，這不僅是數字，更是精材公司向低碳轉型邁出的實質一步。我們已完成中壢三廠 P1 廠區 ISO 50001 能源管理系統驗證，並啟動 Scope 3 溫室氣體的前置盤查，為未來申請科學基礎減碳目標 (SBTi) 認證積累必要的數據基礎。

在社會面 (S)，我們重視人才發展與員工福祉，最好的產品，來自最好的人才；而最好的人才，需要一個被尊重、被看見的職場環境。對公司而言，員工不只是資產，更是創造價值的原動力，我們持續推動勞資溝通機制，強化平權的職場文化建設，員工離職率維持在業界低水準，這是我們對「幸福職場」承諾的最直接回饋。我們也通過了責任商業聯盟 (RBA) 稽核認證，在人權政策的落實上進一步獲得國際標準的認可。

在公司治理面 (G)，精材公司持續強化董事會職能與風險管理機制，提升資訊揭露透明度，並以誠信經營為最高原則，回應利害關係人之信任與期待。

展望未來，隨著全球邁向淨零排放與永續轉型，本公司將持續結合營運成長與永續發展策略，與所有利害關係人攜手合作，在變動的環境中穩步前行，邁向永續共榮的發展願景。

精材科技股份有限公司

董事長暨總經理

陳家湘

2025 年度永續亮點

環境面向 (E)

2025 年，精材公司在環境管理上繼續兌現對永續轉型的承諾。年度再生能源購置量成長超過 57%，達到 298.8 萬度，能源管理系統更獲 ISO 50001 第三方驗證；廢棄物全數委外合規處理，有害廢棄物零非法棄置；溫室氣體盤查查驗工作全面完成，為碳管理邁向新階段做好準備。另外我們也制定「生物多樣性宣言」，並由最高管理階層（董事長）正式簽署於公司官方網站公開，以展現對環境責任的承諾。



環境主題	2025 年主要績效	關鍵管理措施
氣候變遷與能源	再生能源採購量達 2,988,095 度，較 2024 年之 1,900,000 度大幅成長；總用電量 252 百萬度，能源密集度 125.5 GJ/ 百萬元營收。	通過 ISO 50001:2018 能源管理系統年度驗證；推動三廠區 LED 全面更換及空壓機汰舊換新；持續評估再生能源長期採購協議（PPA）可行性。
溫室氣體管理	完成 Scope 1 及 Scope 2 年度盤查查驗（最終數值待查驗報告確認）；啟動 Scope 3 商務差旅、員工通勤及銷售產品下游類別之前置估算。	依循環境部溫室氣體溫室氣體排放量（113 年版）盤查作業指引；委託第三方機構執行查驗；為申請 SBTi 科學基礎減碳目標認證積累基礎數據。
廢棄物管理	有害廢棄物 395.3 公噸（焚化 162.2 公噸、化學處理 40.6 公噸、物理再利用 184.0 公噸、物理掩埋（非直接）8.5 公噸）；一般廢棄物 749.8 公噸；廢棄物有效再利用持續推進。	與合格委外廠商合作，落實廢棄物清除申報及追蹤；推動製程廢液減量及物料循環再利用；持續降低廢棄物最終掩埋比例。
水資源管理	年度總取水量 1,006 百萬公升（地下水 11.4%、自來水 88.6%）；推動廢水再生回收利用，逐步提升水資源循環率。	執行 123 專案水資源目標（年度降低 3%）；持續監測各廠區排水水質，確保符合環保法規；評估廠區中水回用技術導入可行性。

社會面向 (S)

精材公司對「人」的關注，不是口號，而是每一個工作天裡真實發生的事。2025 年，我們繼續在職場安全、人才培育與社區連結上深耕。零職業病的紀錄，是全廠同仁共同守護的成果；36 場實體訓練、36 堂數位課程，是我們對每位員工成長的承諾；超過 130.2 萬元的社區公益投入，是公司走出圍牆、回饋社會的行動腳印。



社會主題	2025 年主要績效	關鍵管理措施
職業安全衛生	失能傷害件數 0 件（廠區）；職業病件數 0 件；危害辨識與風險評估持續執行；承攬商安全管理稽查全年落實。	持續維持 ISO 45001:2018 及台灣職業安全衛生管理系統（TOSHMS）驗證；設置職業醫學專業人員；辦理多層次安全訓練，包含危害化學品、緊急應變與急救訓練。
勞資關係與人權	勞資會議定期召開，員工申訴管道暢通；人權申訴案件 0 件；通過 RBA 責任商業聯盟稽核認證；員工離職率維持業界低水準。	遵循 ILO 勞工標準八大基本公約及聯合國人權指導原則（UNGPs）；強化人權盡職調查（HRDD）流程；確保禁止強迫勞動、童工及性別歧視。
人才發展與留任	舉辦 36 場實體訓練（累積 270.11 小時，868 人次）；建置 36 堂數位專業課程（14.06 小時）；強化主管溝通力與團隊管理能力培訓。	建立系統化教育訓練體系，涵蓋技術職能、管理職能及法規遵循三大面向；推動績效考核雙向溝通；強化薪酬市場競爭力調查，確保薪酬福利具行業競爭力。
社會參與	社區公益活動總金額逾新台幣 130.2 萬元；舉辦愛心義賣、物資捐贈、公益採購；全年累計捐血 248 人次；參與企業河川認養及植樹活動。	鼓勵員工自發性參與公益，與在地社福機構合作，推動弱勢扶助計畫；獲桃園市政府企業河川認養優良獎、綠色採購優良獎表揚。

公司治理與經濟面向（G）

連續七年公司治理評鑑前 5% 的成績，對精材公司來說不是用來展示的獎盃，而是一份必須年年自我要求、自我超越的責任。2025 年，在面對財務壓力的同時，本公司的治理架構維持穩健，資訊安全防護全年零重大事件，供應鏈 ESG 稽核 100% 完成，每一個數字背後，都有全體同仁的付出支撐。



治理主題	2025 年主要績效	關鍵管理措施
財務績效	合併營業收入 NT\$7,238.5 百萬元 (+2.53%)；稅後淨利 NT\$1,353.5 百萬元；ROE 14.36%；ROA 9.79%；純益率 18.7%；研發費用約佔營收 4.5%。	持續推動技術差異化策略；擴大客戶多元化佈局以降低集中風險；精實製造提升成本效益；R&D 投資聚焦先進晶圓級封裝製程技術開發。
公司治理	榮獲 OTC 公司治理評鑑前 5%；董事會定期召開，審議重大 ESG 議題；ESG 指導委員會每季召開，審視年度目標達成進度。	強化董事會職能評估與持續進修；完善利益衝突迴避及保密責任機制；落實股東會決議追蹤與資訊揭露；持續精進內稽內控制度。
資訊安全	通過 ISO 27001 : 2022 資訊安全管理系統驗證（2025 年 9 月）；全年重大資安事件 0 件；每週偵測並阻擋惡意攻擊超過 1,066 次；部署 25 項以上主動防護機制。	建立多層次縱深防禦架構，如防火牆、端點偵測與回應（EDR）、資安資訊與事件管理（SIEM）等；定期辦理資安教育訓練及釣魚郵件演練；個人資料保護管理系統持續精進；業務持續計畫（BCP）定期演練。
供應鏈管理	供應商 ESG 評估完成率 100%；衝突礦產（3TG+Co）查驗全數通過；高風險供應商現場稽核完成；在地採購比例持續維持高水準。	依 RBA 行為準則對供應商進行 ESG 問卷評估；針對高風險供應商執行現場稽查及改善追蹤。

2025 年度 獲獎與外部肯定

2025 年，精材科技在環境管理、職業安全衛生、責任商業實踐及公司治理等面向持續深耕，獲得政府機關、產業協會及國際認證機構之多項肯定與表揚。各項獲獎，是對本公司永續承諾之具體驗證，亦激勵我們在往後的永續旅程中持續精進。另外我們也制定「生物多樣性宣言」，並由最高管理階層（董事長）正式簽署於公司官方網站公開，以展現對環境責任的承諾。



環境
ENVIRONMENT



第七屆
國家企業環保獎
(銅級獎)

頒獎 / 認證單位：環境部

肯定企業在污染防治、資源回收及環境管理之卓越表現。



企業河川
認養優良獎

頒獎 / 認證單位：桃園市政府

表彰精材認養廠區周邊河川，積極維護在地水域生態環境。



綠色採購
卓越獎

頒獎 / 認證單位：桃園市政府

優先採購具環保標章或節能標章產品，推動供應鏈綠色消費。



響應植樹節
獲表揚

頒獎 / 認證單位：桃園市政府

配合政府植樹節活動，積極投入增植樹木與維護城市綠化。



社會
SOCIAL



永續報告書職業健康與安全
績效揭露評比優選企業

頒獎 / 認證單位：勞動部

職業健康與安全資訊揭露完整透明，榮獲優選肯定。



職業安全衛生管理系統
績效審查通過

頒獎 / 認證單位：勞動部

職安衛管理制度 (TOSHMS) 通過主管機關績效審查，持續符合法規要求。



RBA VAP 稽核銀牌證書
(Line A/B/C 三廠區)

頒獎 / 認證單位：責任商業聯盟 (RBA)

2025 年三廠區完成 RBA Validated Audit Process (VAP) 稽核，取得責任商業聯盟銀牌認證。



治理
GOVERNANCE



公司治理評鑑前 5%

頒獎 / 認證單位：金融監督管理委員會 (FSC) / 上櫃公司

治理品質獲主管機關肯定



CHAP. 01

企業永續營運

- 1.1 永續發展願景與使命
- 1.2 ESG 指導 / 執行委員會組織架構
- 1.3 利害關係人鑑別與溝通
- 1.4 重大主題鑑別流程
- 1.5 2025 年度重大主題列表
- 1.6 與聯合國永續發展目標 (SDGs) 之連結

1.1 永續發展願景與使命

精材公司成立迄今，始終將「技術創新」與「企業責任」視為並行不悖的兩條發展主軸。進入永續發展的新時代，本公司以「穩健永續治理經營」、「綠色永續營運管理」及「創造永續幸福職場」為三大核心支柱，形塑公司在 ESG 面向的整體承諾與行動方向。

本公司的永續發展願景，不是由外部壓力催生的，而是發自對下一代的責任感。精材公司的產品用於半導體封裝，影響著每一片晶片的可靠性；而精材公司的永續行動，則影響著每一個與我們有所連結的社區、環境與人。我們深刻認識到：一家真正優秀的企業，其成長的軌跡必須與環境的健康、社會的進步以及治理的完善同步前行。這是公司的選擇，也是公司的核心信仰。

▼ 三大永續核心支柱

01 穩健永續治理

透過健全的董事會職能、ESG 指導委員會定期運作及嚴格的內稽內控制度，確保企業決策的透明度、責任性與長期穩健性，為所有利害關係人的信任奠定根基。

- 誠信經營零容忍政策
- ISO 27001:2022 資訊安全認證
- 完善的風險管理 (ERM+BCP) 架構

02 綠色永續營運

以「減碳、節能、節水、廢棄物減量」為實踐方向，積極投入再生能源採購，導入能源管理系統，逐步建構低碳、高效率的生產營運模式，為應對氣候變遷貢獻具體力量。

- 再生能源採購
- ISO 50001:2018 能源管理系統驗證
- 123 專案：節能 1%、減廢 2%、節水 3%
- GHG 盤查查驗完成

03 幸福永續職場

以人為本，建立尊重人權、安全健康、公平包容的工作環境。提供具市場競爭力的薪酬福利，完善的育才留才機制，讓每一位精材人都能在這裡找到成就感與歸屬感。

- RBA 責任商業聯盟稽核通過
- 職業病件數連續多年為零

▼ 永續經營六大政策

在三大支柱的架構下，精材公司進一步提出六項具體的永續經營政策，作為全公司各部門設定年度目標、執行方案與績效評估的共同依據：

 追求企業永續，關注經濟、環境與社會議題	具體展現方向 每年發布永續報告書，持續揭露 ESG 績效；將永續目標納入年度 KPI 體系
 落實公司治理，強化公司競爭優勢	具體展現方向 健全董事會職能評估；強化內稽制度與合規管理；持續提升治理評鑑排名
 積極研發創新，促進產業升級	具體展現方向 每年投入約 4.5% 以上營收於研發；持續推動先進晶圓封裝製程技術開發與產學合作
 提供友善職場，營造健康工作環境	具體展現方向 推動職安衛管理；辦理員工健康促進計畫；建立開放申訴文化
 強化夥伴合作關係，共同提升價值	具體展現方向 推動供應商 ESG 稽核；與客戶共同推動綠色產品；深化與台積電供應鏈生態圈的永續協作
提升能資源利用率，降低環境衝擊	具體展現方向 持續執行 123 專案；擴大再生能源採購；強化廢棄物再利用；推動節水設備更新

1.2 ESG 指導／執行委員會組織架構

永續治理的關鍵，不在於設立委員會本身，而在於這個委員會是否真的有決策權、有執行力、有問責機制。公司在建立 ESG 治理架構時，特別考慮到如何讓永續議題從「ESG 部門的事」變成「每個主管、每個部門的事」。因此，我們選擇了從董事會層級出發，由董事長親自召集指導委員會，確保永續策略與公司整體經營策略緊密連結；再透過高階經理人統籌的執行委員會，將行動方向貫穿至每個功能部門。

2025 年度 ESG 執行委員會四次定期會議主要審議議題包含：



▲ ESG 執行委員會 2025 年度議題摘要

■ 永續目標管理機制

為確保永續目標不流於形式，內部建立了「目標設定→執行追蹤→績效評核→改進循環」的持續改進管理機制。每年年初，各部門 ESG 窗口，提出部門級年度永續目標；每季由執行委員會追蹤達成率，並針對落後項目啟動改善討論；年底進行整體績效評核，並作為次年目標設定的參考依據。這套機制確保了永續績效的持續改善與透明揭露。



▲ 治理架構說明

1.3 利害關係人鑑別與溝通

在精材公司，「傾聽」不是被動等待投訴，而是主動建立多元的溝通管道，讓不同立場的聲音都能進入公司的決策系統。我們知道，每一個與精材公司有所連結的人，無論是在廠房操作機台的同仁、下訂單的客戶，還是住在工廠附近的社區居民一都有理由對我們的行動有所期待。這份期待，是我們改進的動力，也是我們揭露的義務。

利害關係人鑑別方法

本公司依循 AA 1000 利害關係人參與準則（SES）及 GRI 2-29 利害關係人議合方針，以下列三項準則系統性鑑別主要利害關係人：

〈影響力準則〉

該群體對精材公司業務決策、營運或聲譽的影響程度

〈受影響準則〉

精材公司的業務行動對該群體的利益、健康或安全之潛在影響

〈依賴性準則〉

該群體對精材公司在資源、服務、採購或就業上的依賴程度

利害關係人	主要關注議題	溝通管道	溝通頻率	對應重大主題	2025年度溝通重點與績效
 股東與投資人	財務績效、ESG 評級 公司治理透明度 股東回報穩定性	股東會、法人說明會、年報、永續報告書、重大訊息公告、投資人關係專頁	每年（股東會、報告書） 每半年（法說會） 即時（重大訊息）	08. 永續發展與公司治理 09. 營運績效 11. 風險管理 04. 氣候變遷與能源	2025 年股東常會出席率達 58%； 法人說明會 2 場，機構投資人覆蓋率 95%； ESG 評級維持 MSCI BBB 級； 公司治理評鑑前 5%。
 員工	薪酬福利競爭力 職業安全與健康 職涯發展與學習 勞資溝通管道	職業安全衛生委員會、勞資會議、員工特定主題意見調查、績效面談、主管溝通會議、內部公告平台、員工申訴信箱	每月（職業安全衛生委員會） 不定期（特定主題意見調查） 每年（滿意度調查） 不定期（員工溝通）	01. 職業安全衛生 02. 勞資關係與人權 03. 人才發展與留任	職業安全衛生委員會 12 場（勞工代表比例 38%） 員工溝通 8 場（2,215 人次）、 勞資會議 4 場（75 人次）； 員工意見 27 件、100% 結案； 離職率維持業界低水準； 職業病件數 0 件。
 客戶	產品品質與交期穩定 資訊安全保護 綠色產品與減碳服務 供應鏈合規	定期業務拜訪、客戶 CSR 問卷、RBA 稽核、品質審查、客戶滿意度調查	持續（業務往來） 每年（問卷與稽核）	12. 資訊安全與隱私 07. 永續供應鏈管理 04. 氣候變遷與能源 01. 職業安全衛生	RBA 責任商業聯盟稽核通過； 客戶 CSR 問卷 100% 完成； GHG Scope 3 資訊揭露前置盤查啟動； 客戶滿意度維持高水準。
 供應商/承攬商	採購政策透明度 供應商評估標準 ESG 合規要求 衝突礦產管理	供應商大會、ESG 問卷調查、現場稽核、行為準則宣導、合約條款更新	每年（大會、稽核、問卷調查） 不定期（行為準則宣導）	07. 永續供應鏈管理 10. 誠信經營與反貪腐 05. 環境永續與資源循環	供應商 ESG 問卷調查完成率 100%； 衝突礦產（3TG+Co）查驗全數通過。
 政府機關	環境法規遵循 勞工安全法規 公司治理與誠信 永續資訊揭露	主管機關定期申報、環境許可審查、勞工稽查配合、資訊公開平台揭露	依法規（定期申報） 不定期（主動溝通）	08. 永續發展與公司治理 10. 誠信經營與反貪腐 05. 環境永續與資源循環 06. 水資源與廢棄物	環境許可審查全數通過； 勞工稽查零缺失； 違規件數 0 件； 重大訊息公告及時揭露。
 社區與媒體	廠區環境影響 噪音、空氣品質 企業社會貢獻 透明溝通	社區公益活動、媒體採訪與聲明、企業官網、永續報告書、河川認養等	不定期（活動） 每年（報告書）	05. 環境永續與資源循環 06. 水資源與廢棄物 04. 氣候變遷與能源	河川認養活動持續維持； 廠區噪音及空氣品質監測全部達標； 廠界臭味管制達標； 媒體重大負面報導 0 件。

▲ 主要利害關係人類別及溝通機制

1.4 重大主題鑑別流程

確認「什麼是真正重要的」，是精材公司每年啟動 ESG 報告書準備工作時最優先處理的課題。本公司嚴格遵循 GRI 2021 準則中的「雙重重大性」(Double Materiality) 原則，從兩個相互補充的維度系統性鑑別重大主題（此雙重重大性概念亦與歐盟永續報告準則 ESRS 精神一致）：

- **衝擊重大性 (Impact Materiality)：**
由內而外，評估本公司營運活動對環境、社會及人權產生的現有與潛在正負面影響
- **財務重大性 (Financial Materiality)：**
由外而內，評估外部環境、社會及治理議題對本公司財務績效、風險暴露及商業模式的影響。



▲（一）四步驟重大主題鑑別流程

雙重重大性分析表

下表呈現 2025 年度 13 項重大主題的雙重重大性評估結果。「衝擊重大性」反映本公司活動對環境、社會及人權的影響程度；「財務重大性」反映該議題對本公司財務績效與業務模式的影響程度。評分採 1~5 分制（5 分＝極高重大性）。

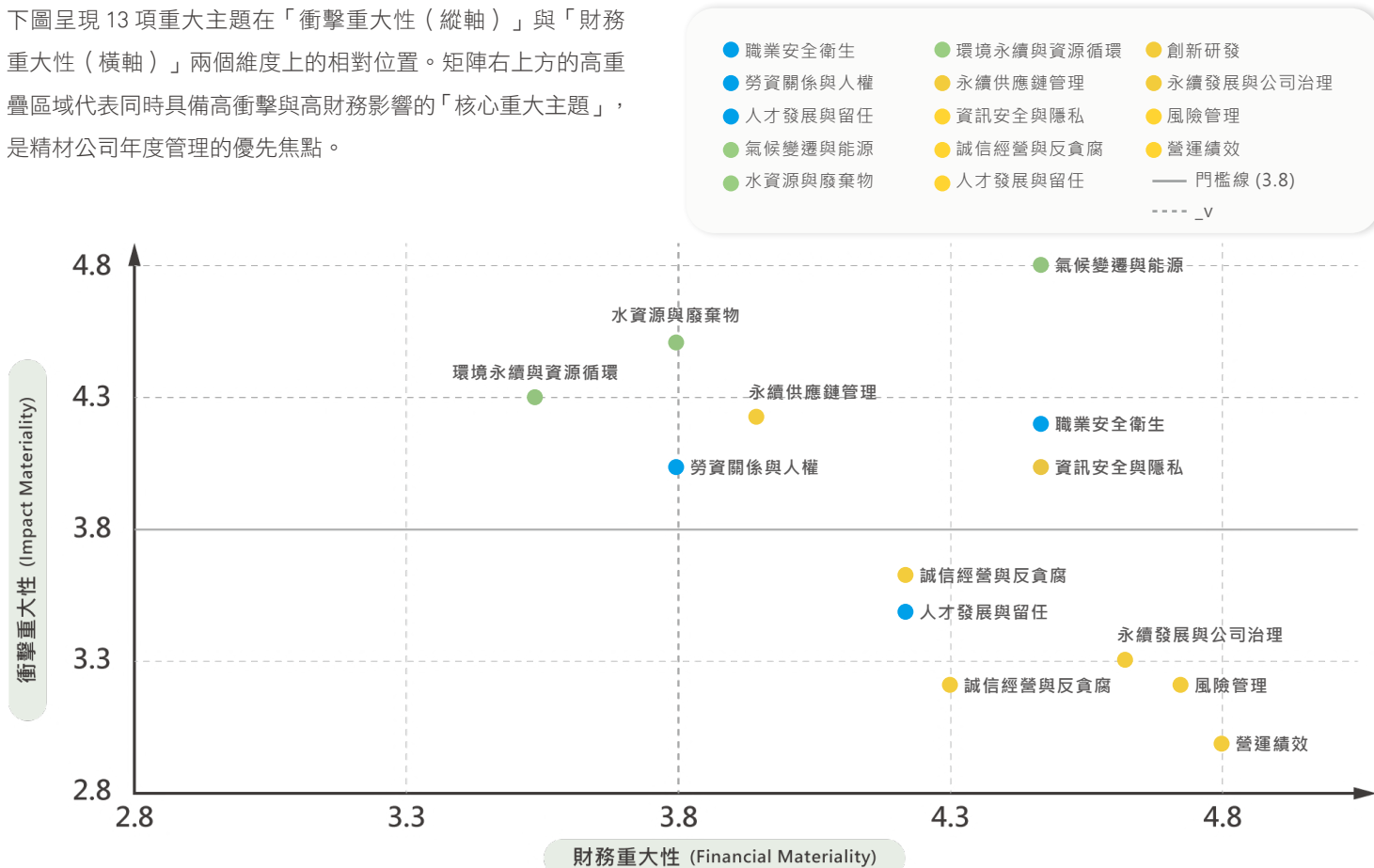
類別	#	重大主題	衝擊重大性評分 (1-5)	衝擊重大性說明 (由內而外：本公司對環境 / 社會的影響)	財務重大性評分 (1-5)	財務重大性說明 (由外而內：議題對本公司財務的影響)	重要性等級
社會	01	職業安全衛生	4.2	半導體製程使用大量有害化學品，職安衛管理不當可能導致員工健康傷害或職業病。精材大量資源保障員工安全，對社會具正面示範效果。	4.5	工傷事故引發停工、賠償與監管處罰，直接衝擊財務；ISO 45001 及 RBA 為重要客戶評核指標，影響訂單取得。	★★★★☆
社會	02	勞資關係與人權	4.0	員工超過千人，其就業條件、工作權利及申訴管道對社會公平與人權保障有直接影響。	3.8	勞資糾紛或人權違規可能引發 RBA 稽核不合格、品牌負面報導及潛在勞動法規罰則，影響聲譽與客戶關係。	★★★★☆
社會	03	人才發展與留任	4.0	完善的人才培育機制提升員工職涯發展機會，改善就業品質與技術人才供給。	4.2	高技術人才流失直接影響先進封裝製程品質與研發能力，導致產能瓶頸及競爭力下滑，衝擊中長期營收。	★★★★☆
環境	04	氣候變遷與能源	4.8	半導體封裝製程耗能龐大，GHG 排放對全球氣候具實質影響；積極推動再生能源採購與節能，對降低產業鏈碳排有示範效果。	4.5	能源成本占製程費用比例高；碳定價機制、CBAM 法規及客戶要求碳足跡查證將顯著影響成本結構；氣候實體風險亦可能中斷生產。	★★★★★
環境	05	環境永續與資源循環	4.3	製程材料（矽晶圓、化學品、封裝材料）的使用量龐大，循環經濟實踐程度直接決定對自然資源耗竭的影響。	3.6	原物料採購成本為主要生產費用項目；循環材料使用有助降低成本波動風險；綠色採購要求亦可能成為市場准入門檻。	★★★★☆
環境	06	水資源與廢棄物	4.5	晶圓製程用水量龐大，廢水與有害廢棄物若管理不當將直接汙染在地水源與土壤，對桃園中壢地區社區環境造成影響。	3.8	廢水排放超標可能導致環保主管機關停工處分；有害廢棄物清除費用持續增加；水資源限制亦可能影響未來廠區擴產計畫。	★★★★☆

類別	#	重大主題	衝擊重大性評分 (1-5)	衝擊重大性說明 (由內而外：本公司對環境 / 社會的影響)	財務重大性評分 (1-5)	財務重大性說明 (由外而內：議題對本公司財務的影響)	重要性等級
治 理	07	永續供應鏈管理	4.2	供應鏈中的勞工人權、環境違規及衝突礦產問題透過精材的採購行為向上游延伸，精材負有供應鏈盡職調查的社會責任。	4.0	供應鏈 ESG 不合規（含衝突礦產）可能導致客戶終止合約；供應鏈中斷風險直接影響交期與客戶滿意度；RBA 要求亦持續強化。	★★★★☆
治 理	08	永續發展與公司治理	3.3	健全的董事會職能與功能性委員會運作，確保企業決策兼顧環境與社會利益，提升對各利害關係人的責任與透明度。	4.6	公司治理品質直接影響投資人信心、資本市場 ESG 評分及授信條件；多次獲得公司治理評鑑前 5% 紀錄是重要品牌資產。	★★★★★
治 理	09	營運績效	3.0	穩健的財務績效支撐公司持續在員工薪酬、社區投資及環保設備上的投入，對利害關係人的直接經濟價值分配具影響。	4.8	年度營收、獲利能力及 EPS 直接決定公司繼續經營能力、股東回報水準及再投資能量；是所有 ESG 策略的財務基礎。	★★★★★
治 理	10	誠信經營與反貪腐	3.5	反貪腐行為準則的落實，有助維護公平市場競爭秩序，並保障外部合作夥伴與社會公眾免受不當商業行為侵害。	4.2	貪腐或違規事件可能引發法律訴訟、主管機關罰款及媒體負面報導，嚴重者影響上市資格；內稽內控健全性關聯法規遵循風險。	★★★★☆
治 理	11	風險管理	3.2	完善的 ERM+BCP 風險管理框架，有助在地緣政治、天災或供應鏈中斷情境下保障員工就業與社區穩定。	4.7	有效 ERM 與 BCP 直接降低重大事件對營運的衝擊；新興風險（如地緣政治）若管理不當可能造成供應鏈或業務中斷損失。	★★★★★
治 理	12	資訊安全與隱私	4.0	個資保護是員工與客戶的基本權利；資安防護不足可能導致敏感商業技術外洩，影響整體產業生態及客戶信任。	4.5	資安事件可能導致生產中斷、客戶機密外洩索賠及監管罰款，並嚴重損害聲譽；ISO 27001 認證為客戶重要評核指標。	★★★★★
治 理	13	創新研發	3.2	先進封裝技術的研發突破有助提升台灣半導體產業競爭力。	4.3	研發創新是維持技術差異化、贏得先進客戶訂單的核心驅動力；技術落後可能導致市場份額快速流失。	★★★★☆

※ 重要性等級評定：衝擊與財務評分平均 ≥4.3 = ★★★★★；4.0~4.2 = ★★★★；≥3.5 = ★★★；< 3.5 = ★★

雙重重大性矩陣圖

下圖呈現 13 項重大主題在「衝擊重大性（縱軸）」與「財務重大性（橫軸）」兩個維度上的相對位置。矩陣右上方的高衝擊區域代表同時具備高衝擊與高財務影響的「核心重大主題」，是精材公司年度管理的優先焦點。



精材公司 2025 年度雙重重大性矩陣（評分來源：內部影響評估＋利害關係人問卷綜合計算）
藍色● = 社會 (S)，綠色● = 環境 (E)，金色● = 治理 (G)

依據矩陣位置，各象限主題的建議管理方向如下：

右上象限	評分條件 衝擊 ≥ 3.8 且 財務 ≥ 3.8 涵蓋主題 01. 職業安全衛生 04. 氣候變遷與能源 08. 永續發展與公司治理 09. 營運績效 11. 風險管理 12. 資訊安全與隱私 精材公司管理策略 設立量化年度目標、納入董事會議程、安排專門部門與預算、每季追蹤績效進度。
左上象限	評分條件 衝擊 ≥ 3.8 且 財務 < 3.8 涵蓋主題 05. 環境永續與資源循環 精材公司管理策略 強化社會責任管理目標，關注法規合規風險，逐步提升財務重大性的關注程度。
右下象限	評分條件 衝擊 < 3.8 且 財務 ≥ 3.8 涵蓋主題 02. 勞資關係與人權 03. 人才發展與留任 06. 水資源與廢棄物 07. 永續供應鏈管理 10. 誠信經營與反貪腐 13. 創新研發 精材公司管理策略 以風險管理與競爭力維持為主軸，同時評估對社會的附加正面效益，持續強化揭露深度。

1.5 2025 年度重大主題列表

2025 年度重大主題鑑別結果共確認 13 項重大主題，分屬社會（3 項）、環境（3 項）及治理（7 項）三大類別。

相較於 2024 年度，本年度強化了「風險管理」主題中對新興風險的界定。

類別	#	重大主題	議題範疇定義	衝擊性質 正 / 負	衝擊類型 實際 / 潛在	對應價值鏈關係	對組織衝擊程度	對應 GRI 準則
社會 與 人權	01	職業安全衛生	職場災害預防與管理、員工健康檢查與促進計畫、承攬商安全衛生管理、ISO 45001 及 TOSHMS 推動	正面 + 負面	實際 + 潛在	本公司（員工與承攬商）	■■■■■	GRI 403
	02	勞資關係與人權	勞資會議機制、員工申訴管道、結社自由保障、人權盡職調查（HRDD）、禁止強迫勞動及童工	正面 + 負面	實際 + 潛在	本公司（員工） 上游（供應商勞工）	■■■■■	GRI 401 GRI 402 GRI 407~409
	03	人才發展與留任	系統化教育訓練體系、績效考核機制、晉升管道透明化、薪酬福利競爭力管理、員工流動率管理	正面	實際 + 潛在	本公司（員工）	■■■■■	GRI 404 GRI 405
環 境	04	氣候變遷與能源	溫室氣體盤查（範疇 1、2、3）、節能減碳專案、能源管理系統（ISO 50001）、TCFD 氣候風險評估與情境分析	正面 + 負面	實際 + 潛在	上游（能源 / 材料供應） 本公司（製程） 下游（客戶 Scope 3）	■■■■■	GRI 302 GRI 305 TCFD
	05	環境永續 與資源循環	原物料使用減量、包材輕量化、環境友善材料導入、綠色製程推動、循環經濟概念落實	正面 + 負面	實際 + 潛在	上游（原物料採購） 本公司（製程廢棄物）	■■■■■	GRI 301
	06	水資源與廢棄物	水資源使用監控與回收率提升、廢水排放水質達標管理、廢棄物產生量減量、有害廢棄物合規清除及追蹤	正面 + 負面	實際 + 潛在	本公司（廠區用水） 下游（廢水 / 廢棄物）	■■■■■	GRI 303 GRI 306

衝擊程度：■■■■■ 極高 ■■■■■ 高

類別	#	重大主題	議題範疇定義	衝擊性質 正 / 負	衝擊類型 實際 / 潛在	對應價值鏈關係	對組織衝擊程度	對應 GRI 準則
治 理	07	永續供應鏈管理	供應商 ESG 問卷評估、直接材供應商現場稽核、在地採購優先、衝突礦產 (3TG+Co) 全程追蹤、供應商行為準則宣導	正面 + 負面	實際 + 潛在	上游 (供應商全鏈) 本公司 (採購決策)	■■■■■	GRI 204 GRI 308 GRI 414
	08	永續發展與公司治理	董事會職能評估、ESG 委員會定期運作、股東權益保障與溝通、法規遵循管理、內稽內控制度	正面	實際	本公司 (治理層級) 下游 (投資人 / 股東)	■■■■■	GRI 2-9~2-21 GRI 206 自訂重大主題
	09	營運績效	年度營收與獲利能力、稅務治理與透明度、政府補助揭露、分配給各類利害關係人之直接經濟價值	正面 + 負面	實際	本公司 (財務績效) 下游 (利害關係人分配)	■■■■■	GRI 201 GRI 207
	10	誠信經營與反貪腐	從業道德規範宣導、反貪腐及反賄賂教育訓練、匿名檢舉制度保護、內稽自控程序落實	正面 + 負面	實際 + 潛在	本公司 (員工與管理層) 上游 (供應商合規)	■■■■■	GRI 205 GRI 206 自訂重大主題
	11	風險管理	企業風險管理 (ERM) 框架完整執行、業務持續計畫 (BCP) 定期演練、新興風險辨識 (含地緣政治、AI 治理)	正面 + 負面	實際 + 潛在	本公司 (全廠區與營運) 上游 (供應鏈中斷) 下游 (交期 / 品質影響)	■■■■■	GRI 2-22 TCFD 風險管理
	12	資訊安全與隱私	機密資訊保護、資訊安全防護體系建立與監測、個人資料保護、ISO 27001 認證維持	正面 + 負面	實際 + 潛在	本公司 (IT 系統與資料) 下游 (客戶機密保護)	■■■■■	GRI 418
	13	創新研發	研發經費投入占比、專利申請與布局、先進晶圓級封裝製程技術開發、產學合作計畫推動	正面	潛在	本公司 (研發部門) 下游 (客戶產品競爭力)	■■■■■	GRI 201-1 自訂重大主題

衝擊程度：■■■■■ 極高 ■■■■■ 高

1.6 與聯合國永續發展目標（SDGs）之連結

2015 年，聯合國通過《2030 年永續發展議程》，提出 17 項永續發展目標（SDGs），呼籲全球各界，包括企業，共同承擔對人類未來的責任。

對精材而言，SDGs 不是一份對外宣示的清單，而是一個讓我們更清楚看見「自己的行動如何影響更大世界」的座標系統。

我們依據公司的產業特性、核心業務影響範疇及 2025 年度 13 項重大主題，選定 10 項最具實質關聯的 SDGs。為確保 SDG 對應的嚴謹性，本公司進一步對應至各 SDG 之具體細項目標（Targets），真正揭露精材公司在各目標下的實質貢獻。

相關績效數據分散呈現於各業務章節，本節提供整體性對應概覽。

精材公司在半導體供應鏈中的永續定位



精材公司作為晶圓級封裝（WLCSP）的專業服務提供商，長期深度參與全球半導體業供應鏈體系，服務對象涵蓋全球。



在此供應鏈位置下，精材不僅是技術的提供者，更是永續價值的傳遞者。客戶對綠色產品、碳排揭露及供應鏈合規的要求，直接驅動精材在環境管理、資訊安全及人權保障等面向持續精進。



精材公司的永續表現，既是對客戶要求的回應，也是對整條半導體供應鏈永續升級的貢獻。

SDG 03

良好健康與福祉

重大主題：職業安全衛生

職業病 0 件，總和傷害指數為 0（不含交通事故），失能傷害持續改善。（詳見第四章）

SDG 07

可負擔的永續能源

重大主題：氣候變遷與能源

再生能源採購達 298.8 萬度（年增 57%）。（詳見第七章）

SDG 13

氣候行動

重大主題：職業安全衛生

完成範疇一、二溫室氣體盤查查驗，導入 TCFD。（詳見第七章）

SDG 04

優質教育

重大主題：人才發展與留任

辦理 36 場實體訓練與 36 堂數位課程。（詳見第八章）

SDG 08

就業與經濟增長

重大主題：人才發展與留任、營運績效

營收達 72.4 億元，獲 RBA 認證。（詳見第三、八章）

SDG 16

制度的正義與和平

重大主題：人才發展與留任

公司治理評鑑前 5%，重大資安 0 件。（詳見第二章）

SDG 05

性別平等

重大主題：勞資關係與人權

確保同工同酬與以個人績效考量的晉升平權原則。（詳見第八章）

SDG 09

永續工業與基礎建設

重大主題：創新研發、營運績效

研發投入佔營收 4.5%，深耕先進封裝。（詳見第六章）

SDG 17

永續發展夥伴關係

重大主題：人才發展與留任

持續執行供應商 ESG 評估，推動協作。（詳見第五章）

SDG 06

淨水與衛生

重大主題：水資源與廢棄物

SDG 12

責任消費與生產

重大主題：環境永續與資源循環、水資源與廢棄物、營運績效

廢棄物 100% 合規處理，再利用率達 62%。（詳見第七章）



CHAP. 02

公司治理

- 2.0 重大主題管理方針
- 2.1 公司簡介
- 2.2 永續經營目標與策略
- 2.3 公司治理方針
- 2.4 功能性委員會
- 2.5 薪酬制度
- 2.6 企業誠信經營
- 2.7 法規遵循
- 2.8 精材公司參與之公協會

對應聯合國永續發展目標 |

【SDG 8 就業與經濟成長】【SDG 12 責任消費與生產】【SDG 16 制度的正義與和平】

精材公司透過獨立且多元的董事會組成、健全的委員會監督機制、透明的薪酬制度，以及嚴格的誠信合規文化，保障股東權益並維護所有利害關係人的長期信任。

2.0 重大主題管理方針

誠信經營與反貪腐 管理方針 (GRI 205)



議題範疇及邊界

本公司之誠信合規管理涵蓋董事、高階經理人及全體員工，並延伸至商業夥伴，範疇包括反貪腐、反賄賂、利益衝突管理、法規遵循及人權保障。



潛在機會

誠信治理文化有助於強化客戶信任、吸引優質供應商合作；健全的合規體系可降低監管風險，並提升公司在 ESG 評鑑中的表現。



潛在風險

貪腐或違規行為可能損害公司聲譽、降低投資人信心，並引發法律訴訟；利益衝突未妥善管理可能影響決策公正性；供應鏈或合作夥伴的誠信問題可能衍生連帶責任。



管理政策依據

本公司依《公司法》、《上市上櫃公司治理實務守則》及《誠信經營守則》制定相關內控制度，包含《誠信經營守則》、《董事及經理人道德行為準則》、《機密資訊保護政策》、《個人資料保護管理程序》，並參照 GRI 205 反貪腐標準、聯合國反腐敗公約 (UNCAC) 及 RBA 責任商業聯盟行為準則，制定完整的誠信合規框架。



2025 年度目標



誠信申訴案例
0 件



全員從業道德訓練
完成率 100%



利益衝突申報率
100%



持續通過 RBA
責任商業聯盟稽核



評估機制與成果

✓ 誠信申訴案例 0 件

✓ 利益衝突申報率 100%

✓ 新進人員從業道德訓練
完成率 100%

✓ 無重大法規裁罰事件

✓ 無貪腐事件

✓ 持續符合 RBA 準則



短期目標 (1 年)



持續執行年度
誠信教育訓練



強化舉報機制
宣導



完成每季法規鑑別
與追蹤



中長期目標



持續提升公司治理
評鑑排名



深化人權盡職
調查機制



擴大誠信合規文化
至全供應鏈



對應 SDGs



SDG 8
就業與經濟成長



SDG 12
責任消費與生產



SDG 16
制度的正義與和平

績效亮點

獨立董事比例

66.7%

2025年董事會議次數

6 次

董事平均受訓時數

8+ 小時

利益衝突申報率

100%

誠信違規事件

0 件

2.1 公司簡介

	公司名稱 精材科技股份有限公司 (Xintec Inc.)		主要客戶產業 消費電子、通訊、汽車、醫療、工業
	公司性質 半導體業 - IC 封裝測試		營運據點 臺灣桃園市中壢區吉林路 23 號 9 樓 (Line-A : 11,000M ² ; Line-B : 6,500M ² ; Line-C : 57,007M ²)
	董事長暨總經理 陳家湘		成立時間 1998 年 9 月 11 日
	主要產品 晶圓級尺寸封裝 (WLCSP) 晶圓級後護層封裝 (WLPPI) 晶圓級測試 (Wafer Level Chip Probing Test) 最終測試 (FT, Final Testing) 應用領域涵蓋影像感測器、光學感應器、 MEMS 揚聲器、新型生物辨識器等		實收資本額 新台幣 27.14 億元
			員工人數 1,540 人 (統計至 2025.12.31)

精材科技股份有限公司 (Xintec Inc.) 成立於 1998 年，是全球第一家將晶圓層級封裝技術 (WLCSP) 商品化的公司。公司以「誠信、研發、創新、顧客導向」為核心價值，自認為先進封裝服務方案的專業供應商，在晶圓級封裝 (WLCSP) 及光學相關技術的供應鏈中扮演樞紐角色。精材公司從 CMOS 影像感測元件 (CIS) 封裝起家，目前已拓展至各式感測元件、微機電封裝及客製化晶圓級架構服務，應用涵蓋消費電子、通訊、電腦、工業及汽車等領域。

在製程整合與技術開發方面，公司每年投入高比率研發資源，持续提升光阻塗佈、曝光顯影、蝕刻、晶圓接合、物理與化學氣相沉積、金屬導線製程 (鋁與銅)、深孔電鍍 (Cu-TSV)、特殊材料薄化與高精度切割等關鍵技術，佈局橫跨前段至後段的完整封裝服務鏈。亦積極開拓 12 吋晶圓封裝平台，發展細線寬導線、多層金屬佈局、異質整合封裝與氮化鎵 (GaN) 晶片封裝等先進技術，以支援車用感測器、醫療設備、AR/VR 模組等新興應用的量產需求。



2.2 永續經營目標與策略

2025 年營運成果回顧

2025 年，精材公司在全球半導體市場持續分化的環境下，憑藉穩健的技術積累與客戶深耕策略，全年合併營收達新台幣 72.4 億元，稅後淨利為 13.5 億元，每股盈餘為 4.99 元。主要成長動能來自影像感測器封裝服務及測試服務，3D 感測零組件加工服務亦持續擴展。

市場環境分析

2025 年，AI 應用加速落地、車用電子與醫療感測元件需求持續增長，為公司的封裝服務創造有利條件。然而，非 AI 相關消費電子需求仍具不確定性，加上匯率波動與材料成本上升帶來挑戰。面對此環境，公司持續聚焦差異化技術、多元化產品組合，以維持穩健競爭力。

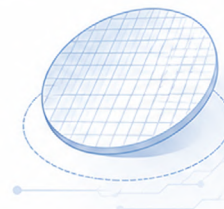
策略性發展方向

公司將優先投入以下幾項策略性方向：

編號	策略方向說明	
01	先進封裝服務深化	強化晶圓級 CSP 差異化優勢，因應車用影像感測 (CIS) 量產需求，提供穩定且高品質的封裝解決方案。
02	客製化解決方案推進	協助客戶新產品導入，開發針對醫療、AR/VR 等應用領域的光學感測器封裝與加工工程。
03	中長期研發佈局	中長期研發佈局：加速感測器相關之 SiP (System in Package) 封裝技術平台建構，擴大關鍵設備資本支出，提前布設未來成長動能。
04	永續價值強化	永續價值強化：結合 ESG 治理與環境目標，於技術創新之餘同步推動綠色製程與低碳營運，以企業永續為核心驅動力。

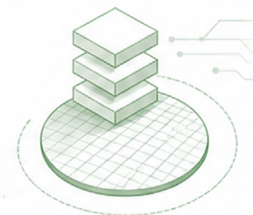
短期目標 (1-2 年)

- 建立以客戶導向之專業封裝服務，強化顧客滿意度，以更快、更好的技術與服務滿足客戶需求。
- 在晶圓級製程平台上提供更多樣的封裝技術，以因應多元化產品需求。



中期規劃 (3-5 年)

- 深耕產業合作，強調與上下游廠商的長期合作，在產業專業分工的趨勢中，本公司將成為客戶信賴的封裝加工廠。
- 技術創新驅動，致力於先進 3D 晶圓層級堆疊、新生物辨識產品、矽晶圓載板等新製程研究發展，產品類別從消費、汽車、電腦等擴展至監控、醫療等領域。



長期規劃

- 健全公司經營體質，以職能為培育核心，提升管理及經營績效。
- 加強上中下游產業鏈合作，與晶圓代工業者及測試大廠共同策略聯盟，期望成為先進晶圓級封裝技術服務領導廠商。



2.3 公司治理方針

精材公司秉持「誠信、創新、顧客導向」的經營理念與價值觀，致力於成為晶圓級晶片封裝領域的領導企業，以誠信為本，追求卓越營運，並承擔對所有利害關係人的責任。透過健全的公司治理機制，確保資訊透明、落實永續發展目標，並維護股東權益。

■ 公司治理原則

保障股東權益、公允對待股東與重要所有權功能；強化董事會職能；發揮審計委員會功能；尊重利害關係人權益；提昇資訊透明度。

■ 公司最高治理單位

公司最高治理單位由董事長暨總經理擔任，集中領導權責，確保決策與執行一致。精材公司已依《財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點》第四條規定，設置獨立董事不得少於 4 人；本公司現有獨立董事 4 席。董事長陳家湘先生同時擔任總經理職務，係基於公司規模、產業特性及營運效率之考量，採集中式領導架構，以利策略方向與日常執行之快速整合，加速決策回應市場變化之速度。考量此一兼任安排可能對董事會獨立監督職能形成潛在影響，公司已設計並落實多項制衡機制，以確保治理獨立性與利益衝突防範。

■ 董事會組成與職責

精材公司的董事會共 6 席董事，成員皆具備豐富實務經驗與專業背景，並依據公司章程及相關法規選任，於就任時均已簽署「無違反誠信原則聲明書」，負責公司治理與重大經營決策，維護股東權益與提升企業績效。2025 年度共召開 6 次董事會，出席率（含委託）達 100%。本公司於報導期間內，透過董事會定期會議，由總經理向董事會報告各項關鍵重大事件，並由董事會提供專業建議與監督決策。本年度共計向董事會報告 4 件關鍵重大事件，分別涵蓋永續發展、風險管理、智慧財產權管理，以及誠信經營管理。

董事會主要職責包括：審議經營策略與發展方向；任命及監督高階管理團隊；審查財務報表與風險管理機制；評估企業永續（ESG）發展之落實，制定執行策略與成效；確保資訊公開與利害關係人溝通；持續營運風險管理，核定本公司的風險管理政策和相關措施，並監督各種風險管理制度的執行和確保其有效運作。

■ 資訊公開與透明治理

精材公司重視資訊揭露與利害關係人溝通，所有董事會重大決議、治理架構、會議運作情形與相關政策，均依規定即時公告於「臺灣證券交易所公開資訊觀測站」及公司官網，確保國內外投資人能迅速掌握公司治理最新動態，強化外部信任與企業形象。



第十四屆董事任期為 2025 年 5 月 29 日至 2028 年 5 月 28 日，董事會成員資訊如下：

董事長（法人）

陳家湘

男 | 61~70 歲



主要學經歷

台積公司上海松江廠總經理、台積公司三廠廠長、新加坡 SSMC 合資廠營運副總、台積公司產品工程處處長、台積公司七廠廠長、交通大學光電工程研究所碩士、交通大學電子物理系學士



擔任職務

本公司總經理、ESG 指導委員會召集人

董事（法人）

游秋山

男 | 61~70 歲



主要學經歷

台積公司歐亞業務副總經理、台積公司歐亞業務策略客戶專案辦公室資深處長、台積公司電子束作業處資深處長、台積公司 SRAM/DRAM/ 嵌入式 DRAM 開發處處長、美國伍斯理理工學院化學工程博士



擔任職務

台積公司特殊技術組織副總經理

獨立董事

王文宇

男 | 71~80 歲



主要學經歷

創意電子公司獨立董事、凱基證券獨立董事、統一超商公司獨立董事、臺灣大學法律學院教授、開南大學法律學院客座教授兼院長、行政院公平交易委員會委員、美國史丹福大學法學博士



擔任職務

本公司薪資報酬委員會委員、尼得科超眾科技獨立董事、臺灣大學法律學院兼任教授、國際比較法學會 (IACL) 台灣分會召集人

獨立董事

謝徽榮

男 | 71~80 歲



主要學經歷

茂達電子股份有限公司獨立董事、寶勝國際 (控股) 有限公司獨立非執行董事、世界先進積體電路股份有限公司財務副總經理、美商美國銀行台北分行副總經理、臺灣大學商研所碩士、清華大學核子工程系學士



擔任職務

本公司審計委員會召集人及薪資報酬委員會委員

獨立董事

梁明成

男 | 61~70 歲



主要學經歷

昇陽國際半導體獨立董事、台灣光罩集團美祿科技董事、建鵬創達科技獨立董事、美光科技副總裁、台灣大學國際企業學系研究所 EMBA 碩士、成功大學物理系學士



擔任職務

本公司 ESG 指導委員會委員、薪資報酬委員會召集人及昇陽國際半導體董事長

獨立董事

李雨師

女 | 41~50 歲



主要學經歷

中原大學領導力發展中心暨 EMBA 副執行長、中原大學公共事務中心主任、中原大學企業管理學系助理教授、政治大學企業管理博士



擔任職務

本公司 ESG 指導委員會委員、中原大學學生事務處副學務長及中原大學企業管理學系副教授

董事會組成與獨立性、多元化政策

本屆董事會共計 6 席成員，其中包含 4 席獨立董事，占比達 66.7%，高於法定標準，展現公司對治理透明與監督獨立性的高度重視。董事會中設有 1 位女性董事，占比 17%，未來將持續推動董事會性別多元化，以不同性別董事達三分之一為長期目標。全體董事間無配偶或二等親內親屬關係，董事長陳家湘先生為唯一兼任總經理之董事，符合法規規定，董事會整體具備高度獨立性與制度合規性。

2025 年度，董事會共召開 6 次會議，出席率（含委託）達 100%。公司積極推動董事會成員多元化，依據營運型態與未來發展需求，從基本條件與價值觀（性別、年齡、國籍、文化背景等多元包容）及績效指標（涵蓋法律、財務、會計、行銷、產業科技研發、永續管理與經營管理等領域）兩大面向規劃成員組成。

陳家湘 6 ~ 9 年 經營管理 產業知識 領導決策	游秋山 1 ~ 3 年 經營管理 產業知識 領導決策 技術研發	王文宇 12 年以上 法律專業 經營管理 領導決策
謝徽榮 12 年以上 財務會計 經營管理 領導決策	梁明成 1 ~ 3 年 經營管理 領導決策 產業知識	李雨師 1 年以下 經營管理 領導決策 永續管理

持續專業進修，提升公司治理能力

為強化董事專業素養，並提升對公司治理、風險控管與永續發展議題的掌握，董事會持續依循《上市上櫃公司董事監察人進修推行要點》，定期安排董事參與外部專業課程，協助其掌握最新治理趨勢與實務案例，強化決策能力與監督效能。2025 年，公司董事平均受訓時數均達 8 小時以上，符合法令要求，課程主題聚焦於營業秘密與內線交易預防、性別平等議題與當前全球經濟與金融情勢。透過進修，董事得以強化公司治理及全球經濟與金融動態等面向的理解，進一步提升董事會在風險治理與企業資源管理策略上的綜合判斷力。

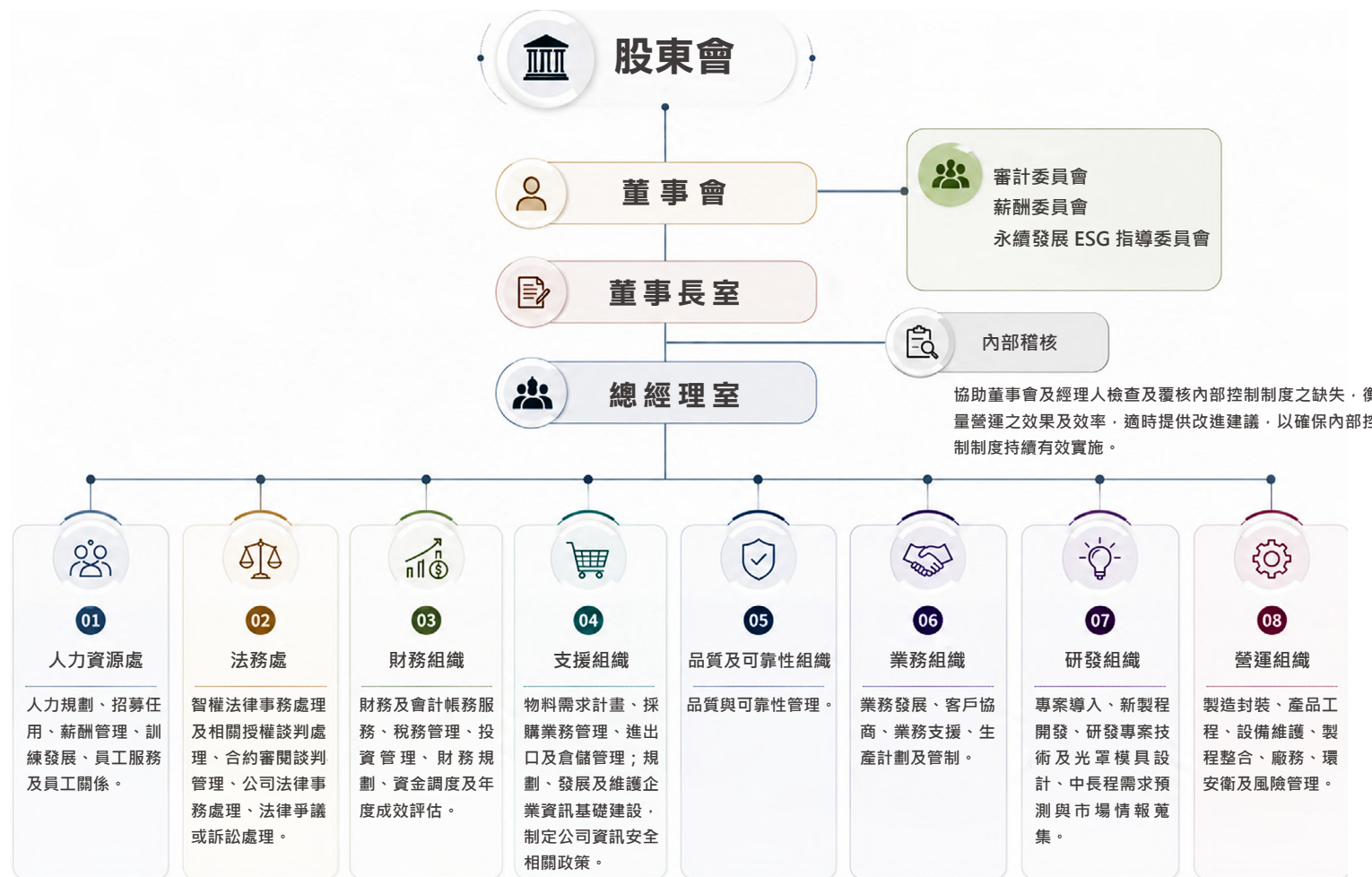
2025/07/29 2025/08/08	上櫃與櫃公司內部人股權宣導說明會 證券櫃檯買賣中心 游秋山董事 (7/29)、李雨師獨立董事 (8/8)，共 2 人。	3 HR
2025/08/07	營業秘密與內線交易預防（含性平） 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 陳家湘、游秋山、謝徽榮、李雨師、梁明成，共 5 人。	3 HR
2025/11/07	當前全球經濟與金融情勢 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 陳家湘、游秋山、王文宇、謝徽榮、李雨師、梁明成，共 6 人。	3 HR
2025/11/21	從股東行動主義觀點，由外資法人投票行為之實務案例解析，來落實國際思維之董監責任 社團法人中華公司治理協會 游秋山	3 HR
2025/12/05	「企業避險新思維：應對匯率挑戰與資產管理趨勢」研討會 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 王文宇、李雨師，共 2 人。	3 HR

公司治理主管

為強化公司治理制度之落實與董事會運作之支持，精材公司已依規定設置公司治理主管。經董事會決議通過，任命法務處處長周正德先生擔任本公司治理主管，負責協助董事會及董事履行職責，並確保公司治理相關作業之正確與法遵。治理主管的主要職責包括：協助董事遵循相關法令及公司章程、確保董事會運作程序符合法規規範、強化董事間及董事與經營管理層之資訊溝通，以及督導公司治理事務之執行與推進。

公司組織架構

精材公司組織架構以董事會為最高決策機構，下設審計委員會、薪資報酬委員會及 ESG 指導委員會三大功能性委員會。董事長暨總經理統籌全公司營運，轄下設有內部稽核、法務處、人力資源處、財務組織、品質及可靠性組織、業務組織、研發組織、營運組織等各職能部門。



2.4 功能性委員會

為提升董事監督效能與參與度，公司董事會下設三大功能性委員會，包括「審計委員會」、「薪資報酬委員會」及「ESG 指導委員會」，由董事及獨立董事擔任委員，針對各自職責領域進行深入監督與政策審議。

審計委員會

組成及職掌概述

由本公司獨立董事王文宇、謝徽榮、溫環岸及梁明成擔任委員，成員共計四人；而獨立董事溫環岸因任期屆滿改選，於 2025 年 5 月 29 日卸任，由獨立董事李雨師新任；其中一位獨立董事具備會計或財務專長。主要工作職責包括：審閱與確認財務報表之表達適當性；選任或解任簽證會計師，並評估其獨立性與績效；檢討內部控制制度及法規遵循狀況；評估風險管理政策與機制之有效性。

2025 年運作情況

全年共召開 6 次委員會會議，會計師每季出席委員會，並向獨立董事報告財務查核重點與法令更新，與獨立董事保持雙向溝通，確保審查透明且全面。

職 稱	姓 名	審計委員會	薪資報酬委員會	ESG 指導委員會
董 事 長	陳家湘	---	---	召集人
董 事	游秋山	---	---	---
獨立董事	王文宇	委 員	委 員	---
獨立董事	謝徽榮	召集人	委 員	---
獨立董事	梁明成	委 員	召集人	委 員
獨立董事	李雨師	委 員	---	委 員

薪資報酬委員會

組成及職掌概述

由本公司獨立董事梁明成擔任召集人，王文宇、謝徽榮擔任委員，成員共計三人。主要工作職責包括：定期檢討委員會組織規程與運作方式；訂定與檢討董事及經理人之薪資報酬政策與結構；根據職務、貢獻與績效目標達成狀況進行薪酬評估；建議董事與經理人酬金方案，提報董事會決議，並依法公開揭露。

2025 年運作情況

薪資報酬委員會共召開 4 次會議，審核董事與經理人年度績效及酬勞方案，評估董事酬勞與員工酬勞提撥金額，強化公司激勵制度與營運績效連結，促進長期永續發展。

ESG 指導委員會

組成及職掌概述

由本公司董事長陳家湘、獨立董事李雨師及梁明成擔任委員，成員共計三人。主要工作職責包括：審定公司 ESG 願景、策略、管理方針及相關政策；審核年度永續工作計畫與目標；督導執行委員會執行成果與工作進度，確保策略落實與改善循環。

2025 年運作情況

ESG 指導委員會於 2025 年召開 2 次會議，全體委員出席率達 100%。會議審議年度永續行動計畫，並追蹤執行小組之各項推動進度，以確保 ESG 發展目標之落實。



2.5 薪酬制度

董事薪酬政策

依據本公司章程規定，若年度有盈餘，得提撥不超過當年度稅後淨利 2% 作為董事酬勞。惟此項酬勞不包括兼任本公司經理人之董事，以強化職責區隔與治理獨立性。董事報酬之給付依據本公司《董事酬勞、報酬及車馬費給付辦法》辦理，並參考董事個別對公司營運之實際參與程度與貢獻價值，結合國內外同業薪酬水準作為調整依據。董事績效評估結果亦納入整體酬勞核定考量，並須經薪資報酬委員會審議後，報請董事會通過。2025 年度，董事酬勞合計新台幣 604.8 萬元（稅前淨利之約 0.4%）。本公司並未設置董事會酬金索回機制及退休福利制度。

經理人薪酬政策

本公司經理人之薪資報酬係依其職務性質、管理職級、營運參與程度、個人績效與目標達成情況等多項因素綜合評定。績效評估項目包括年度經營目標達成率、公司整體獲利率、各部門營運效能與實質貢獻、個人能力發展與團隊領導成效等。公司亦參考產業市場薪酬調查與同業水準，制訂具競爭力且具激勵效果的薪酬結構。相關薪酬方案須經薪資報酬委員會評估並提交董事會審議通過後執行。

董事會利益衝突之迴避情形

為落實誠信經營原則並強化公司治理，精材公司已建立完備的董事會利益衝突規避制度，確保決策過程之公正性與透明性，並兼顧公司、股東及利害關係人之最大利益。依據《董事會議事規則》第 14 條規定，董事對於會議事項，與其自身或其代表之法人有利害關係者，應於當次董事會說明其利害關係之重要內容，如有害於公司利益之虞時，不得加入討論及表決，且討論及表決時應予迴避，並不得代理其他董事行使表決權。所有涉及利益迴避之案件，皆由董事會秘書依規定詳細紀錄並納入會議紀錄中，供公司內部審核與對外揭露參考。

▼ 年度總薪酬比率



全體員工年薪中位數

NT\$ 840,000

依據非擔任主管職務之全時員工
「薪資總額」之定義



全體員工年薪平均數（非主管職）

NT\$ 1,076,000

依據非擔任主管職務之全時員工
「薪資總額」之定義



總經理與其他員工薪酬中位數之倍數

9 ~ 10 倍



基層員工起薪倍數（相對法定基本工資）

1.03 倍

1.03 倍（月薪約 NT\$29,447 元）

2025 年法定基本薪資
NT\$28,590/ 月

管理職男女薪酬比（男：女）

1 : 0.9 | 以男性薪資為基準

專業 / 間接人員男女薪酬比（男：女）

1 : 0.9 | 以男性薪資為基準

技術 / 直接人員男女薪酬比（男：女）

1 : 0.98 | 以男性薪資為基準

董事會績效評估

精材公司每年依《董事會績效評估辦法》進行評估，對象涵蓋整體董事會、個別董事及功能性委員會，評估指標納入永續監督、風險控管等 ESG 相關項目。評估採內部自評與同儕互評方式，結果提報董事會作為改善依據。評估面向包括：參與公司營運之程度、提升董事會決策品質、董事會組成及繼任規劃、內部控制、董事會認知、內部溝通與利害關係人關係共六大面向。

永續績效納入評估架構

依據 IFRS 永續揭露準則第 S1 號規定，企業應揭露治理單位如何監督永續相關風險與機會，並說明相關績效指標是否及如何納入薪酬政策中。精材公司在現有六大董事會績效評估面向基礎上，進一步將永續（ESG）績效指標系統性地整合於評估架構，以確保董事會對永續目標之督導責任具體可衡量，並符合 IFRS S1 所要求之治理面揭露。2025 年度共設定以下五大永續績效評估向度，涵蓋氣候風險、職安、供應鏈、誠信合規及資訊安全等重大議題：

 氣候風險治理	主要評估指標 (KPI) · 每年至少召開 1 次 ESG 專項報告 · 審議溫室氣體減量目標達成進度 · 氣候風險議題納入董事會議程比率	2025 年達成情形 已達成 (1 次/年·100% 納入)
 職業安全衛生	主要評估指標 (KPI) · 失能傷害頻率 (FR) 年度目標達成率 · 職安重大事故 0 件目標	2025 年達成情形 重大事故 0 件 認證持續有效
 永續供應鏈管理	主要評估指標 (KPI) · 關鍵供應商 ESG 評估覆蓋率 · 審議溫室氣體減量目標達成進度 · 氣候風險議題納入董事會議程比率	2025 年達成情形 評估覆蓋率 100% 簽署率 100%
 誠信合規治理	主要評估指標 (KPI) · 貪腐風險評估覆蓋率 · 關鍵供應商 ESG 評估覆蓋率 · 高風險供應商改善完成比率	2025 年達成情形 覆蓋率 100% 違規 0 件 訓練完成率 100%
 資訊安全治理	主要評估指標 (KPI) · 重大資安事件件數 · ISO 27001: 2022 認證維持 · 資安教育訓練覆蓋率 · 資安防護系統有效性審查	2025 年達成情形 重大事故 0 件 認證持續有效 訓練覆蓋率 100%

永續績效指標與薪酬連結

依 IFRS S1 第 27 條第 (a) (v) 款要求企業揭露治理單位如何監督永續相關目標之設定，以及相關績效指標是否及如何納入薪酬政策。精材公司已將上述五大永續績效向度之關鍵指標連結至高階主管之年度績效考核，由薪資報酬委員會審議確認，並建議董事會核定。公司已將氣候減碳進度、職安零事故目標及誠信經營運作狀況入高階主管年度績效考核。

評估流程與改善機制

永續績效評估由公司治理主管彙整各永續議題負責部門之年度績效數據，並於每年第一季完成前一年度之評估作業。評估結果提交審計委員會複核後，提報董事會審議，並作為下一年度永續目標修訂之依據。若有特定指標未能達標，董事會應責成相關委員會或管理階層提出改善方案，並於下一季董事會報告改善進度，以落實 IFRS S1 所要求之永續治理問責機制。

2.6 企業誠信經營

精材公司始終堅持誠信經營，將其視為企業的核心價值。公司強烈禁止任何形式的賄賂行為，並要求保密公司及客戶的機密資訊。為確保法規遵循與良好的公司治理，本公司依照「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司誠信經營守則」，制訂了「誠信經營守則」和「董事及經理人道德行為準則」，以指導所有員工遵守最高的道德標準，並避免任何不誠信的行為。公司創造透明與自律的工作環境，鼓勵員工透過暢通管道報告不正當行為，並保護舉報員工免於報復。

誠信經營主要規範

本公司要求員工遵守法律法規與公司治理規範，並禁止行賄、收賄、非法政治獻金、不當慈善捐贈、非法禮物及不正當利益。員工必須忠於職守，清楚了解並遵守「從業道德規範」，並避免參與或鼓勵任何不當活動。

反貪腐與反賄賂

在 2018 年至 2025 年間，精材公司未曾發生任何道德違規或貪腐事件，顯示出公司在誠信經營與反貪腐方面的穩定表現。2025 年度，已確認的貪腐事件為 0 件，無任何員工因貪腐事件被解僱或受到紀律處分，亦無任何與商業夥伴因貪腐違規行為終止合約的情形。

RBA 責任商業聯盟行為準則

精材公司於 2025 年通過 RBA 責任商業聯盟稽核認證，2 持續依據該準則，制定並執行各項計畫以推動客戶服務、環境保護、人權保障、供應商管理及社會參與等永續社會責任要求。規範涵蓋勞工、環境、員工權益、健康安全及道德規範等領域，並定期進行作業流程的查核，發揮企業的社會責任影響力，營造一個友善且包容的工作環境。

利益衝突防範

員工應避免任何可能導致個人利益與公司利益間的衝突。精材公司設有迴避利益衝突的申報系統，要求員工主動申報任何利益衝突情形，並定期進行利益衝突申報政策及反貪腐、反賄賂的宣導，確保每位員工在執行職務時都能遵循道德標準並避免利益衝突。2025 年度，利益衝突申報率達 100%。

人權盡職調查流程

精材公司認真對待人權議題，並建立了三步驟的盡職調查框架來辨識、預防及減少人權風險：



教育訓練與公告宣導

定期公佈公司從業道德規範及誠信經營政策文件，供員工隨時查閱，並透過案例宣導課程及內部網站進行宣導，確保每位員工都能理解並遵守相關規範。所有新進員工須接受相應的從業道德課程，2025 年度員工完成 RBA 責任商業聯盟行為守則訓練，涵蓋誠信經營、利益衝突申報及反貪腐等議題。

反舉報管道與吹哨者保護政策

為確保員工及外部人士擁有安全的舉報管道，精材公司在官網及內部網站提供了舉報任何財務、法律及誠信相關不正當行為的管道。所有舉報將由董事長指派的高階主管處理，並採取適當的保護措施，以防止對善意舉報者或協助調查者進行報復行為。主要舉報管道包括：



2025 年度未接獲任何舉報事件，展現出公司對誠信與合法行為的堅持。

內部稽核

精材公司對於內部法規的遵循十分重視，並制定了多項規範，包括個人資料保護、保密協議、反賄賂、反歧視、環保、反內線交易及勞工保護等，確保企業責任的履行。公司由人力資源部門負責推動專責的誠信經營計畫，並監督各部門的執行情況。每年會向董事會報告內部稽核結果，並對業務流程的遵循情形進行評估。透過內部控制稽核措施，精材公司確保所有業務執行符合相關法規要求，並促進各部門間的合作，提升政策執行績效。2025 年度，內部稽核涵蓋全部查核作業，全部依時程完成。

2025 年度誠信合規績效

為確保員工及外部人士擁有安全的舉報管道，精材公司在官網及內部網站提供了舉報任何財務、法律及誠信相關不正當行為的管道。所有舉報將由董事長指派的高階主管處理，並採取適當的保護措施，以防止對善意舉報者或協助調查者進行報復行為。主要舉報管道包括：

法規遵循與誠信類別	2025 年度績效	說明
 已確認貪腐事件	0 件	無任何貪腐相關事件
 因貪腐解僱或受紀律處分員工	0 件	無相關事件
 因貪腐終止合約之商業夥伴	0 件	無相關事件
 反貪腐訓練—董事會成員	6 人	全體董事
 反貪腐訓練—主管層級	151 人次	含各部門主管
 反貪腐訓練—非主管員工	1,497 人次	全體員工涵蓋
 供應商誠信聲明簽署	100%	新進及現有交易供應商全數簽署
 服務供應商誠信政策溝通	8 家	含人力仲介、保全、清潔、團膳
 貪腐風險評估覆蓋率	100% (所有營運據點)	每年進行危害鑑別與風險評估
 反競爭 / 反托拉斯法律行動	0 件	無相關訴訟
 因環境污染違反環保法規裁罰	0 件	符合環保法規
 違反社會與經濟領域法規	0 件	符合相關法規

2.7 法規遵循

為確保符合國內外最新法令規範，公司訂定了各項管理規章與辦法。公司積極關注可能影響營運的法令與政策變動，並設立法規變更簽核流程，協助各部門掌握重大法令修訂的動態。每當有法規變動時，公司會進行法規鑑別和作業分析，並隨之修訂內部相關標準程序。每月追蹤法規變動並通知相關單位，每季進行法規追蹤與鑑別，確保公司內部所有業務遵守法規。關於人權相關法遵狀況，公司依據人力資源法規查核作業，每季進行一次相關法規查核作業，2025 年共鑑別 28 條更新法規，列管遵循法規共 113 條。

法規遵循情況與重大違規事件

在 2025 年度，公司未發生任何重大法規違規事件，亦未遭遇非金錢制裁的處罰，未有任何反競爭、反托拉斯或壟斷相關之訴訟事件，亦未有環保法規重大裁罰事件。

反競爭與反壟斷行為

公司承諾遵守反競爭法與反壟斷法，並根據《精材公司誠信經營守則》的規定，嚴格遵循反托拉斯法、反海外貪污法等相關法令。公司每年修訂相關法規及辦法，確保所有產品與服務未涉及任何反競爭行為。近年來，公司未涉及任何與反競爭、反托拉斯或壟斷相關的事件。

備註 | 重大違規事件的定義是單一事件罰鍰累計超過新台幣 100 萬元。

2.8 精材公司參與之公協會

精材公司積極參與行業公協會，透過與同業及專業機構的互動，持續吸收最新產業知識與治理趨勢，強化公司競爭力與永續發展能力。

序號	協會名稱	資格
1	國立清華大學微感測器與致動器產學聯盟	會員
2	桃園市中壢工業區廠商協進會	會員
3	高科技產業薪資管理協進會	會員





CHAP. 03

永續發展策略 風險管理與財務績效

- 3.0 重大主題管理方針
- 3.1 財務績效
- 3.2 稅務管理
- 3.3 市場及產銷概況
- 3.4 風險管理
- 3.5 傾聽客戶聲音，共創卓越未來
- 3.6 資訊安全管理

精材公司將「永續發展與公司治理」、「營運風險管理」及「資訊安全與隱私管理」列為核心重大主題，透過完整的 ESG 三層治理架構、嚴謹的企業風險管理機制，以及健全的資訊安全體系，確保公司在創造長期經濟價值的同時，積極履行社會責任與環境保護義務。2025 年，完成 ISO 27001:2022 資訊安全管理系統認證，並持續強化企業全面風險管理（ERM）機制，彰顯永續治理的深度與廣度。

3.0 重大主題管理方針

永續發展與公司治理 管理方針



議題範疇及邊界

本主題涵蓋公司 ESG 治理架構的完整性與有效性，範疇包括 ESG 三層治理體系（董事會→ESG 指導委員會→ESG 執行委員會）的運作、永續資訊揭露、年度永續目標設定與追蹤，以及公司對各利害關係人之永續承諾。



潛在風險

ESG 治理架構不完善可能導致永續目標失焦、投資人信任度下降；資訊揭露不透明可能影響公司評鑑排名；董事會永續監督能力不足可能導致策略執行偏差。



潛在機會

健全的 ESG 治理有助於提升公司治理評鑑排名、強化國際投資人信心；透明的永續資訊揭露可吸引 ESG 導向機構投資人；持續的永續目標管理可驅動公司長期競爭力。



管理政策依據

依照 GRI 2-22、金管會上市上櫃公司永續發展行動方案及 SASB 半導體業指引，公司建立 ESG 三層治理架構，包含董事會層級之 ESG 指導委員會（每年至少 2 次）、執行層級之 ESG 執行委員會（每季召開）及各部門 ESG 推動小組，確保永續策略從決策到執行的完整落地。每年發布企業永續報告書，依 GRI 準則揭露重大主題管理績效。



2025 年度目標

- ✓ 每季召開 ESG 執行委員會
- ✓ 完成企業永續報告書
- ✓ 公司治理評鑑達全體上櫃公司前 5%
- ✓ 利益衝突申報率 100%



評估機制與成果

- ✓ ESG 執行委員會每季召開 1 次
- ✓ 完成 2025 年企業永續報告書
- ✓ 年度報告書及公司網站已揭露公司治理運作情形
- ✓ 利益衝突申報率 100%



短期目標（1 年）

- 持續強化董事會 ESG 監督機能
- 擴大永續報告書揭露範疇



中長期目標

- 提升 ESG 評鑑國際排名
- 完善永續資料管理系統
- 強化氣候風險揭露（環境章節詳述）



對應 SDGs



SDG 5
性別平等



SDG 12
責任消費與生產

對應聯合國永續發展目標

【SDG 8 就業與經濟成長】 【SDG 9 永續工業與基礎建設】
【SDG 12 責任消費與生產】 【SDG 16 制度的正義與和平】

透過健全的 ESG 治理架構、系統化的企業風險管理、業界領先的資訊安全防護，以及穩健的財務績效，精材公司致力成為投資人信任、客戶倚重的永續發展標竿企業。

績效亮點

2025 年合併營收
72.4 億元

每股盈餘 (EPS)
4.99 元

資產報酬率
9.79%

重大資安事件
0 件

客戶滿意度
89.4 分

營運績效 管理方針



議題範疇及邊界

本主題涵蓋公司財務績效表現、技術研發投入與產品服務市場競爭力，確保公司持續創造長期經濟價值，維護股東、員工與社會各利害關係人利益。範疇包含合併財務報告、研發投入管理、客戶滿意度及投資人關係等。



潛在風險

全球總體經濟波動、匯率劇烈波動及通貨膨脹等因素可能壓縮公司獲利能力；技術世代轉換可能帶來競爭壓力；客戶過度集中可能造成業務風險；研發投入未能及時轉化為市場競爭優勢可能影響長期成長動能。



潛在機會

AI、車用電子與醫療感測元件等新興應用帶動封裝需求持續擴大；12吋晶圓技術升級可擴大市場份額；持續研發投入可建立差異化競爭優勢，強化客戶黏著度；穩健獲利可支持公司持續擴大資本支出布建未來成長動能。



管理政策依據

依照 GRI 201-1 經濟價值揭露標準，精材公司建立財務績效管理框架，包含：年度營收目標設定與追蹤；研發投入比率管理（目標佔營收 4.5% 以上）；嚴謹的財務風險管理機制（匯率避險、利率管理、通膨因應）；財務資訊定期揭露（依台灣證券交易所規定）；以及每年舉辦股東會與法人說明會，確保投資人充分知情。



2025 年度目標

- 年營收維持正成長
- 維持穩健獲利能力
- 研發投入佔營收比率 $\geq 4.5\%$
- 持續向股東分配穩定股利
- 客戶滿意度維持 85 分以上



評估機制與成果

- 全年合併營收達 NT\$72.4 億元 (年增 2.5%)
- EPS 4.99 元
- ROA 9.79% ROE 14.36%
- 股東現金股利 NT\$678 百萬元
- 客戶滿意度 89.3 分
- 無重大財務違規事件



短期目標 (1 年)

- 續優化製程成本效益
- 加速 12 吋晶圓封裝技術導入
- 強化財務風險控管機制
- 提升客戶多元化程度



中長期目標

- 毛利率持續提升獲利持續成長
- 年營收及稅後淨利均呈正成長
- 深化異質整合封裝技術平台建構，拓展高附加價值產品線



對應 SDGs



SDG 8
就業與經濟成長



SDG 9
永續工業與基礎建設



SDG 12
責任消費與生產

風險管理 管理方針



議題範疇及邊界

本主題涵蓋企業全面風險管理 (ERM) 框架的建立與執行，包括財務風險 (匯率、利率、通膨)、營運風險 (供應鏈中斷、設備故障)、環境風險 (氣候相關，詳見環境章節)、社會風險 (勞工、社區)、資安風險及法規遵循風險等六大類別，並含業務持續計畫 (BCP) 管理。



潛在風險

未能有效識別與管理關鍵業務風險可能導致營運中斷、財務損失；供應鏈中斷或單一客戶 / 供應商集中度過高可能影響公司穩定性；未符合法規要求可能遭受裁罰。



潛在機會

健全的風險管理體系可提升公司韌性，增強客戶信任；完善的 BCP 有助於在突發事件中維持業務連續性，保持市場競爭優勢；主動管理氣候風險可識別綠色轉型機會。



管理政策依據

依循 ISO 31000 風險管理框架，公司於 2020 年成立「風險管理委員會」，由高階主管及跨部門專業人士組成，定期識別、評估及管控各類風險。委員會每季召開風險審查會議，並定期向審計委員會及董事會提出風險管理報告。同時建立業務持續計畫 (BCP)，確保關鍵業務流程在突發事件下仍能維持運作，關鍵業務流程 RTO (復原時間目標) < 4 小時。



2025 年度目標

- ✓ 每季召開風險管理委員會
- ✓ 完成全面風險鑑別
- ✓ 關鍵業務流程 RTO < 4 小時
- ✓ 關鍵供應商 BCM 稽核覆蓋率 100%



評估機制與成果

- ✓ 風險管理委員會每季召開
- ✓ 完成六大類風險識別與評估
- ✓ 關鍵業務流程 RTO 達標
- ✓ 完成關鍵供應商 BCM 稽核
- ✓ 無重大營運中斷事件



短期目標 (1 年)



持續定期風險審查



強化 BCP 演練
(含斷電、網路攻擊情境模擬)



中長期目標



建立更完善的供應
鏈韌性評估機制



深化氣候相關財務揭
露 (環境章節詳述)



持續提升風險管理成熟度



對應 SDGs



SDG 8
就業與經濟成長



SDG 9
永續工業與基礎建設



SDG 12
責任消費與生產



SDG 16
制度的正義與和平

資訊安全與隱私 管理方針



議題範疇及邊界

涵蓋公司機密資訊保護、客戶資料隱私管理及資訊安全治理，範疇包含全體員工、客戶、供應商及商業夥伴，涉及機密資訊保護委員會 (PIP Committee) 運作、ISO 27001 認證維護、資安防護基礎設施管理及個人資料保護法遵。



潛在風險

資訊安全事件或資料洩漏可能造成商業機密外洩、客戶信任受損及法律責任；網路攻擊及社交工程威脅持續升高；員工疏失可能造成資安漏洞。



潛在機會

取得 ISO 27001:2022 認證可強化客戶信任、提升品牌形象，並符合大型國際客戶的供應商資安要求；持續投資資安防護可降低事件應變成本；完善的個資保護可預防監管風險。



管理政策依據

公司自 2008 年成立機密資訊保護委員會 (PIP Committee)，制定《機密資訊保護政策》、《機密資訊保護作業管理辦法》及《資訊系統安全規範》。依個人資料保護法訂有個人資料保護管理程序。取得 ISO 27001:2022 資訊安全管理系統認證。依 PDCA 循環制定五大行動目標，確保資安防護全面落實。



2025 年度目標

✓ 無重大資安事件	✓ 年度隱私影響評估 (PIA) 執行率 100%	✓ 每月第三方系統弱點掃描	✓ 完成 ISO 27001:2022 認證	✓ 全員 PIP 教育訓練完成
--------------	------------------------------	------------------	---------------------------	--------------------



評估機制與成果

✓ 無重大資安事件	✓ 無客戶資料洩漏事件	✓ 全員完成 PIP 教育訓練與稽核
✓ 2025 年 9 月取得 ISO 27001:2022 認證	✓ 完成 12 次 PIP 管理會議及 4 次 PIP 委員會議	



短期目標 (1 年)



維護 ISO 27001 認證



持續月度弱點掃描



強化社交工程防禦演練



中長期目標



深化零信任架構建設



持續提升外部資安評鑑等級 (目標維持 A 等級)



擴大資安供應鏈管理範疇



對應 SDGs



SDG 9
永續工業與基礎建設

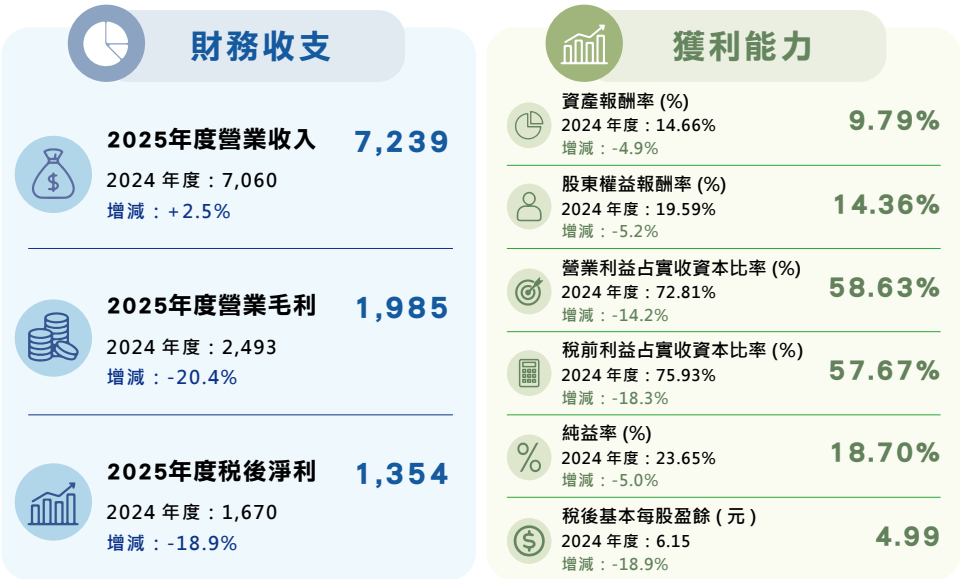


SDG 16
制度的正義與和平

3.1 財務績效

精材公司在 2025 年度持續引進新機台與開發新製程，逐步擴展 12 吋封裝與加工技術，並將既有的 8 吋技術延伸至 12 吋。針對市場趨勢及特定客戶需求，公司開發了多項專案，包括：客製化晶圓級封裝應用於 AR/VR 領域、車用影像感測器客製化加工服務，以及穿戴式裝置感測器的超薄晶圓級封裝。公司於 2025 年全年營收達新台幣 72.4 億元，較前年度成長 2.5%；稅後淨利達新台幣 13.5 億元，每股淨利為 4.99 元。

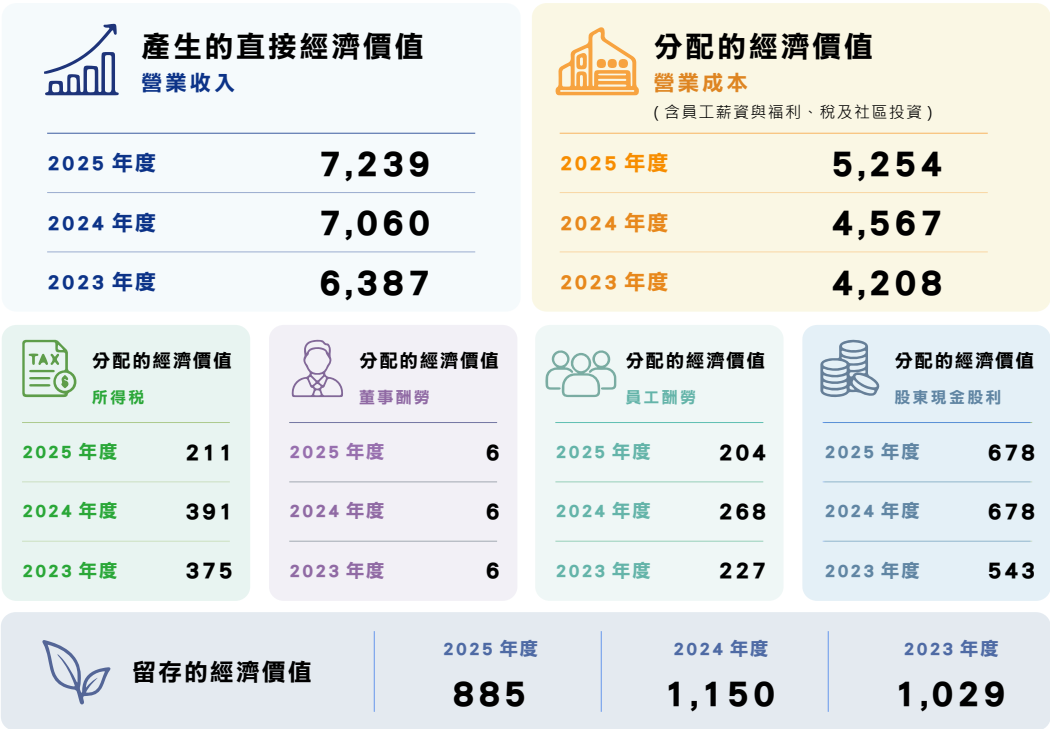
財務績效概況



表：財務績效 (單位：新台幣佰萬元)

經濟價值分配

精材公司 2025 年度產生之直接經濟價值與分配如下，反映公司對員工、供應商、政府及股東等利害關係人的經濟貢獻。公司遵循上市公司之資訊揭露規範，定期公告財務報表及重大資訊，並公開於公司網站與公開資訊觀測站。



註：留存的經濟價值 = 產生的直接經濟價值 - 分配的經濟價值。

3.2 稅務管理

本公司承諾實行嚴謹的稅務治理策略，採用保守且穩健的稅務管理政策來支持永續發展。各營運據點均依據當地國家之稅法規定嚴格遵守，並以誠信與透明度為核心原則，堅守常規交易規則，避免利用稅務結構調整或避稅天堂進行稅務規劃。此外，在財務報告中充分披露稅務相關資訊，以增強對外透明度，並在稅法有變動時重新檢視稅務政策，以確保完全符合當地規範。

公司積極建立完善的稅務風險管理機制，確保資訊的完全透明和法規的遵循。稅務決策涉及內部擁有相關資格的专业團隊以及外部專家的共同參與，確保按時申報並繳納稅捐，並滿足法定的資訊披露要求。對於政府推動的稅收優惠政策，公司不僅積極支持，還致力於促進地方經濟和產業的可持續發展。

公司的財務組織承擔著稅務治理的重責大任，遵循內部控制流程，有效識別、評估及管理由法規變更及業務活動產生的稅收風險。所有重大交易和決策均基於臺灣本地稅法及相關稅務協定進行，定期確保日常交易符合當地稅法規範。公司董事會透過審計委員會監督公司的會計、稽核和財務報告流程，確保這些流程的品質、透明度和誠信度。公司承諾遵守營運地點的稅法，並與當地稅務機關保持良好溝通，以公平原則合作，確保所有交易均符合移轉定價規範和常規交易原則。

3.3 市場及產銷概況

2025 年度市場概況說明

一、總體經濟環境：多重壓力下的分化成長

2025 年，全球經濟步入「後通膨、高科技競爭」的關鍵轉折點。美國推動「對等關稅」與保護主義，促使供應鏈加速落實「中國 +1」及屬地化生產佈局，地緣政治風險持續升溫。台灣半導體產業雖憑藉技術壁壘化危機為轉機，然國內企業同步面臨「能源、人力、減碳、關稅」四重成本夾擊——工業電費調漲、碳費時代開啟、結構性缺工引發薪資上升，多重壓力嚴峻考驗企業的獲利韌性。

二、全球半導體產業：AI 驅動景氣創歷史新高

在 AI 應用基礎設施建設全面提速帶動下，WSTS 上修 2025 年全球半導體產值預估至 7,720 億美元（年增 22%），創歷史新高。其中邏輯 IC 增幅最大（+37.1%），感測器亦成長 10.4%。展望 2026 年，全球半導體市場規模預估將再成長 25% 以上，達 9,750 億美元，逼近兆元大關。台灣晶圓代工產值突破 4.3 兆元新台幣、封測產值約 7,100 億元，持續鞏固全球供應鏈關鍵地位。

三、CMOS 影像感測器與 MEMS 市場：轉型升級，成長動能強勁

CIS 市場正從「手機驅動」轉向「AI 與自動化驅動」，應用快速擴展至車用 ADAS、AR/VR 智慧眼鏡、醫療影像及機器視覺等領域。隨

著 Edge AI 於 2026 年走入終端裝置，CIS 已成為 AI 感知系統的核心元件。根據 Stratistics MRC 預測，2025 年全球 CIS 市場規模將達 336.4 億美元，2032 年將達 643.2 億美元（CAGR 9.7%）。MEMS 感測器方面，廣泛應用於消費電子、汽車、工業及穿戴裝置，2025 年市場規模估計約達 175 億美元（Yole），成長動能穩健。

四、晶圓級封裝：先進封測需求持續擴大

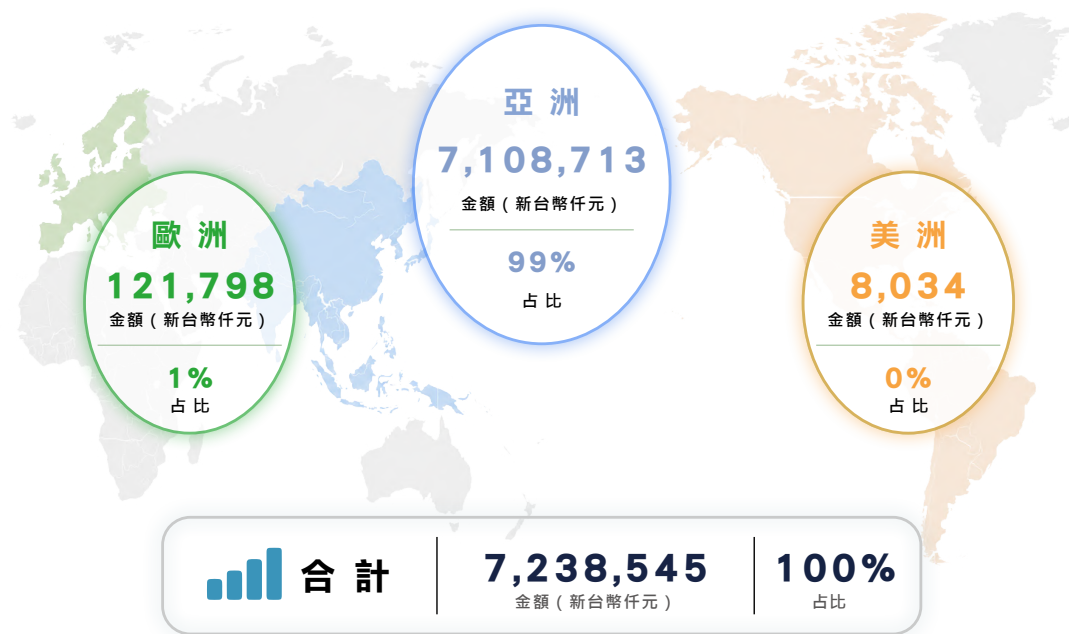
在後摩爾定律時代，系統級封裝（SiP）提供跨技術節點的整合解決方案，薄型封裝與晶圓級封裝（WLP）需求持續擴大。精材作為全球首家將三維晶圓層級封裝技術商品化的公司，具備獨特的技術先發優勢，可充分掌握此波先進封裝成長機遇。

五、精材公司營運展望

面對市場機遇與多重挑戰，精材公司持續採取差異化策略，聚焦晶圓級 CSP 封裝服務，應用涵蓋影像感應器、光學感應器、IMU、MEMS 及生物辨識感測器等領域。2025 年 12 吋新機台陸續到位，車用 CIS、穿戴裝置感測器等新專案數項已完成產品驗證，即將量產；晶圓測試服務第二階段裝機依計劃推進，將成為近年最主要成長動能。展望未來，公司將持續深化晶圓級封裝、SiP 及測試服務三大業務方向，在 AI 感知、車用電子及穿戴裝置等高成長賽道上鞏固競爭優勢。

主要商品之銷售地區

精材公司 2025 年度產生之直接經濟價值與分配如下，反映公司對員工、供應商、政府及股東等利害關係人的經濟貢獻。公司遵循上市公司之資訊揭露規範，定期公告財務報表及重大資訊，並公開於公司網站與公開資訊觀測站。



本公司上下游之價值鏈

半導體產業鏈猶如一條精密的生產流水線，將構思巧妙的晶片設計，一步步轉化為可供使用的成品。精材位於半導體產業鏈之中下游階段，在封裝與測試領域扮演關鍵角色。半導體產業鏈主要可分為三個主要階段：



3.4 風險管理

風險管理是永續發展的基石，隨著全球對環境、社會與公司治理（ESG）議題的重視，精材積極響應國際趨勢，於 2020 年成立「風險管理委員會」，系統化地整合企業風險管理（ERM）與 ESG 策略，展現其對永續經營的承諾。透過委員會的運作，不僅可降低風險，更將挑戰轉化為競爭力，為股東與社會創造長期價值。

■ 風險管理委員會主要職責

風險管理委員會由高階管理層及跨部門專業人士組成，主要職責包括：

01

風險識別與評估

定期審視營運中的潛在風險，涵蓋財務、營運、環境及社會層面，並將其納入 ESG 策略框架。

04

資安與科技風險

因應半導體產業的技術敏感性，強化數據保護與智慧財產權管理。

02

氣候變遷與環境風險管理

針對極端氣候、碳排放法規等議題，制定減碳目標與能源轉型計畫（詳見環境章節）。

05

定期向審計委員會及董事會提出風險管理報告。

03

供應鏈韌性

確保供應商符合 ESG 標準，降低因環境或勞工問題帶來的營運中斷風險。

06

規劃風險管理會議、追蹤風險目標。

■ 業務持續計畫：建構全方位韌性

精材公司制定業務持續計畫（BCP），確保在突發事件（如自然災害、供應鏈中斷、資安攻擊等）發生時，關鍵業務流程仍能維持運作。主要措施包括：定期進行 BCP 演練（如模擬斷電、網路攻擊等情境），確保應變流程順暢；加強緊急事件應變能力，建立跨部門應變小組，確保危機發生時能迅速決策；關鍵業務流程 RTO（復原時間目標）< 4 小時。2025 年度完成關鍵供應商 BCM 稽核覆蓋率 100%。



本公司各面向風險列表



01 財務風險

匯率變動風險

說明 本公司營收主要以外幣進行交易，部分製造成本亦以外幣支付，因此，任何顯著的國際匯率變動均可能對公司損益造成不利影響。

因應策略 以進貨所產生之應付帳款（外幣負債）與收入所產生之應收帳款（外幣資產）相互沖抵，發揮自然避險效果。同時密切注意匯率趨勢，定期以買賣遠期外匯或即期外匯合約管理匯率風險。

利率變動風險

說明 利率的變動對公司損益影響可分為兩部分：約當現金利息收入隨利率上升而增加，利息費用則將因利率上升而增加。

因應策略 為避免未來利率走高，增加融資成本之不確定性，本公司持續關注利率走勢，視市場狀況及中長期負債部位，決定是否向銀行簽定利率交換交易。

通貨膨脹風險

說明 因通貨膨脹因素使成本增加或實際收益減少的可能性，因通貨膨脹會降低本公司之購買力。

因應策略 密切掌握原物料供需狀況，積極尋求兼具品質和價格競爭力的替代來源；致力於製程改良、良率改善及效率提升的成本縮減活動。



02 營運風險

供應商管理

說明 單一供應商可能造成生產中斷或不穩定風險。

因應策略 開發新供應商，加強對現有供應商的稽核，降低依賴單一供應商，確保供應穩定。

業務風險

說明 客戶過於集中可能影響業務穩定性。

因應策略 積極開發多元化的產品及客戶群，分散業務風險。

法律風險

說明 遵守所有相關法規，並持續監控法規更新。

因應策略 各部門監控其業務範圍內的法規，並確保風險評估和策略執行到位。



03 環境風險

氣候變遷

說明 極端氣候對環境和社會經濟活動的影響愈來愈顯著，可能影響廠區營運及供應鏈穩定。

因應策略 評估氣候變遷對公司可能帶來的機會與風險（詳見環境章節），積極推動綠色製程、環保節能與減碳措施。

水資源

說明 極端型氣候造成水資源匱乏，可能影響生產製程。

因應策略 改善水回收設施，減少自來水使用量；改善製程用水，降低水資源消耗。



04 社會風險

員工招募

說明 人口少子化與產業需求高，導致人才招聘困難。

因應策略 定期檢視人力需求，透過多渠道招募適合人才，符合政府規範聘用外籍員工。

勞動安全

說明 公司高度重視職業安全，已獲得 ISO 45001:2018 驗證。

因應策略 設立完善的職業安全與健康管理系統；對所有工作場所進行全面的風險識別與評估。



05 資安風險

資訊安全

說明 半導體技術敏感性高，面臨網路攻擊、社交工程等威脅，可能造成機密資訊外洩。

因應策略 建立 PIP 委員會機制、取得 ISO 27001:2022 認證、建置 SIEM 系統、定期弱點掃描及員工教育訓練。



06 社會風險

法規遵循

說明 國內外環保、勞工、資安等法規日趨嚴格，不遵循可能遭受裁罰。

因應策略 設置法規鑑別機制，每月追蹤法規變動。

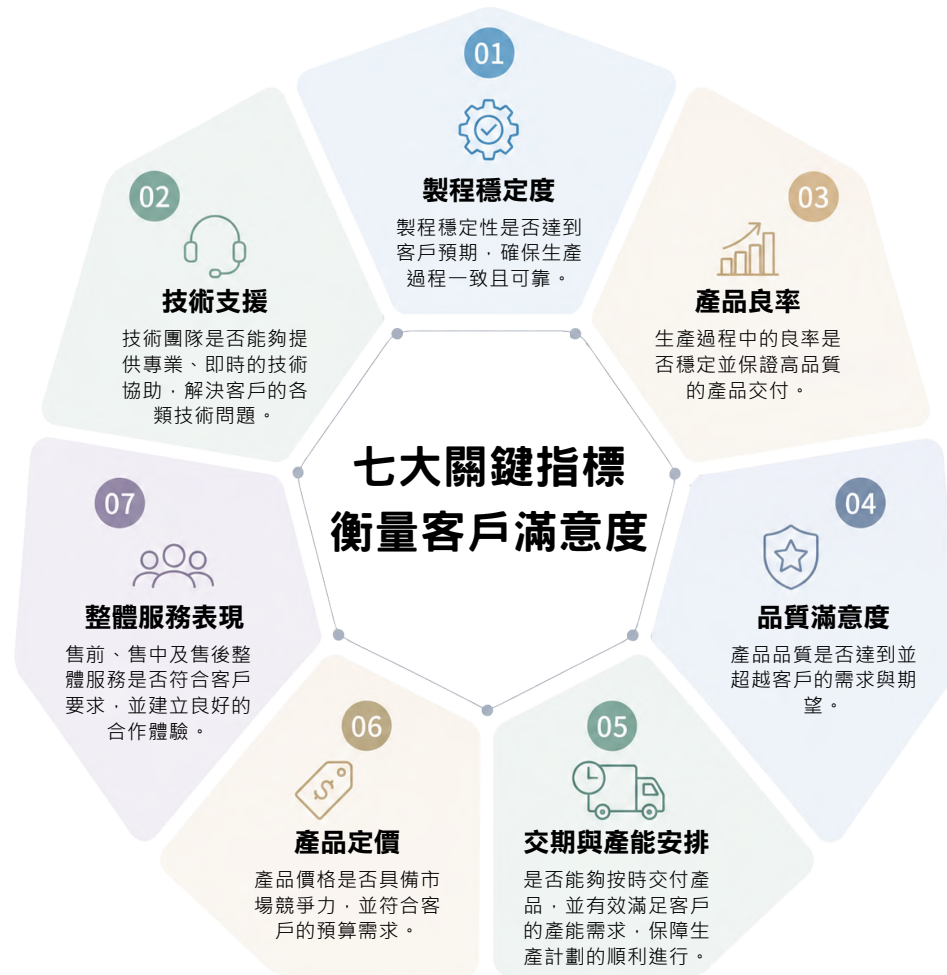
3.5 傾聽客戶聲音，共創卓越未來

客戶滿意度

精材客戶滿意度問卷內容主要涵蓋七大衡量指標：製程穩定度、技術支援、產品良率、品質滿意度、交期與產能安排、產品定價與整體服務表現。透過客戶問卷收集相關建議與回饋，作為提升客戶服務品質與產品改善之重要參考依據。

客戶滿意度成績

2025 年精材公司整體客戶滿意度得分為 89.3 分，客戶滿意度維持高水準（近三年調查結果皆在 88-89 分間），主要來自於「交期」、「技術支援」與「製程穩定度」等項目獲得客戶高度肯定。這充分體現了對服務、技術及品質的重視，也反映出在與客戶合作中所取得的良好成果。對於未達標準項目以及客戶給予的建議與回饋，經彙整後交由相關部門擬定改善計畫並執行，同時將結果反饋給客戶，並將「年度客戶滿意度調查成績」於「高階管理審查會議」報告執行結果，以確保客戶需求與回饋受到管理階層重視，進而強化市場競爭力。



3.6 資訊安全管理

機密資訊保護與管理

為保障公司及客戶的機密資訊安全，精材公司自 2008 年起設立了「機密資訊保護委員會（PIP Committee）」來負責資訊安全管理與監督工作。委員會制定了《機密資訊保護政策》和《機密資訊保護作業管理辦法》，明確規範公司在機密資訊保護上的管理政策、流程及操作規範。PIP 委員會偕同資訊部門每季定期召開會議，檢視資安政策執行成果，並每年定期向董事會報告資安治理概況。為順應資安趨勢，建全公司資安標準作業程序，確保面對威脅時具備即時應變韌性，本公司於 2025 年 9 月取得 ISO 27001 資訊安全管理系統認證，全員完成資訊安全教育訓練，無重大資安事件損失。

資安五大行動目標

精材公司依 PDCA 循環，制定五大資安行動目標並持續落實：

01	建立與落實機密資訊及資訊安全管理系統。	制度面	
02	遵守法規與合約之機密資訊及資訊安全要求。	合規面	
03	落實員工與相關團體機密資訊保護及資訊安全教育及宣導。	人員面	
04	評估與鑑識風險並設定改善目標與控制措施。	技術面	
05	透過內部稽核活動持續改善機密資訊及資訊安全管理系統。	稽核面	

資安防護架構

精材公司建立多層次資安防護架構，涵蓋郵件防護（垃圾郵件過濾、關鍵字稽核、郵件寄送政策）、網路防護（防火牆、網頁瀏覽管制、網頁隔離、TLS 加密）、端點電腦防護（軟硬體管制、防毒軟體、硬碟資料加密）及伺服器防護（雙因子認證、檔案異動軌跡、連線行為側錄、異常行為監控）四大防護層面。總計資安建置投入約新台幣 909 萬元，年度維護費用約新台幣 781 萬元，形成全方位資安防禦體系。

防護層面	主要措施	效益
郵件防護	垃圾郵件過濾、關鍵字稽核、郵件寄送政策管控	減少惡意郵件（釣魚、木馬、病毒及廣告），降低資訊洩漏、中毒、入侵及惡意加密之風險
網路防護	防火牆（規則管制、入侵阻擋、沙箱掃描）、網頁瀏覽管制、網頁隔離、第三方萬用憑證	降低外部惡意入侵及內部不當連線操作，防止資訊洩漏、中毒及惡意加密
端點電腦防護	軟硬體管制（USB 管制、軟體白名單）、電腦攜出管制、防毒軟體、硬碟資料加密	防止內部不當行為，防止系統遭惡意使用，避免硬碟資料遭外接讀取
伺服器防護	雙因子認證、檔案異動軌跡、連線行為側錄、異常行為監控	防止外部入侵，追蹤異常操作行為，早期發現並修復異常弱點

資安教育訓練

員工疏忽與大意是企業常見的資訊安全風險之一。為有效應對這些威脅，精材公司定期對所有員工進行機密資訊保護宣傳與教育訓練，並將其列為每年必修課程。培訓內容涵蓋公司網路使用規範、電子郵件使用、敏感性資料保護、資料訪問、移動設備和設備使用規範等。通過這些訓練，提高員工對機密資訊分級和處理常式的認識和能力。此外，定期進行公司內部的釣魚郵件演練，違規人員將由其主管進行輔導和再次訓練。

統計項目	2025 年度成果
 PIP 管理會議次數	12 次
 PIP 委員會議次數	4 次
 全員PIP教育訓練完成率	100%
 資安事件（重大）	0 次
 ISO 27001:2022 認證	已取得 (2025 年 9 月)

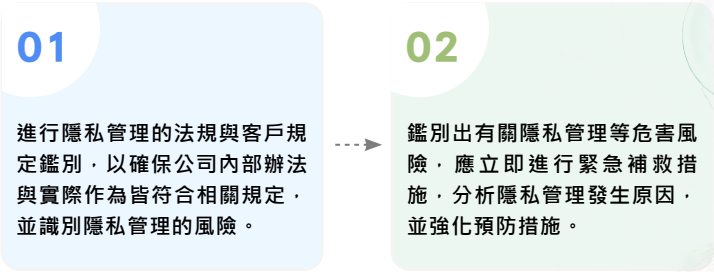
緊急資安事件維護服務

公司每年編列預算簽訂緊急資安事件維護服務，能即時聯繫第三方專業廠商協助分析系統弱點，並進行後續改善與修補措施，確保公司系統及資料不會受到長期影響。

個人隱私管理

依據個人資料保護法訂有個人資料保護管理程序，建立公司執行業務或管理個人資料保護應遵循之依據。於 2025 年間，公司無發生任何客戶資料洩漏事件。

隱私管理之風險管理及衝擊採取之行動措施：



2022 年至 2025 年間，公司無發生任何重大資安外洩事件。





CHAP. 04

安全職場文化

- 4.0 重大主題管理方針
- 4.1 職業安全衛生管理系統
- 4.2 危害辨識、風險評估及事故調查
- 4.3 職業健康服務
- 4.4 工作者參與、諮商與溝通
- 4.5 職業安全衛生訓練
- 4.6 安全防護措施與化學品管理
- 4.7 緊急應變計畫與演練
- 4.8 承攬商安全衛生管理
- 4.9 職業傷害與職業病統計
- 4.10 2025 年度目標達成與未來展望

在精材公司，安全不只是一套管理制度，更是每個工作日的起點。半導體製程涉及化學品、高壓氣體、精密設備與潔淨室環境，技術難度高、操作風險不可忽視。我們相信，唯有讓每一位員工在安全、健康的環境中工作，才能真正實現企業的長期價值。

公司以系統化方式落實職業安全之危害辨識、風險評估與持續改善。公司透過職業安全衛生委員會、月度會議、主動稽核與安全文化推廣等多重機制，確保管理層與一線員工共同守護職場安全，朝「零職業災害」目標持續前行。

4.0 重大主題管理方針



對應聯合國永續發展目標 |

【SDG 3 良好健康與福祉】 【SDG 8 就業與經濟成長】

透過完善的職業安全衛生管理系統、積極的健康促進方案，以及承攬商安全管理機制，保障所有工作者的身體安全與職業健康，共同實現「安全、健康、有尊嚴的工作」目標。

2025 年度職安衛績效亮點



4.1 職業安全衛生管理系統

ISO 45001 認證

2025 年，精材公司已完成中壢三廠（Line C）、中壢二廠（Line B）及中壢廠（Line A）三個廠區的 ISO 45001:2018 職業安全衛生管理系統持續驗證。不僅彰顯公司對系統化安全管理的承諾，更確保三廠區在危害鑑別、風險控制、內部稽核與持續改善等關鍵管理環節上，均達到相同的國際標準水準。同步導入台灣職業安全衛生管理系統（TOSHMS），有效整合國際認證架構與本土法規要求，確保管理制度兼顧全球最佳實務與在地法令遵循。

備註 | TOSHMS 為台灣職安衛法規架構下的管理系統，與 ISO 45001 保持整合。

環安衛政策六大承諾

精材公司環安衛政策由最高管理階層（董事長）正式核定並簽署，確保環安衛工作獲得最高層級的資源支持與授權。政策內容每年進行系統性審視，結合法規變動、年度稽核結果與管理審查會議建議進行更新，並透過公司內網、廠區公告欄及教育訓練等管道向全體員工公告周知，確保每位工作者均知悉並認同公司的環安衛核心承諾。以下六大承諾為現行環安衛政策之核心內容：



◆ 遵守法令規範

滿足政府與客戶的安全衛生要求，確保各項作業合法合規。



◆ 推動資源再利用與污染防制

減少生產過程對環境的負面衝擊，落實廢棄物與廢水管理。



◆ 風險導向管理制度

建立持續改善與危害預防機制，保障所有工作者的安全健康。



◆ 強化認知與責任意識

透過教育訓練，提升員工、承攬商對環安衛議題的認識與當責。



◆ 關注國際環保趨勢

推動綠色產品與供應鏈，呼應國際永續發展要求。



◆ 建立透明溝通機制

強化與員工、供應商、承攬商及客戶的雙向互動，善盡企業社會責任。



4.2 危害辨識、風險評估及事故調查

精材公司以「預防重於補救」為核心理念，將危害辨識與風險評估（HIRA）視為職安衛管理體系的基石。公司每年針對廠區所有作業範疇，系統性執行危害風險鑑別，依量化風險矩陣（R 值＝嚴重度 × 暴露頻率 × 發生機率）評定風險等級，並依五級分類採取對應管控行動，確保高風險作業在控制措施就位前不得開始。同時，公司建立完整的事故通報、調查與改善閉環機制，確保任何職業傷害或虛驚事件均獲得根本原因分析與後續追蹤，以系統性方式持續降低廠區安全風險。

風險等級	2023 年	2024 年	2025 年
 輕度	286 項 (12.3%)	400 項 (16%)	278 項 (11.3%)
 低度可接受	942 項 (40.7%)	1,052 項 (42%)	1,054 項 (42.9%)
 中度可接受	1,086 項 (46.9%)	1,042 項 (42%)	1,122 項 (45.7%)
 高度不可接受	3 項 (0.1%)	0 項 (0%)	2 項 (0.1%)
 總計	2,317 項	2,494 項	2,456 項



2025 年說明
2 項高度不可接受風險已納入持續監督管理，設定明確改善目標，無嚴重不可接受風險項目。

近三年危害風險鑑別結果

危害風險鑑別流程與分級

針對廠區所有作業活動，包括日常與非日常作業、設備操作、新機台上線前安全檢驗，以及承攬商施工等，精材公司均執行系統性危害辨識與風險評估。評估方式採量化風險矩陣，以「風險值（R 值）＝嚴重度（S）× 暴露頻率（F）× 發生機率（P）」進行評分，嚴重度與發生機率各分為五個等級，採取對應管控行動，確保高風險作業在未完成控制措施前不得開始作業。

事故調查與通報機制

精材公司建立完整的職業災害通報、調查與改善閉環機制，涵蓋從事故發生、立即應變、調查根因到改善驗證的全流程管理。當員工在作業中遭遇立即性危險情境時，得在不危及他人安全的前提下，立即停止作業並撤離至安全場所，無需等候指示，並應立即向直屬主管或職安衛人員回報。公司依《職業災害管理程序》執行後續調查，調查時需系統性重新評估相關風險因素，包括：工作安排與作

業許可適當性、歷史類似事故案例對照、緊急情況發生可能性評估、影響人員範圍及危害傳播途徑分析等。調查結果需提出具體改善措施，並設定完成期限與責任人，於下次職業安全衛生委員會會議上進行追蹤確認，以確保根本原因消除、改善措施落實，有效防止類似事故再發。

4.3 職業健康服務

精材公司秉持「以人為本」的健康管理核心理念，建立超越法令基本要求的完整職業健康服務體系。公司相信，員工是最重要的資產，唯有確保每一位工作者在身體、心理與職業健康三個層面均獲得充分守護，企業才能實現可持續的安全文化與長期競爭力。現行職業健康服務涵蓋常駐廠護日常照護、駐廠醫師門診諮詢、職業醫學科醫師定期現場訪視、法定與特殊健康檢查、健康分級管理、健康促進活動及員工心理健康支持等多元面向，全面守護員工的身心整體健康。

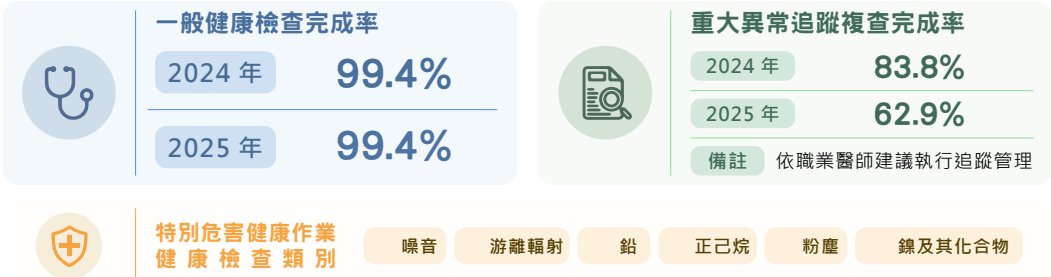
職業健康服務架構

公司設置廠護 3 名，並聘任駐廠醫師提供日常醫療諮詢服務，同時聘請職業醫學專科醫師定期執行作業現場訪視，提供作業環境改善建議、危害辨識方案，以及職業傷病預防與適性配工評估，形成三層次的職業健康服務體系：

服務層級	服務提供者	主要服務內容
 基礎層	廠護（護理師）3 名 常駐各廠區	日常急救處置、健康諮詢、健康管理追蹤、員工健康問卷分析、高風險族群健康關懷
 醫療層	駐廠醫師 （勞工健康服務醫師）	定期門診服務、傷病個案諮詢、健康風險管理
 專科層	職業醫學專科醫師 （定期訪視）	作業現場環境訪視、危害辨識與改善建議、職業傷病預防方案、適性復配工評估

員工健康檢查

精材公司每年提供優於法規標準的員工健康檢查服務，並針對高噪音、游離輻射、鉛、正己烷、粉塵、鎳及其化合物七項特殊作業辦理特殊健康檢查。高齡主管另設有健檢補助機制，確保高風險族群獲得更全面的健康保障。



健康促進計畫

除法定健檢外，精材公司積極規劃多元健康促進活動，將員工的身體健康維護與生活品質提升視為企業社會責任的重要一環。在運動健康方面，公司定期舉辦體重管理競賽、廠區運動挑戰賽、體能訓練課程及柔軟度活動；在知識衛教方面，定期辦理線上健康講座及各類衛教宣導，主題涵蓋心血管疾病預防、正確飲食觀念、慢性病自我管理。公司並引進視障按摩師常駐廠區（FUN 鬆小站），讓員工在緊湊的工作節奏中，能就近獲得紓壓放鬆的服務，有效舒緩長時間站立或精密作業所造成的肌肉緊繃。

4.4 工作者參與、諮商與溝通

精材公司深信，職場安全管理若缺乏工作者的主動參與，僅能停留於「由上而下」的被動遵從，難以形成真正的安全文化。因此，公司依《職業安全衛生法》規定，在各廠區正式設置職業安全衛生委員會，透過勞工代表直選機制，確保一線員工的聲音直接進入安全決策層。同時，公司建立多元化的資訊交流管道，包括月度會議公告、內部網路、安全競賽、主管雙向溝通及保密申訴管道等，確保管理層與每一位工作者之間能實現真正有效的雙向溝通，讓每個人都成為職場安全的主動守護者。

職業安全衛生委員會

公司依法選舉勞工代表，於各廠區設置職業安全衛生委員會，委員會成員涵蓋職業安全衛生人員、各部門主管及監督指揮人員、相關工程技術人員、健康服務護理人員，以及勞工代表五類成員。委員會每月固定召開例行會議，議程涵蓋：上月安全衛生績效指標回顧（含職業傷害數據、稽核缺失）、現場危害改善進度追蹤、法規變動衝擊評估，以及安全衛生推動方案審議等重要事項。會議結論及決議事項均製作正式會議紀錄，並透過廠區公告欄張貼、公司內部網路公告、公文傳閱及部門主管向下傳達等多元管道，確保資訊即時且完整地觸達每位工作者，落實雙向溝通與透明治理。

委員會指標	2024 年	2025 年
 委員會總人數	28 人	39 人
 勞工代表人數	10 人	15 人
 勞工代表比例	36 %	38 %
 年度召開次數	12 次	12 次



每月委員會會議

每月召開，討論安全績效、法規變動與改善建議，會議結論公告全員。



公司內網 / 公告 / 公文

即時發佈職安衛相關資訊、法規政策更新及事故案例，確保資訊透明。



安全知識競賽與訓練活動

透過寓教於樂的方式強化員工安全意識，提升技能應變能力。



海報宣導活動

在廠區顯眼位置張貼安全衛生宣導資料，建立日常安全文化氛圍。



直屬主管 / 委員回饋管道

員工可向直屬主管、委員會成員或安全部門反映問題，公司承諾即時回應並改善。

資訊交流與員工回饋機制

4.5 職業安全衛生訓練

精材公司建立完善的分層分級安全衛生教育訓練體系，依據工作者的角色、職位與作業風險屬性，為不同身分別量身設計訓練課程。

新進員工需完成入職職安衛基礎訓練，方可進入廠區正式作業；在職員工每年定期接受安全衛生複訓，強化知識更新；管理階層則另行接受職業安全衛生管理實務、法規責任及事故調查方法等進階培訓；外部承攬商於每次進廠作業前均須完成危害告知訓練及每日工具箱會議。訓練內容涵蓋消防演練實操、緊急疏散應變程序、危害物質通識、一般安全衛生法規、廠區環境安全規則及化學品安全操作規範等。

所有訓練課程結束後均辦理書面或實作成效評估，評估未通過者需接受補訓，確保安全衛生知識能真正內化並落實於日常作業行為。

訓練類別	訓練內容	 管理人員	 管理階層	 一般員工	 承攬商
 法定教育訓練	依政府或客戶規定執行	✓	✓	✓	✓
 環安衛訓練 (EHS)	強化職安、環保、衛生與應變知識 (消防、緊急應變、化學品危害等)	✓	✓		
 專業課程	依部門職能設計，針對作業安全規範實施	✓	✓		
 危害告知訓練	施工前針對承攬商進行風險預警與安全教育 (含危害物質 SDS、入廠安全、每日工具箱會議)				✓

專業安全衛生證照持有情形

依台灣《職業安全衛生法》及相關子法規定，公司對各廠區具有法定資格要求之專業操作人員，實施嚴格的證照管理制度。由廠區環安衛負責人定期執行法規證照盤點與有效期限追蹤，並於到期前三個月啟動換證或訓練安排，確保法定持照合格率維持 100%。

專業證照項目	取得人數 (2025 年度)	說 明
 職業安全 / 衛生管理師	4 人	最高層級安全衛生管理專業資格
 職業安全衛生管理員	4 人	廠區日常安全衛生管理執行
 甲種職業安全衛生業務主管	5 人	事業單位安全衛生業務主管資格
 有害作業主管 (粉塵 / 缺氧 / 特化 / 有機)	110 人	特殊化學品及高風險作業環境管理
 高壓氣體特定設備操作人員	14 人	高壓氣體系統操作合規管理
 職業健康服務護理人員	3 人	廠護常駐，執行員工健康服務
 急救人員	72 人	各廠區緊急急救能量
合 計	212 人 / 照	廠區持有法定安全衛生專業證照合格率 100%

4.6 安全防護措施與化學品管理

精材公司採行四大面向推動工作安全促進，從硬體設施的源頭設計安全、管理程序的制度性約束、委員會機制的勞資雙向溝通，到安全文化的全員意識培育，形成互相支撐的多層次職場安全防護體系。各面向相輔相成，共同守護每位工作者在廠區的作業安全，並對高風險化學品實施從採購審查到廢棄處置的嚴格生命週期全程管理。

工作安全四大推動面向



硬體設施安全衛生管理

新建或改建廠房時，由廠務、環安及總務等相關單位事前執行安全衛生風險評估，依法規、國際規範與公司標準進行規劃設計。完工後透過專設機制程序進行驗收審核，確保廠房設施符合安全衛生條件。新機台設計依嚴格的環保、安全與衛生審查程序辦理，並透過三階段安全簽核制度後才可正式生產運作。



職業安全衛生管理程序

設有高風險作業管制、承攬商管理、化學品安全管理及安全稽核制度，同時妥善規劃災害緊急應變程序並定期演練。安全變更管理制度涵蓋新建廠房設施及消防防護等級改變，均依「安全變更管理制度」辦理評估與審核。



設置職業安全衛生委員會，落實溝通機制

公司依法設置職業安全衛生委員會，由勞資雙方代表共同組成，每月定期召開，針對安全衛生執行成效與改善事項進行雙向溝通，提升環安衛整體績效。對外部承攬商，公司每年亦舉辦承攬商會議，進行職安衛宣導、意見諮詢與雙向溝通。



安全文化推動

由管理階層公開宣示推動安全文化，持續透過內部落實相關活動，鼓勵全體員工積極參與危害辨識、通報創新改善。同時導入「獎勵取代懲罰」制度，鼓勵主動提案與實務優化，讓安全與健康意識深植為「員工 DNA」，全面提升整體安全文化水準。

化學品安全管理

精材公司重視化學品使用風險之控管，透過制度化管理機制，保障員工健康並降低環境與財產損失風險。管理重點包括：建立化學品使用風險評估制度，與原物料供應商合作制定管控措施；為所有接觸危害物質的員工提供安全資料表（SDS）與適用的個人防護裝備；並針對噪音、游離輻射、鉛、正己烷、粉塵、鎳及其化合物等特殊作業區域，定期進行作業環境監測，確保符合法規與職業安全標準。

化學品管理並整合以下兩項強化災害應對的配套制度：定期規劃災害應變程序與實地演練，確保在緊急狀況下能將人員、社會、環境及財產損失降至最低；以及設立化學品安全稽核與審查制度，預防管理漏洞，確保化學品在完整生命週期內均受到妥善控管。

4.7 緊急應變計畫與演練

精材公司制定全面的持續營運管理規範，涵蓋風險識別、規劃、執行、評估與改善等完整階段，以有效因應突發事件與自然災害。緊急應變優先順序依序為：人員安全（確保內外部人員及鄰近居民安全，防止災害擴大）、環境保護與污染防止（避免污染擴散，減少環境損害）、財產損失控管（快速進行設施損害防堵），以及迅速恢復營運（有效縮短生產恢復時間）。

年度演練項目

各廠區每年依標準演練腳本，結合歷年經驗與行業案例，針對以下情境實施演練：

			
火災應變	有毒氣體洩漏	化學品外洩	大規模人員疏散
模擬廠區火災啟動消防系統、人員疏散、聯繫消防單位全流程。	模擬毒性化學品外洩之人員防護、通報、洩漏控制及後續清理。	測試化學品緊急應變設備、隔離措施及廢棄物緊急處置能力。	演練大規模廠區疏散路線、人員清點與傷員急救程序。
.....			

4.8 承攬商安全衛生管理

半導體製程廠區中，承攬商施工作業所帶來的外部安全風險不可輕忽。精材公司除持續強化內部員工職安衛教育訓練外，亦對所有進廠承攬商實施嚴格的安全衛生管理，確保整體工作場所對每一位工作者，無論其僱用關係為何，均能提供同等水準的安全保障。

公司建立完整的承攬商安全衛生分級管理機制：進廠前透過資格審查評估承攬商的安全體質；施工中執行現場稽核；施工後辦理安全衛生體質評鑑，並依評鑑結果進行分級輔導改善。對於屢次評鑑不達標或拒絕配合改善之廠商，公司得拒絕其進廠作業資格，以維護廠區整體作業安全水準與工作者的基本安全權益。

管理機制	說明
危害告知訓練 (入廠前)	所有入廠承攬商須接受危害告知教育訓練，內容涵蓋施工作業規範、入廠安全訓練及每日工具箱會議。
定期承攬商評鑑	建立分級評鑑機制，針對體質不佳廠商進行個案溝通輔導；必要時拒絕進廠作業，維護整體作業安全。
承攬商年度會議	每年舉辦承攬商大會，進行職安衛宣導、法規更新說明，並開放意見諮詢與雙向溝通。
聯合演練	邀請承攬商共同參與廠區年度緊急應變演練，強化協同應變能力與場地熟悉度。
2025 年度	2025 年無因環安衛體質不良而列入輔導名單之廠商，顯示承攬商整體安全衛生表現良好。

4.9 職業傷害與職業病統計

精材公司每年完整揭露正式員工及在廠承攬商的職業傷害與職業病統計數據。統計範疇涵蓋可記錄之職業傷害件數（廠區作業及通勤）、嚴重職業傷害件數、因職業傷害或職業病造成之死亡人數、職業病確診人數，以及失能傷害頻率（FR）與嚴重率（SR）等關鍵指標。所有統計數據均基於實際工時紀錄及事故通報系統進行計算，確保數據完整性與一致性。公司對於每一起可記錄傷害事件均執行根本原因調查（RCA），並追蹤改善措施之執行成效，以確保職安衛管理體系持續進化。

4.10 2025 年度目標達成與未來展望

精材公司始終以「零職業災害」為職安衛管理的最高目標，以系統化的管理框架搭配全員的安全文化實踐，持續向此目標邁進。2025 年度，廠區作業職業傷害可記錄件數成功歸零，充分印證公司在制度面與執行面的雙重成果。

展望未來，公司將在鞏固既有廠區安全管理成效的基礎上，進一步拓展職安衛管理的視野與深度，將通勤安全納入宣導重點、深化員工心理健康支持機制、強化承攬商安全管理覆蓋率，並積極回應氣候變遷帶來的新型態職場安全風險。精材公司相信，真正的安全職場文化是每個人對安全的主動承諾，而非被動遵從的法規義務；公司將持續以行動印證這一信念，逐步建立更全面、更具韌性的安全職場文化。

近三年職業傷害統計（員工）

指標項目	2023 年 (員工)	2023 年 (承攬商)	2024 年 (員工)	2024 年 (承攬商)	2025 年 (員工)	2025 年 (承攬商)	說明
年度總工作時數 (小時)	2,990,016	(含於員工)	2,806,248	(含於員工)	2,939,448	153,168	2025 年承攬商與員工工作時數分開統計
廠區作業可記錄之職業傷害 (件)	6 件	0 件	9 件	0 件	0 件	0 件	-
洽公 / 通勤途中交通事故 (可記錄)	19 件	0 件	5 件	0 件	18 件	0 件	依台灣《職業安全衛生法》，通勤事故列入統計
嚴重職業傷害 (件)	0 件	0 件	0 件	0 件	1 件	0 件	2025 年嚴重案例為員工通勤交通事故，非廠區作業傷害
因職業傷害死亡人數	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人 (男)	0 人	2025 年死亡案例發生於上下班通勤途中交通事故
職業病人數 (人)	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	-
失能傷害頻率 (FR)	2.01	0	3.21	0	0	0	FR = 失能傷害人次 × 1,000,000 ÷ 總工時 不含上下班通勤途中交通事故
失能傷害嚴重率 (SR)	13	0	33	0	0	0	SR = 失能傷害損失日數 × 1,000,000 ÷ 總工時 不含上下班通勤途中交通事故
損失日數 (日)	39	0	95	0	0	0	不含上下班通勤途中交通事故



2025 年度通勤交通事故說明

2025 年，全廠區作業職業傷害可記錄件數為零。惟本年度發生 18 件員工洽公或通勤途中交通事故 (17 件上下班交通事故、1 件非上下班交通事故)，其中包含 1 件嚴重傷害 (1 名男性員工不幸於上下班通勤途中因交通事故罹難)。依台灣《職業安全衛生法》規定，通勤事故列為職業災害統計範疇。公司對於此一憾事深感遺憾，已依規定完成通報，並持續關懷家屬，同時規劃加強通勤安全宣導，提醒員工行路安全及防禦性駕駛觀念。



CHAP. 05

永續供應鏈管理

- 5.0 重大主題管理方針
- 5.1 供應商類型
- 5.2 供應商評選與績效評鑑管理
- 5.3 責任商業聯盟（RBA）管理
- 5.4 有害物質管理與綠色採購
- 5.5 衝突礦產管理（責任礦產採購）
- 5.6 在地採購優化
- 5.7 供應鏈韌性與風險管理
- 5.8 供應鏈碳管理規劃
- 5.9 目標規劃與未來展望

精材公司是台灣晶圓級封裝（WLCSP）技術的先驅，自 1998 年成立以來，供應鏈管理一直是維繫生產品質、達成客戶信任的核心基礎。精材公司的上游供應商涵蓋基板材料、化學品、製程設備與工程服務等多個類別，每一個環節的品質與合規性，都直接關係到最終封裝產品的良率與可靠性。

2023 年，精材公司正式取得責任商業聯盟（RBA）認證，將勞工、環境、道德與管理系統等面向的要求正式延伸至供應鏈。2025 年，公司在既有的 QCDSS 五維度評鑑架構基礎上，啟動供應鏈碳排放調查，回應國際半導體客戶日益嚴格的 Scope 3 碳揭露要求，以及台灣上市公司永續資訊揭露法規的相關期待，持續強化供應鏈的責任治理能力。

5.0 重大主題管理方針



議題範疇

涵蓋原材料、化學品、製程設備、工程服務及間接材料等各類採購之供應商管理，包含供應商資格審查、QCDSS 績效評鑑、ESG 標準審查、環境與社會風險稽核、衝突礦物申報管理、在地採購比例維持、有害物質管控（RoHS/REACH），以及供應鏈碳排放管理規劃。



潛在機會

- 嚴謹的供應商評鑑有助穩定原材料品質，強化精材公司晶圓封裝良率競爭力；
- 積極落實在地採購可縮短物流距離並降低供應中斷風險；
- 符合 RBA 與客戶 ESG 要求，有助爭取國際大客戶訂單；
- 建立綠色供應鏈有助達成公司「123 節能減廢」環境目標。



2025 年度目標

- 啟動 Scope 3 Category 1 供應鏈碳排放調查規劃框架
- 在地採購比率維持七成以上持續優化在地供應鏈
- 金屬類供應商 100% 完成衝突礦物（CMRT/EMRT）申報
- 完成 67 家供應商 QCDSS 之永續面（S）評鑑維持零 C/D 級供應商
- 新供應商 Category 1 及 Category 2 100% 完成書面 ESG 標準確認 ESG 審查覆蓋率目標 39% 以上



短期目標（2026）

- 完成前 80% 採購金額供應商碳排放基線問卷
- 建立供應商 ESG 績效分級制度並與採購決策連動



對應 SDGs



SDG 8
就業與經濟成長



SDG 12
責任消費與生產



SDG 17
永續發展夥伴關係



潛在風險

供應商環境或勞動人權違規可能危及精材公司聲譽與客戶稽核評比；關鍵材料單一來源導致斷鏈風險，影響生產連續性；若無法因應客戶對 Scope 3 供應鏈碳揭露之要求，可能影響訂單競爭力；衝突礦物採購疏漏將引發客戶合規檢核失敗。



管理政策依據

- 供應商行為準則
- 責任商業聯盟（RBA）行為準則
- 衝突礦物政策
- 公司環境保護政策
- 企業持續營運計畫（BCP）暨供應鏈風險管理程序
- 有害物質管理規範（RoHS/REACH 相關採購規格要求）



2025 年度成果

- 環標標準採購金額達 132,763,719 元，落實綠色採購
- 在地採購比率達 8 成以上
- 12 家金屬類供應商完成衝突礦物調查，合規率 100%，零不符合事件
- 41 家新供應商納入管理，其中 16 家（39%）完成 ESG 標準審查
- 完成 67 家供應商 QCDSS 之永續面（S）評鑑：A 級 56 家（83.6%）、B 級 11 家（16.4%）、零 C/D 級



中期目標

中期 2030



推動關鍵供應商設定碳減量具體目標



A 級供應商比率維持 90% 以上

對應聯合國永續發展目標

- 【SDG 8 就業與經濟成長】
- 【SDG 12 責任消費與生產】
- 【SDG 17 永續發展夥伴關係】

透過責任採購、供應商 ESG 評鑑、在地採購優先、衝突礦物管理及綠色採購，建構以誠信為本的供應鏈夥伴關係，共同實現環境永續與社會責任目標。

2025 年度供應鏈管理績效亮點

- 年度採購往來供應商總數
- 完成 QCDSS 之永續面（S）評鑑供應商數

240 家

67 家

- QCDSS 之永續面（S）A 級供應商比率
- 在地採購比率維持 80%

83.6%

80%

- C/D 級或重大負面影響供應商
- 2025 年新增供應商

0 家

41 家

- 新供應商完成 ESG 審查（39%）
- 衝突礦物供應商合規率

16 家

100%

- 環標標準採購金額
- 取得 RBA 責任商業聯盟認證

1.33 億元

2025 認證

5.1 供應商類型

精材公司以晶圓級封裝為主要業務，所需原材料、化學品、設備與服務高度技術導向。

公司依採購性質與供應商特性，將採購來源劃分為四大類別，並針對不同類別採取對應的管理強度與稽核機制。

供應商類別	型態說明	產 品
 Category 1	委外加工（原物料、成品或半成品）或測試之供應商	蓋版加工
 Category 2	BOM 表內之直接（DM）、間接（IDM）原物料之供應商	化學品、乾材、基版
 Category 3	提供機器設備、委外備校、零件備品之供應商	機械修護、電氣設備修護、設備零件
 Category 4	其他廠務工程、總務類、服務性質、治工具運輸等服務性之供應商	人力派遣、工安、環保

2025 年度精材公司採購往來廠商共計 240 家。公司主要供應商以 Category 2（直接與間接原物料）及 Category 1（委外加工）為 QCDSS 評鑑之主要對象，2025 年施作之結果，QCDSS 共考核計 46 家，考核結果皆為 A 級；永續（S）施作之供應商共 67 家，評核結果 A 級 56 家，B 級 11 家，無 C 和 D 級供應商。精材公司的採購業務由「支援組織」統籌負責，聯絡窗口為採購業務管理部門，確保採購活動與公司品質及永續政策充分整合。在 Category 2 主要原物料供應商中，本地供應商比例已達 80%，超過設定的 70% 目標。

5.2 供應商評選與績效評鑑管理

永續供應鏈管理架構

透過建立「新供應商審查」與「現有供應商年度評鑑」雙軌管理機制，確保進入供應鏈的廠商符合品質、環境與社會責任標準，並透過持續評鑑推動共同進步。

精材公司的永續供應鏈管理架構以三大支柱貫串全程，形成相互支撐的整體系統：

管理支柱	主要內涵
 永續管理規範	◆ 供應商行為準則稽核與簽署道德承諾書 ◆ 綠色產品限用物質規範（RoHS、REACH 等） ◆ 衝突礦石管理規範
 管理機制	◆ 新供應商評核 ◆ 年度供應商評核（QCDSS） ◆ 供應商缺失輔導與改善
 綠色管理	◆ 強化在地採購 ◆ 使用環境友善綠色供應商 ◆ 供應商全面符合政府法律與規範

新供應商審查程序

新供應商在正式納入合格廠商名單前，須通過多階段審查。自 2019 年起持續推行供應商自我評估問卷（SAQ），並簽署「供應商行為準則」，確認其在勞動條件、職業安全、環境法規與商業道德方面符合 RBA 行為準則之要求。

	審查階段	內容要求
	基本資格審查	- 營業登記合法性確認 - 財務穩健性初評 - 產品或服務基本符合性確認
	品質與環境評估	- ISO 9001 品質管理系統確認 - ISO 14001 環境管理系統狀態 - RoHS/REACH/ 衝突礦物政策符合性 - 有害物質管控能力評估
	社會責任審查	- 簽署供應商行為準則（含 RBA 要求承諾） - 勞動條件與人權政策確認 - 無重大環境或勞動違規紀錄 - 完成 SAQ 自評問卷
	現場稽核 （視情況執行）	- 針對高採購金額或高環境 / 社會風險之新供應商執行現場稽核，驗證問卷內容的真實性與現場管理水準

2025 年新增供應商 41 家，其中 16 家（39%）完成 ESG 標準審查，其餘主要為低風險或短期採購性質之 Tool/Parts 供應商。

QCDSS 五維度年度績效評鑑

QCDSS 為精材公司現有供應商年度評鑑的核心框架，從品質（Quality）、成本（Cost）、交期（Delivery）、服務（Service）、永續性（Sustainability）五個維度全面衡量供應商表現，評分結果分為 A、B、C、D 四個等級。C 級供應商須於 4 個月內提出改善計畫，D 級須於 8 個月內完成改善，逾期未達標者將啟動替換評估。

維 度	代表字	主要評核項目	資料來源
 品質	Q Quality	進料檢驗合格率、品質異常處理效率、矯正預防能力、ISO 9001 認證狀態	IQC 紀錄 異常追蹤系統
 成 本	C Cost	報價合理性、年度降本配合意願、總採購成本（TCO）競爭力	報價比較 成本年度檢討
 交 期	D Delivery	準時交貨率、緊急需求應變能力、安全庫存與供料連續性	交貨記錄統計
 服 務	S Service	技術支援能力、問題回應速度、文件配合度、溝通效率	採購人員評分 服務記錄
 永續性	S Sustainability	環境管理系統（ISO 14001）認證狀態、勞動人權合規（RBA SAQ）、職業安全衛生管理、碳排放揭露進展	SAQ 問卷 書面審查 現場稽核

供應商評鑑結果比較

	2024	2025
 評鑑家數	71	67
 A 級	60	56
 B 級	11	11
 C 級	0	0
 D 級	0	0
 備 註	S 面向（永續性）評鑑 71 家；QCDSS 完整評鑑 42 家（全部 A 級）	A 級比率 83.6%；無環境 / 勞動 / 人權 / 社會面重大負面影響供應商

2025 年 67 家受評供應商中，A 級供應商 56 家（83.6%），B 級 11 家，無任何 C 級或 D 級供應商。2025 年執行現場稽核 1 次、文件稽核 1 次，強化對重點供應商的直接管理深度，確認，在環境、勞動條件、人權及社會面向均未識別出任何造成重大負面影響的供應商。

5.3 責任商業聯盟（RBA）管理

精材公司於 2023 年通過 RBA 認證，確立公司在勞工、健康安全、環境、道德及管理系統五大面向的合規基準。公司以 RBA 行為準則為基礎，制定「供應商行為準則」，要求所有供應商遵循。

SAQ 自評問卷自 2019 年推行以來，已成為精材公司每年定期追蹤供應商 RBA 合規狀態的標準工具。

 勞工 Labour	● 禁止強迫勞動與童工 ● 保障結社自由與集體協商權 ● 工時管控（每週不超過 60 小時，加班須經員工同意） ● 薪酬不低於最低工資 ● 零歧視政策
 健康安全 Health & Safety	● 職業安全衛生管理系統持續驗證 ● 化學品安全資料表（SDS）完整建置 ● 緊急應變計畫每年演練 ● 廠護及職業醫學科醫師常態服務
 環境 Environment	● 環境管理系統持續驗證 ● 節能減廢 ● 廢水廢氣符合法規 ● 環保標章綠色採購推動
 道德 Ethics	● 誠信經營守則 ● 反貪腐政策 ● 檢舉人保護機制 ● 供應商禁止收受不當利益 ● 商業機密與客戶資料隱私保護
 管理系統 Management System	● SAQ 自評問卷： 自 2019 年啟動，每年要求主要供應商填報 ● QCDSS 永續面（S）評鑑： 納入 RBA 合規性檢查 ● 配合客戶稽查： 提供 RBA 相關文件

5.4 有害物質管理與綠色採購

半導體封裝製程使用大量化學品，精材公司從採購端嚴格管控危害物質，確保原材料符合國際環境法規，同時積極推動環保標章採購，落實公司對客戶與環境的責任。

RoHS / REACH 危害物質管控

精材公司嚴格遵守歐盟《電機電子設備危害物質限制指令》（RoHS）與《化學品登記評估授權限制法規》（REACH）要求，建立完整的原材料有害物質進料管控體系。所有第一類供應商均須提供材質安全資料表（SDS）、無鉛及無鹵素聲明書，並於採購合約中明定危害物質合規義務。

2025 年度進料檢驗未發現任何 RoHS 指定限制物質超標，亦無 REACH 高關注物質（SVHC）違規事件。精材公司同步建立化學品管理清單，確保製程中所使用的所有化學物質均有完整的風險控制措施與緊急應變資訊。

環保標章採購

精材公司積極落實綠色採購原則，優先採購具有行政院環境部「環保標章」認證之商品與服務，類別涵蓋辦公用品、清潔用品、包裝材料及節能設備等。2025 年度環保標章採購金額達 132,763,719 元，持續兌現公司的綠色消費承諾。



5.5 衝突礦產管理（責任礦產採購）

精材公司依循《責任礦產倡議》（Responsible Minerals Initiative, RMI）框架，落實責任礦產採購政策，確保供應礦物來源不涉及武裝衝突地區。公司要求所有金屬類原材料供應商每年填報「衝突礦物申報模板」（CMRT）及「延伸礦物申報模板」（EMRT），追溯礦物來源冶煉廠資訊。2025 年度擴展礦物報告模板（EMRT）新增石墨、鋰、銅和鎳等品項，進一步強化礦產溯源管理範圍。

申報類別	管理工具	2025 年合規狀態	說明
 有害物質管理	RoHS/REACH	 100% 符合	產品之 RoHS/Halogen & REACH 100% 符合；原物料 RoHS & REACH 100% 符合
 CMRT 礦物 (鈹、錫、金、鎢)	CMRT 申報模板	 100% 合規	原物料鈹、錫、金、鎢均 100% 合規，無使用衝突礦產
 EMRT 礦物 (鈷、雲母、石墨、鋰)	EMRT 申報模板	 100% 合規	原物料鈷、雲母、石墨、鋰均 100% 合規，無使用衝突礦產
 銅、鎳	EMRT 申報模板	 31% 合規	持續追蹤要求供應鏈提供合規物料，目標逐步提升至 100%



2025 年有害物質管理 & 衝突礦產管理成果

1) 有害物質管理：產品之 RoHS/Halogen & REACH 100% 符合；原物料 RoHS & REACH 100% 符合

2) 衝突礦產管理：2025 年擴展礦物報告模板（EMRT）新增石墨、鋰、銅和鎳

- CMRT：原物料之鈹、錫、金、鎢 100% 合規，無使用衝突礦產
- EMRT：原物料之鈷、雲母、石墨、鋰 100% 合規，無使用衝突礦產
- 銅、鎳 31% 合規，持續追蹤要求供應鏈提供合規物料。



5.6 在地採購優化

精材公司優先採購台灣在地供應商，一方面縮短供應鏈物流距離、降低碳排放，另一方面強化供應彈性，在面對全球供應鏈風險時能快速應變。在地採購也有助於支持本地製造生態系的發展，符合精材公司「強化夥伴合作關係，共同提升價值」的永續經營願景。

我們將「在地採購」定義為向台灣本地供應商採購之金額比率。2025 年在地採購比率達 80% 以上。此一比例達成主要反映關鍵製程材料在地供應鏈的持續深化，以及部分原先透過進口採購之材料，其供應商在台設立在地服務據點的成效。

提升在地採購比率不僅是成本與彈性的考量，也直接支持精材公司的碳管理目標——縮短物流里程有助降低運輸碳排放，符合公司「節能減碳 123 專案」的整體精神。精材公司持續評估現有進口原材料的在地替代可行性，並將在地採購比率納入採購部門年度績效追蹤指標。

5.7 供應鏈韌性與風險管理

精材公司的晶圓級封裝製程對特定化學品與材料高度依賴，若供應中斷將直接衝擊生產排程。公司建立多層次供應鏈風險管理架構，確保在面對地緣政治、天然災害、法規變動或單一來源依賴等風險時，能有效應變並維持營運連續性。



精材公司已建立「企業持續營運計畫 (BCP)」，明訂供應鏈中斷時的啟動條件、內部通報流程與替代採購程序。每年度至少執行一次供應鏈韌性評估，針對前十大採購品項進行單一來源風險審查，並將風險評估結果提報 ESG 執行委員會及相關業務部門。

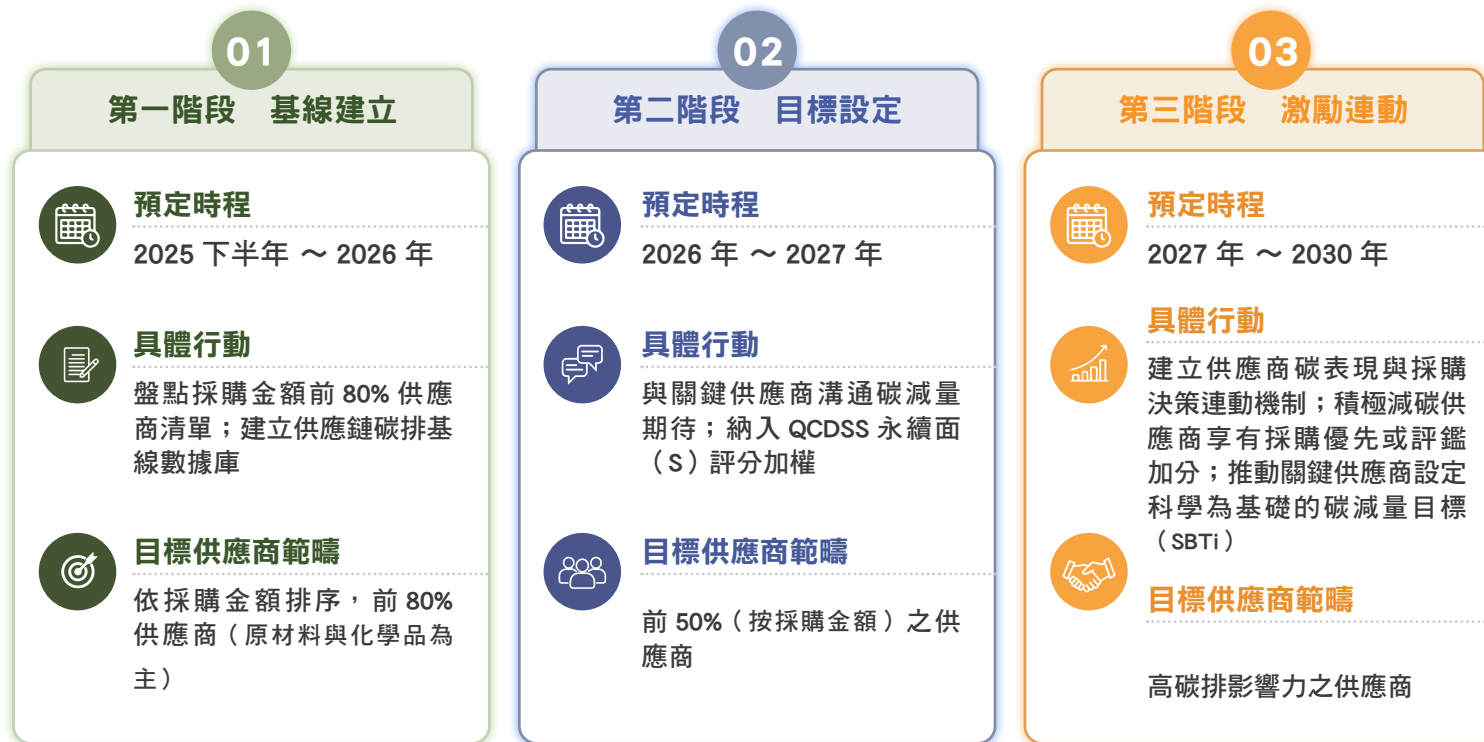


5.8 供應鏈碳管理規劃

隨著國際半導體客戶對供應鏈 Scope 3 碳排放揭露的要求持續升溫，以及台灣上市公司永續資訊揭露規範的強化，供應鏈上游碳排放（Scope 3 Category 1：採購商品與服務）已成為精材公司碳管理的重要延伸課題。

Scope 3 供應鏈碳排放管理路徑圖

精材公司目前的溫室氣體盤查涵蓋 Scope 1（直接排放）與 Scope 2（能源間接排放），並已通過外部查驗確信。供應鏈上游的 Scope 3 Category 1 排放尚未納入正式計算，為碳管理的重要改善空間。2025 年，採購部門與 ESG 執行委員會協作，正式啟動供應鏈碳排放基線調查的規劃工作。



5.9 目標規劃與未來展望

精材公司的永續供應鏈管理以「責任採購、有害物質管控、在地化深化、碳管理啟動、夥伴共成長」五大支柱持續推進，目標成為客戶信賴、供應商認同、社會肯定的負責任製造商。

精材公司的供應鏈是公司價值創造的起點，也是實踐「誠信、創新、客戶導向」核心價值的延伸舞台。面對半導體客戶對供應鏈 ESG 透明度的要求持續提高，以及台灣上市公司永續資訊揭露法規的逐步完善，精材公司將持續強化供應鏈的責任治理架構，以實際數據和可追蹤的成果，向客戶、股東及社會各界展現我們對永續供應鏈的長期承諾。

管理面向	2025 年成果	2026 年目標	2028 - 2030 年中期願景
 供應商評鑑	67 家完成 QCDSS 之永續 (S) 評鑑 A 級 83.6% 零 C/D 級	擴大至第一、二類全部供應商 永續面權重提升	評鑑覆蓋率 100% A 級比率目標 ≥ 90%
 新供應商 ESG 審查	16 家完成 ESG 審查 (39%)	持續執行新供應商 ESG 審查	深化新供應商 ESG 審查並建立電子審核系統
 衝突礦物管理	12 家金屬供應商 100% 合規申報	維持 100% 回覆率 擴大 EMRT 調查礦物種類	完善冶煉廠來源資料庫 優先與 RMI 認定冶煉廠供應商合作
 在地採購	在地採購比率達 80% 以上	維持在地採購比率 ≥ 80% 識別更多在地替代方案	策略性材料在地化持續深化 支持本地供應鏈生態系發展
 供應鏈碳管理	Scope 3 Cat.1 調查規劃啟動	完成前 80% 採購金額供應商碳排放基線調查	關鍵供應商設定減量目標
 ESG 能力培育	SAQ 問卷持續推行	辦理 2 場供應商 ESG 工作坊	供應商 ESG 自主管理能力全面提升



CHAP. 06

創新研發

- 6.0 重大主題管理方針
- 6.1 研發管理策略與投入
- 6.2 核心技術平台
- 6.3 專利佈局與智慧財產管理
- 6.4 永續導向的研發策略
- 6.5 未來展望與研發承諾

技術創新是精材公司的核心競爭力，也是企業持續成長的根本動力。作為全球晶圓級封裝（Wafer Level Packaging, WLP）領域的重要供應商，精材公司長期專注於先進封裝技術研發，持續拓展半導體元件在消費性電子、車用電子、5G 通訊、醫療、穿戴裝置及 AI 應用等領域的可能性。

2025 年，精材公司在研發投入上維持高度承諾。全年研發費用約新台幣 3.2 億元，占總營收比例達 4.5%，並持有 792 件有效專利（截至 2025 年底），彰顯公司在技術佈局與知識產權保護上的持續用力。新廠二期於 2025 年正式量產，測試業務上半年較去年同期大幅成長 47%，AI 與 CIS 等應用需求強勁，驅動公司技術持續演進。

對應聯合國永續發展目標 |

【SDG 9 永續工業與基礎建設】 【SDG 8 就業與經濟成長】

透過持續的研發投入、核心技術突破與完善的專利佈局，推動先進封裝技術創新，支持電子產業升級、促進高值就業，並將永續思維融入技術研發方向，實現「技術創新 & 永續發展」的雙贏目標。

6.0 重大主題管理方針

創新研發



議題範疇

涵蓋先進晶圓級封裝製程技術開發、專利申請與智慧財產權佈局，以及產學合作計畫推動。



潛在機會

- 先進封裝技術的研發突破，有助整體提升台灣半導體產業競爭力。
- 維持技術差異化是贏得先進客戶訂單、驅動中長期營收成長的核心動力。



2025 年度目標

- 每年投入約 4.5% 以上營收於研發經費
- 持續推動先進晶圓級封裝製程技術開發
- 累積專利數持續成長強化產學合作



潛在風險

- 技術發展若落後，可能導致市場份額快速流失，直接影響先進客戶訂單取得。
- 關鍵研發人才流失可能導致先進製程研發進度延宕與競爭力下滑。



管理政策依據

以「技術領先、持續精進、市場多元」為研發核心方針，透過系統化的研發管理、跨部門協作與產學研合作，持續強化技術競爭力，確保公司在全球先進封裝市場的領先地位。



2025 年度成果

- 持續推動先進晶圓級封裝製程技術（WLCSP、WLPI 等）開發
- 2025 年度研發費用約佔年度合併營收 4.5%
- 累積專利數持續成長，智財佈局穩健，年度新取得 22 件專利
- 持續強化與大學及研究機構的產學合作計畫



短期目標 (2026)



持續擴大先進製程研發專案量能



推動使用綠色封裝材料



中期目標

中期 2030



鞏固高階晶圓級封裝技術之領先地位



導入綠色製程研發



建立完善的技術專利護城河



對應 SDGs



SDG 9
永續工業與基礎建設

6.1 研發管理策略與投入

研發組織架構

研發組織下轄整合專案、模組專案及設計專案等。定期召開會議，評估研發進度、識別技術瓶頸，並與業務、生產及品質部門緊密協作，確保研發成果能有效轉化為量產能力。公司亦積極與國內大學建立產學合作平台，引入前瞻學術資源，縮短技術探索週期。

研發費用投入

年 度	研發費用 (新台幣百萬元)	占總營收比例
2024 年	412	5.84%
2025 年	323	4.5%

2025 年研發費用約新台幣 3.2 億元，占總營收 4.5%，反映公司在持續擴大產能與新廠建置的資本密集年度，仍維持穩健的研發投入水準。相較 2024 年之 5.84%，2025 年比例略有調整，主要係因總營收提升及部分研發工作進入量產準備階段，整體研發費用仍維持在業界具競爭力的水準。

研發人員

精材公司持續擴充研發人才隊伍，研發工程師具備半導體製程、材料科學、電子封裝及可靠性測試等多元專業背景。公司透過具競爭力的薪資結構、完善的內部訓練體系，吸引並留用優秀的研發人才，維繫公司在先進封裝技術領域的持續創新動能。

6.2 核心技術平台

精材公司長年深耕晶圓級先進封裝技術，涵蓋從消費性電子到高可靠性車用的解決方案。

晶圓級晶片尺寸封裝 (WLCSP)

晶圓級晶片尺寸封裝 (Wafer Level Chip Scale Package, WLCSP) 為精材公司的核心技術，適用於行動通訊、無線連結、生物辨識感測器及電源管理元件等廣泛應用場景。持續提升 WLCSP 製程良率、縮小凸塊節距 (Bump Pitch)，並開發超薄封裝解決方案，以因應行動裝置輕薄化趨勢。2025 年成功開發高階影像感測晶片，通過可靠度測試，進入試量產階段。SiP 是在同一封裝體內整合多顆異質晶片，實現更高的功能密度與更短的訊號路徑，廣泛應用於智慧型手錶、無線耳機、IoT 節點及工業感測器等多元場景。精材公司積極開發 SiP 晶圓級封裝能力，以支持客戶快速導入市場。

6.3 專利佈局與智慧財產管理

專利組合概況

截至 2025 年，精材公司累計持有 792 件有效專利，涵蓋台灣、美國、中國大陸、日本及德國等主要市場，充分保護公司在全球各主要業務地區的技術競爭優勢。

專利地區	持有件數	占 比
台 灣	294	37.1%
美 國	279	35.2%
中國大陸	209	26.4%
日 本	9	1.1%
德 國	1	0.1%
合 計	792	100%

年度新增專利

2025 年度，精材公司新取得 22 件專利，涵蓋台灣（10 件）、美國（7 件）、中國大陸（4 件）及日本（1 件），持續鞏固在核心技術領域的智慧財產保護。

智慧財產管理制度

精材公司設有專責的智慧財產管理機制，由法務暨智財部門統籌管理全球專利申請、維護及授權事務。公司制定《智慧財產管理辦法》，明訂專利申請流程、發明獎勵制度及保密義務，鼓勵研發人員積極提案，並定期進行專利有效性審查，評估非核心專利的維護效益，確保專利資產組合與公司技術策略保持高度一致。

此外，公司定期針對全球競爭對手的專利動態進行監控與分析，及早識別潛在專利障礙，並採取迴避設計、技術授權或主動佈局等因應策略，降低智慧財產糾紛風險，保障公司研發投資的長期回報。

6.4 永續導向的研發策略

精材公司深信，技術創新與永續發展並非對立，而是可以相互強化的力量。在規劃研發方向時，公司積極將永續思維融入技術選擇與創新目標，從產品生命週期視角評估研發成果的環境與社會影響。

綠色封裝技術

精材公司積極推動無鉛（Lead-Free）及無鹵素（Halogen-Free）封裝材料的開發與應用，符合歐盟 RoHS（限制有害物質指令）及 REACH 等國際環保法規要求。公司持續研究以環保材料替代傳統有害化學品，並在製程中導入低溫製程技術，以降低製造過程中的能耗與碳排放，為全球電子製造業的減碳目標貢獻力量。

節能元件技術支持

精材公司在 GaN 元件封裝技術上的突破，直接助益電源轉換效率的提升。高效能 GaN 功率元件的普及應用，可使充電器、電源供應器及電動車車載充電模組的能源轉換損耗降低，有效減少電力消耗，從終端產品使用端助力全社會碳中和目標。這一技術方向與公司支持 SDG 7（確保人人能夠取得可負擔、可靠、永續和現代能源）的承諾高度一致。

車用安全與可靠性研發

車用電子元件對可靠性的要求遠高於消費性電子，需通過車用可靠性認證。精材公司在車用 CIS-CSP 及相關封裝技術開發過程中，嚴格遵循 IATF 16949 品質管理系統要求，進行全面的高溫操作壽命（HTOL）、高溫儲存（HTS）、溫度循環（TC）及濕熱偏壓（HHB）等可靠性驗證，確保車用元件在極端環境下的長期穩定運作，支持自動駕駛系統的安全落地。

AIoT 與智慧製造應用

精材公司的先進封裝技術為 AI 晶片、邊緣運算模組及 IoT 感測節點的小型化與高效能化提供關鍵支撐。隨著 AI 手機、智慧家居及工業 IoT 應用快速擴展，對高整合度、低功耗封裝方案的需求持續成長。公司持續投入相關技術研發，以前瞻性的封裝創新推動整個電子生態系統的智慧化升級。

6.5 未來展望與研發承諾

展望未來，精材公司將持續深化在先進封裝技術領域的研發布局，以應對半導體產業在效能、尺寸、功耗與成本等多維度的挑戰。我們相信，唯有持續的技術創新與高質量的研發投入，方能在全球競爭激烈的先進封裝市場中保持領先。公司將以更積極的研發策略、更嚴謹的智慧財產管理，以及更深遠的永續發展視野，持續推動技術進步，為客戶、股東及社會創造長遠的共同價值。



CHAP. 07

環境永續發展承諾與實踐

- 7.0 重大主題管理方針
- 7.1 環境永續願景與環境管理系統
- 7.2 氣候變遷治理與 TCFD
- 7.3 能源管理
- 7.4 溫室氣體排放管理
- 7.5 水資源管理
- 7.6 廢棄物管理
- 7.7 物料管理與有害物質管理
- 7.8 環境永續短中長期目標

半導體封裝製造的每一道製程，都與能源、水、物料和化學品緊密相連。精材公司不迴避這份責任，而是選擇以透明的數據、系統化的管理，以及全員參與的行動文化，在追求業務成長的同時，堅持將環境保護列為企業經營的核心價值。

2025 年，面對新廠二期（Line C）擴產帶來的能資源使用挑戰，公司仍交出節電 1.72%、節水 5.13%、減廢 2.85% 三項超標的亮眼成績。這份成績的背後，是廠務工程師對每一度電、每一滴水的精準把握，是設備工程師在深夜排查每一個能耗異常點的堅持，也是整個組織對「永續共好」願景的共同承諾。

7.0 重大主題管理方針

氣候變遷與能源 管理方針



議題範疇

能源管理（節能、再生能源）、溫室氣體（GHG）盤查與查驗、氣候風險治理（TCFD 框架 / IFRS S2 揭露）、節能設備更新及廠區碳密度管理。



潛在機會

節能技術投資可降低電力成本、提升競爭力；再生能源採購強化 ESG 評等、吸引 ESG 導向投資人；低碳製程技術符合客戶低碳化需求，有助開拓新訂單。



2025 年度目標

- 以2024年
全公司用電量為基準
達成年度節電 1%
- 通過 ISO 14001:2015
/ ISO 50001:2018
外部驗證
- 2025 年
無造成環境污染違規
或遭客訴事件



短期目標（2026）

- 年度節能達 1.5%
- 完成 2025 年 GHG 盤查
第三方查驗並申報
- F-gases 處理設
備安裝率達 85%



對應 SDGs



SDG 7
可負擔的潔淨能源



SDG 13
氣候行動



潛在風險

碳費 / 碳定價（台灣 2026 年起開徵每噸 300 元）直接增加製造成本；GHG 盤查數據失準影響法規遵循與 ESG 評等；極端氣候事件（颱風、洪水、乾旱）可能導致廠區設施損壞、生產中斷及供應鏈中斷。



管理政策依據

- 環安衛手冊：遵守法令規範、推動資源再利用與污染防制，建立風險導向管理制度
- ISO 14001:2015 環境管理系統 / ISO 50001:2018 能源管理系統
- 環境部溫室氣體排放量盤查作業指引（113 年版）
- ISO 14064-1 溫室氣體盤查準則
- TCFD 氣候相關財務揭露框架 / IFRS S2 氣候相關揭露準則



2025 年度成果

- ✓ 節電成效達 1.72%（目標 1%），執行 8 項節能措施，總計節電 3.314 百萬度，目標達成率 172%
- ✓ 2025 年無造成環境污染違規或遭客訴事件
- ✓ 2025 年再生能源採購 2,988,095 度（較 2024 年增加 57.3%），佔總用電量 1.18%
- ✓ 通過 ISO 14001:2015 / ISO 50001:2018 外部驗證



中長期目標

短期 2030 | 長期 2050



範疇一、二排放量較基準年
（2015/2020 年）減少 15% 以上



再生能源使用佔公司
總用電量 7~15%



達成淨零排放
（Net Zero）

對應聯合國永續發展目標 |

【SDG 7 可負擔的潔淨能源】 【SDG 12 責任消費與生產】
【SDG 13 氣候行動】 【SDG 6 淨水與衛生】

透過氣候風險治理（TCFD / IFRS S2）、能源效率提升、水資源循環、廢棄物減量與物料管理，實踐精材公司「綠色製造、永續共好」的環境永續承諾。

績效亮點

● 節電率（目標 1%，達成率 172%）

1.72%

● 節水率（目標 3%，達成率 171%）

5.13%

● 廢棄物減量率（目標 2%，達成率 143%）

2.85%

● 再生能源佔比（購買量 +57.3% YoY）

1.18%

● 環境污染違規事件

0 件

環境永續與資源循環 管理方針



議題範疇

物料管理（非再生／再生物料比例）、有害物質管控（RoHS/REACH）、綠色供應鏈管理、廢棄物源頭減量及再生利用、循環經濟推動。



潛在風險

資源短缺影響產能；有害物質違規衝擊客戶信任與訂單；無法配合客戶 ESG 轉型要求導致供應鏈排擠；供應商不配合環境目標增加管理風險。



潛在機會

取得 ISO 及 RoHS/REACH 相關 ESG 認證提升企業形象，可爭取更多訂單；推動循環經濟吸引 ESG 導向客戶；帶動上下游供應商遵循 RBA 行為準則，強化整體供應鏈品質。



管理政策依據

- 環安衛手冊 / 綠色產品有害物質管理規定
- RoHS (限制有害物質指令) / REACH (物質登錄、評估、授權和限制法規) 合規標準
- 供應商環境管制物質保證書制度
- ISO 14001:2015 環境管理系統



2025 年度目標

- ✓ 以 2024 年廢棄物產生量為基準，達成年度廢棄物減量 2%
- ✓ 持續通過 ISO 14001:2015 外部驗證；維持有害物質零違規
- ✓ 持續推動再生物料比例提升，優化原物料循環利用



2025 年度成果

- ✓ 減廢成效達 2.85% (目標 2%)，執行 2 項減廢方案，總計減廢 30.1 公噸，達成率 143%
- ✓ 2025 年無有害物質違規事件
- ✓ 2025 年物料總用量 9,376.62 公噸，其中再生物料 148.64 公噸 (佔 1.59%)
- ✓ 廢棄物再利用量達 712.41 公噸



短期目標 (2026)

- ✓ 廢棄物減量 1%
- ✓ 持續零有害物質違規
- ✓ 推動再生物料比例逐年提升



中長期目標

短期 2030 | 長期 2050



含氟氣體 (F-gases)
處理設備安裝率達 100%



廢棄物再利用率持續提升



建立零廢棄排放
管理機制



對應 SDGs



SDG 12
責任消費與生產

水資源與廢棄物



議題範疇

製程超純水 (UPW) 管理、廢水回收系統優化 (廠務 / 製程 / 設備三面向)、廢棄物分類處置與合規管理。



潛在風險

台灣旱澇加劇威脅製程用水穩定性，可能導致停產損失；廢水廢棄物管理不當造成環保法規違規、環境污染及法律責任。



潛在機會

高效水資源管理降低運轉風險及自來水費用；完善廢棄物管理強化客戶信任與 ESG 評級；透過廢水再利用形成廠區內水資源循環，降低對外部水源的依賴程度。



管理政策依據

- 環安衛手冊 / 廢棄物清除處理全流程 SOP (識別、分類、收集、儲存、運輸、處置)
- 水污染防治許可證 / 定期水質檢測申報制度
- 依《事業委託清理之相當注意義務認定準則》篩選清除處理廠商，每年實地稽核
- 持續參與經濟部工業局「產業用水效能提升計畫」



2025 年度目標

- ✓ 以 2024 年自來水用量為基準，達成年度節水 3%
- ✓ 廢棄物清運 100% 合法並妥善處理；每季進行廢棄物儲存流程巡察
- ✓ 2025 年無造成環境污染違反環保法規事項



2025 年度成果

- ✓ 節水成效達 5.13% (目標 3%)，執行 3 項節水方案，於 2025 年度節水 4.452 萬噸，達成率 171%
- ✓ 廢棄物總量 1,145.07 公噸，全數委外合法處理，有害廢棄物 395.29 公噸持續下降
- ✓ 2025 年無造成環境污染違反環保法規事項；廢水處理符合水污染防治許可證放流標準



短期目標 (2026)

- ✓ 年度節水 1%
- ✓ 廢棄物減量持續優化
- ✓ 維持廢棄物清運 100% 合法



中長期目標

短期 2030 | 長期 2050



開發再生水 / 井水利用系統，降低自來水依賴



建立廠區內水資源完整循環系統



對應 SDGs



SDG 6
潔淨水與衛生



SDG 12
責任消費與生產

7.1 環境永續願景與環境管理系統

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 13 氣候行動】 【SDG 12 責任消費與生產】

環境永續願景

精材公司在追求業務成長的同時，始終將環境保護列為企業經營的核心價值，以實際行動展現對氣候變遷議題的重視，透過系統化的環境管理策略，確保所有營運活動都符合永續發展目標。公司秉持「預防勝於矯正」的原則，從製程設計、設備採購到廢棄物處置，每一個環節都納入環境衝擊評估，致力於成為業界環保實踐的標竿企業。

面對氣候變遷帶來的深遠影響，精材公司選擇積極擁抱而非被動應對。我們相信，一家能夠妥善管理環境風險、有效運用資源的企業，不僅能為股東創造長遠價值，更能為員工提供更永續的職場，為社區留下更潔淨的環境，為下一代傳遞更美好的地球。

ISO 14001:2015 環境管理系統

精材公司持續運行 ISO 14001:2015 環境管理系統逾十年以上，透過「規劃 (Plan) — 執行 (Do) — 檢查 (Check) — 改善 (Act)」

的 PDCA 循環，動態因應環保新趨勢，建立持續改善循環機制。定期接受外部驗證機構審核，確保管理系統的有效性與合規性。在人才培育方面，公司定期舉辦環保教育訓練，鼓勵員工提出改善方案，塑造全員參與的綠色企業文化，強化每一位同仁的環境責任認同。

環境目標管理方面，公司每年設定具體量化的環境目標，制定明確執行方案，內容涵蓋溫室氣體減排控制、能資源效率提升與廢棄物減量計畫。同時，建立涵蓋內外部相關者的暢通溝通管道，促進環保意識傳播，並強化供應鏈上下游合作，將環境管理的範疇延伸至整個價值鏈。

123 環境專案：精材公司的永續行動綱領

自 2016 年啟動的「123 環境專案」是精材公司環境永續行動的核心引擎，以「1% 節能、2% 減廢、3% 節水」為基礎目標，歷經近十年的持續深化，已發展成為一套完整的環境績效提升體系。該專案透過系統化的管理方法和技術創新，整合跨部門節能減碳專責團隊的資源，持續為公司創造顯著的環境與經濟效益。

2025 年度，123 環境專案再度交出亮眼成績：在能源面，透過空調系統優化、空壓機升級與 LED 照明汰換等 8 項具體措施，累計節電 3.314 百萬度，節電率 1.72%，超越目標 72%。在水資源面，透過

廢水回收系統優化與製程參數調整，累計節水 4.452 萬噸，節水率 5.13%，超越目標 71%。在廢棄物面，透過製程優化與廢水再利用轉化，累計減廢 30.1 公噸，減廢率 2.85%，超越目標 43%。

展望未來，123 環境專案將持續優化升級，以科學化、數據化的管理方法，配合政府 2026 年碳費開徵政策，修正節能目標為 1.5%，推動精材公司朝向「零廢棄、低排放」的永續願景邁進，並逐步建立全廠能耗即時監控平台，實現能源管理的智慧化轉型。

ISO 50001:2018 能源管理系統

精材公司導入 ISO 50001:2018 能源管理系統，以系統化方式持續檢視能源使用績效，設定明確節能目標與行動計畫，並透過定期內部稽核與外部審查，確保持續改善與能源使用最佳化，達到能源效率與營運永續的雙重目標。能源管理系統的運作涵蓋廠區空調 (HVAC)、空壓系統 (CDA)、照明系統、冷卻水塔及製程設備等所有主要能耗項目，透過即時監控與數據分析，精準識別節能改善空間。

7.2 氣候變遷治理與 TCFD

對應聯合國永續發展目標 | 【SDG 13 氣候行動】

精材公司深切體認到氣候變遷是全球刻不容緩的議題。自 2020 年起依循 TCFD 架構進行系統性氣候風險評估；2025 年起進一步對應 IFRS S2 準則，強化氣候財務揭露的完整性與可比較性。考量到公司半導體封裝製造的產業特性，生產過程中的大量能源消耗必然產生溫室氣體排放，加劇地球溫室效應。為符合全球將升溫控制在 1.5°C 內的目標，公司需積極採取行動，正視並把握氣候變遷帶來的風險與機會。因應台灣《氣候變遷因應法》的實施，已正式於 2025 年開始徵收碳費（每噸 300 元），發展再生能源與購置再生能源刻不容緩。

7.2.1 氣候治理架構與權責

精材公司依據氣候相關財務揭露框架（TCFD），系統性地評估氣候變遷對公司營運的潛在影響，並據此擬定相應策略，強化氣候財務風險與機會的量化分析，將氣候議題整合至公司策略規劃、風險管理與財務決策流程。公司近年成立溫室氣體管理執行小組，並經由風險管理委員會為核心，評估公司營運中潛在的氣候變遷風險、機會和財務影響。

董事會與高階主管共同肩負氣候治理的重責，負責制定並執行應對氣候變遷風險與機會的短、中、長期目標，並報告執行成果，確保氣候治理目標的實現。公司重視氣候資訊的透明度，主動揭露氣候相關資訊，接受外部檢視，彰顯推動氣候行動的決心，藉此建立永續經營的優勢。整體氣候治理層級為：董事會 → 風險管理委員會 → ESG 執行委員會 → TCFD 工作小組（年度執行）。

7.2.1 氣候治理架構與權責

管理核心	實際作為	具體成果
 治 理	將氣候變遷納入全面風險管理範疇，由董事會指派風險管理委員會定期報告；依據 ESG 議題改善生產流程與製程創新；董事會持續監控氣候議題動向並制定目標	1. 董事會定期審查 ESG 執行委員會提出的氣候風險與機會建議 2. ESG 執行委員會動態追蹤目標執行進度 3. 定期召開策略檢討會議並向董事會匯報
 策 略	◆ 採用 RCP2.6/SSP1-1.9（1.5°C 情境）與 IEA NZE（淨零情境）/ SSP5-8.5（最劣情境）模擬短中長期風險 ◆ 分析產業氣候風險並評估財務影響 ◆ 導入 TCFD 報告架構 ◆ 安裝尾氣削減設備 ◆ 制定氣候緊急應變計畫	1. 滾動調整再生能源採購策略 2. 建立系統化氣候韌性強化措施 3. 完成風險貨幣化分析
 風險管理	◆ 整合 ISO 14001:2015 管理系統於營運流程 ◆ 強化部門風險辨識能力 ◆ 建立風險評估程序與高風險議題管理機制 ◆ 制定風險機會指標與計畫 ◆ 定期執行廠區極端氣候風險評估	完成風險貨幣化分析與營收影響評估； 氣候實體風險納入重大客戶環境風險評估； 定期執行 BCP 演練
 指標與目標	◆ 執行溫室氣體盤查（範疇一、二）並通過第三方查驗 ◆ 監控廢棄物減量 / 水回收率 / 用電密度 ◆ 永續報告書揭露排放數據 ◆ 設定逐年減碳目標	1. 2025 年 GHG 排放總量 129,976 公噸 CO2e 2. 依環境部法令完成申報 3. 通過 2030 年再生能源使用佔比達 7~15% 的中期目標設定

7.2.3 氣候情境韌性評估

精材公司採用兩大氣候情境進行系統性分析，評估公司在不同升溫軌跡下的潛在財務影響與業務韌性。透過情境分析，公司得以識別不同時間軸下的關鍵風險與機會，制定具前瞻性的因應策略，並確保企業長期競爭力不受氣候變遷衝擊。

氣候情境	時間軸	主要假設參數	對精材公司的影響分析
 轉型風險 SBTi 1.5°C (SSP1-1.9)	2021-2030	◆ 台灣 2026 年開徵碳費（每噸 300 元） ◆ 實施 GHG 總量管制（超額須購買碳權） ◆ 再生能源強制採購比例提升 ◆ 供應商減碳能力成為採購決策重要標準	◆ 碳費開徵將直接增加製造成本 ◆ 法規遵循義務強化 ◆ 供應鏈低碳壓力加大
		 精材公司應對： 建立內部碳定價機制；加速節能設備更新；擴大再生能源採購；評估碳權購置；輔導供應商提升減碳能力。	
 轉型風險 IEA NZE（淨零情境）	2021-2040	2050 年達到淨零排放	投資綠色設備技術、調整生產方式、應對政策變化，以確保達成淨零排放目標。
 實體風險 IPCC AR6 SSP1-2.6 （理想減緩）	2080-2100	◆ 全球年均溫增加 1.0~1.8°C ◆ 台灣年均氣溫可能增加 1.3°C、1.4°C ◆ 高溫 36°C 以上日數增加約 6.8 日 ◆ 台灣平均年總降雨量增加幅度約 12%、16%	溫度上升： 空調用電量及成本上升；碳排放量增加；水電供應及原物料取得成本上升。 旱災： 台灣水資源匱乏可能影響製程用水穩定性；工業用水新增民生競用成本。 暴雨： 廠區均設有城市排水系統，但單日暴雨強度升高將可能導致交通中斷、設施損壞、生產中斷等問題。
 實體風險 IPCC AR6 SSP5-8.5 （最劣情境）	2080-2100	◆ 全球年均溫增加 3.3~5.7°C ◆ 台灣年最大連續不降雨日數約增加 12.4% ◆ 最大單日暴雨強度約增加 41.3% ◆ 強颱風比例增加 50% ◆ 台灣高溫 36°C 以上日數增加約 8.5 日、48.1 日	極端氣候事件頻率大幅提升： ◆ 廠房、設備損壞，供應鏈中斷風險顯著上升 ◆ 水資源極度匱乏可能導致停產 ◆ 空調能耗大幅增加使碳排放量上升 公司需建置更完整的防災設施並強化 BCP，將氣候變遷因素納入中長期投資決策。

7.2.4 氣候相關風險與機會矩陣

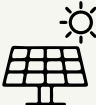
精材公司依 TCFD 工作小組評估結果，共識別出 10 個氣候相關高度風險及 2 個重大機會項目。以下為主要項目之財務影響及因應措施，並依實體風險、轉型風險及機會分類呈現：

類 型	項 目	時間軸	風險等級	財務影響	因應措施
 實體風險	極端氣候事件 (颱風 / 洪水)	立 即 性	高	◆ 廠房設備損壞 ◆ 生產中斷 ◆ 財產損失 ◆ 交通及供應鏈中斷	◆ 強化廠區極端氣候風險評估 ◆ 制定 BCP 與緊急應變計畫 ◆ 定期演練 ◆ 建立安全庫存備援機制 ◆ 設立防洪閘門及不斷電系統
	全球平均溫度持續上升	長 期	中高	◆ 空調用電量及成本上升 ◆ 碳排放量上升 ◆ 水電供應及原物料取得成本增加	◆ 持續節能措施降低電力成本 ◆ 強化廠區環境監測； ◆ 評估廠區建築隔熱改善
	旱災 (水資源壓力)	中至長期	高	◆ 製程用水供應不穩定 ◆ 工業用水新增民生競用成本 ◆ 可能致生產中斷	◆ 開發第二水源 (地下水 / 井水) ◆ 推動廢水回收再利用 ◆ 持續參與工業局用水效能提升計畫
 轉型風險	碳費 / 碳定價 (台灣 2026 年每噸 300 元)	短至中期	高	◆ 碳費直接增加製造成本 ◆ GHG 超額排放須購買碳權 法遵成本增加	◆ 建立內部碳定價機制 ◆ 加速節能減碳與設備更新； ◆ 評估購買碳權 ◆ 推動 GHG 目標管理
	GHG 排放總量管制	中至長期	中高	◆ 超額排放須購買碳權 ◆ 揭露義務加重法遵成本	◆ 擴大再生能源採購比例 ◆ 持續節能設備升級； ◆ 依 TCFD/IFRS S2 框架強化揭露
	低碳產品與供應鏈壓力	短至中期	中高	◆ 客戶要求提供產品碳足跡 ◆ 高碳供應商面臨採購排擠 ◆ 無法滿足要求流失客源	◆ 推動 GaN 節能元件封裝技術； ◆ 執行產品碳足跡查證 ◆ 輔導供應商提升減碳能力

類 型	項 目	時間軸	風險等級	財務影響		因應措施
 轉型風險	氣候資訊揭露要求	短期	中	◆ 揭露不足影響投資人信心及 ESG 評等 ◆ 強制揭露規範帶來法遵成本		◆ 依 TCFD/IFRS S2 框架強化揭露 ◆ 通過 GHG 第三方查驗 ◆ 年度更新風險機會矩陣
	再生能源政策要求	短至中期	中	◆ 採購綠電成本增加 ◆ 影響電力費用結構		◆ 評估太陽能等自建再生能源 ◆ 持續採購綠電憑證 ◆ 目標 2030 年達 7~15%
	國際公約 / 倡議規範	中至長期	中高	◆ 繳納碳稅 / 碳費造成營運成本上升 ◆ 各國強制揭露義務增加管理負擔		◆ 積極接軌國際倡議 ◆ 強化 ESG 資訊揭露品質 ◆ 訂定再生能源使用目標
	未符合國際氣候行動影響聲譽	短期	中	◆ 無法滿足利害關係人期待，影響企業聲譽進而影響銷售 ◆ ESG 評等下降影響股價		◆ 強化 ESG 資訊揭露 ◆ 設定再生能源使用目標 ◆ 發起產業鏈節能減碳專案
 氣候風險	節能技術投資（資源效率）	短至中期	—	◆ 節能設備及 AI 能源管理可降低電力成本 ◆ 提升能源使用效率 ◆ 優化廠務設施運轉		◆ 推動節能專案 ◆ 汰換老舊設備 ◆ 優化製程參數 ◆ 建置即時能源監控平台 ◆ 提高材料利用率
	低碳產品需求增長	中至長期	—	◆ 高效 GaN 元件、低功耗 WLCSP 等節能產品市場需求擴大 ◆ 配合客戶低碳化需求強化競爭力		◆ 深化 GaN 晶圓級背面鈍化等綠色封裝技術； ◆ 執行產品碳足跡查證 ◆ 實施資源回收 / 再利用

7.2.5 中長期減碳指標與目標

精材公司以低碳生產為核心策略，致力於永續發展。公司積極導入 ISO 50001:2018、ISO 14001:2015 等環境管理系統，建立溫室氣體盤查及查驗機制，並投入資源推動節能、節水、減廢等環保措施，從源頭實現清潔生產。公司經過審慎評估，將 2030 年再生能源目標設定為 7~15%，為務實可達的中期目標。在 TCFD 框架下，精材公司已完成以下行動：

推 動 策 略	2030 年階段目標	2050 年目標
 降低碳排 揭露範疇一、二、三排放數據，減少溫室氣體排放量	範疇一、二排放量較基準年減少 15% 以上	配合政府目標於 2050 年完成淨零排放
 能效提升 持續提升能源使用效率，以 ISO 50001 為基礎推動節能	與前年度能源使用效率相比提升 1.5%	與前年度能源使用效率相比持續提升 1.5%
 使用再生能源 採購綠電憑證，評估太陽能等自建方案	使用再生能源佔比達公司總用電量 7~15%	配合政府規定持續擴大
 含氟氣體削減 設置 Local/Central Scrubber 處理設備	F-gases 處理設備安裝率達 85%	處理設備安裝率達 100%
 碳抵減技術 評估購買碳權，建立碳管理制度	碳權機制建立	持續擴大導入碳抵減機制
 運用 TCFD/IFRS S2 情景分析，評估不同升溫情境下的風險，優化氣候策略	完成風險貨幣化並提升 ESG 揭露品質	達成淨零排放路徑

7.3 能源管理

對應聯合國永續發展目標【SDG 7 可負擔的潔淨能源】

精材公司為製程密集型半導體封裝廠，電力消耗為主要能源型態，公司不使用天然氣、重油等化石燃料作為直接能源。公司持續推動 ISO 50001:2018 能源管理系統，透過年度節能計畫、設備汰換更新及製程優化，系統性降低能源消耗密度。

2025 年新廠二期（Line C 擴產）進入試運轉階段，是公司發展史上的重要里程碑，然而這也帶來了顯著的能源使用挑戰，總用電量較 2024 年大幅增加約 31%，同期新廠尚未全面貢獻營收，致能源密集度呈上升趨勢。

面對這項挑戰，精材公司選擇主動出擊而非被動承受。2025 年，廠務與設備工程師團隊攜手執行 8 項具體節能方案，涵蓋空調系統優化、空壓機升級、LED 照明汰換及冷卻水塔節能改善等面向，總計節電 3.314 百萬度，以 2024 年全公司用電量為基準計算，節電比例達 1.72%，超越年度目標 1%，達成率高達 172%。每一度節省下來的電，不只是成本的降低，更是對地球碳排放的直接貢獻。

年度能源消耗統計

能源類型	單位	2023 年	2024 年	2025 年	說明
 外購電力（一般）	度	179,606,289	190,828,157	249,373,430	一般電力消耗（含發電機使用的柴油當年度購買量換算發電量）
 再生能源（綠電）	度	1,890,082	1,900,000	2,988,095	+57.3% YoY 佔比 1.18%
 電力合計	度	181,496,371	192,728,157	252,361,525	新廠擴產帶動用電增加
再生能源佔比	%	1.04%	0.99%	1.18%	中期目標：2030 年達 7~15%
 能源消耗量	GJ	653,386.94	693,821.37	908,501.49	1 度電 = 0.0036 GJ
 總營收	NT\$ 百萬	6,387	7,060	7,239	合併財務報表
 能源密集度	GJ/ 百萬營收	102.3	98.3	125.5	新廠試運轉致密集度上升
 百萬營收單位用電量	kWh/ 百萬	28,417	27,299	34,861	YoY: +27.70%（含新廠影響）



- 備註
- 2025 年新廠二期測試運轉期間尚未全面貢獻營收，導致能源密集度上升為 125.5 GJ/ 百萬營收，較 2024 年上升。
 - 能源係數依據經濟部能源署公布之資料換算（1 度電 = 0.0036GJ）。
 - 2025 年公司總能源消耗 908,501.49 GJ；外購電力（一般 + 綠電）：908,481.6 GJ；柴油（緊急發電機）：19.89 GJ。

2025 年節能措施成效

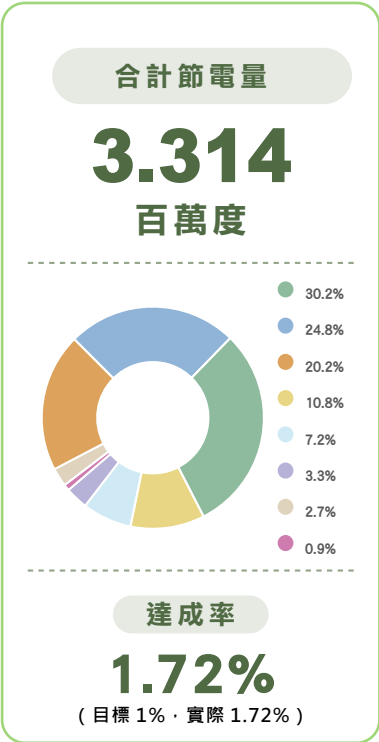
本年度節能改善計畫涵蓋 Line A、Line B 及 Line C 三座廠區，體現整個生產基地對節能目標的共同投入。各項措施均依據「日均用電量差異法」量化節電成效，確保數據的客觀性與可查核性。尤其值得一提的是，Line C CDA 空壓機 #2 升級為高效節能機型，單項貢獻節電 0.999 百萬度，佔總節電量的 30.2%，顯示設備汰換更新策略在節能減碳上的顯著效益。

再生能源採購與中長期目標

公司持續增購再生能源（綠電憑證），2025 年採購再生能源達 2,988,095 度，較 2024 年大幅增加 57.3%，佔全年總用電量的 1.18%，創下歷年新高。每一張綠電憑證，代表著一度來自太陽能或風力等再生能源發電設施的清潔電力，讓精材公司的產品更加綠色，也讓客戶在採購時更有底氣標榜供應鏈的低碳性。2026 年再生能源採購目標預計更達 940 萬度，較 2025 年增購 640 萬度，預計再生能源佔比進一步提升。

公司中長期目標為 2030 年前，再生能源使用佔比達公司總用電量 7~15%，此一目標係經過審慎評估台灣再生能源市場發展趨勢、自建太陽能設施可行性以及公司財務規劃後所設定的務實目標。未來將視台灣再生能源市場發展及自建太陽能設施可行性，結合政府政策導向，持續擴大再生能源比例，朝向低碳電力結構邁進。

節能措施	量化方法	廠區	節電量 (百萬度)	佔比
Line-B Major HVAC Power Reduction (空調主機節能優化)	規格估算法	Line B	0.821	
Line-C CDA 空壓機 #2 升級節能機型 (高效變頻空壓機)	規格估算法	Line C	0.999	
Line-C C/R 照明全面改為 LED 節能燈具	規格估算法	Line C	0.357	
Line-C C/T 冷卻水塔 #3/#4 扇葉更換節能高效扇葉 (#5~#9)	規格估算法	Line C	0.239	
Line-A CDA 乾燥機 #03 停用 (設備精簡化)	規格估算法	Line A	0.108	
Line-AB 水塔風扇節能改善工程	規格估算法	Line A/B	0.031	
Line AB 其他節能項目 (系統優化、製程調整等)	規格估算法	Line A/B	0.091	
Line C 其他節能項目 (廠務系統整合優化)	規格估算法	Line C	0.668	



備註

2025 年節電措施合計節電量 3.314 百萬度。(減少能源消耗量 11,930.4 GJ)

7.4 溫室氣體排放管理

對應聯合國永續發展目標 | 【SDG 13 氣候行動】

精材公司自 2012 年起每年依據環境部發布之氣候變遷及溫室氣體排放管理相關法令，針對環境部列管廠區所有溫室氣體排放源執行年度盤查，並通過第三方外部查驗機構（立恩威驗證股份有限公司）查證，取得溫室氣體排放量查證聲明書，確保數據品質與透明度。盤查依據環境部溫室氣體溫室氣體排放量盤查作業指引界定邊界，採「營運控制權法」界定邊界，涵蓋中壢廠（Line A）、中壢二廠（Line B）及中壢三廠（Line C）。排放係數引用環境部最新公告係數，電力排碳係數採用經濟部能源署公布年度係數（2024 年為 0.474 kgCO₂e/度）。

在基準年設定方面，中壢廠及中壢二廠因法令規範執行溫室氣體排放量盤查，選定 2015 年為基準年；中壢三廠因於 2020 年新增溫室氣體排放源，重新選定 2020 年為基準年。透過持續強化 F-gases 含氟氣體處理設備的安裝率，公司範疇一直接排放量已從 2022 年的 55,077 公噸 CO₂e 大幅削減至 2025 年的 12,021 公噸 CO₂e，降幅高達 78.2 %，充分展現技術手段在減碳路徑上的核心地位。另公司有部分辦公室區域非屬工廠登記地址，其 2025 年溫室氣體排放量為 245 tons-CO₂e。

範疇一、二排放統計

項 目	單 位	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	說 明
 直接排放（範疇一）	公噸 CO ₂ e	55,077	30,025	13,857	12,021	2025 年 減少 1,836 公噸 CO ₂ e 
 能源間接排放 - 地點基礎（範疇二）	公噸 CO ₂ e	92,965	89,401	91,102	119,371	2025 年 增加 28,269 公噸 
 能源間接排放 - 市場基礎（範疇二）	公噸 CO ₂ e	92,965	88,468	90,202	117,955	2025 年 增加 25,917 公噸 CO ₂ e 
 排放總量 - 地點基礎（範疇一 + 二）	公噸 CO ₂ e	148,042	119,426	104,959	131,392	2025 年 增加 26,433 公噸 CO ₂ e 
 排放總量 - 市場基礎（範疇一 + 二）	公噸 CO ₂ e	148,042	118,493	104,059	129,976	2025 年 增加 25,917 公噸 CO ₂ e 
 GHG 排放密集度 - 地點基礎（範疇一 + 二）	公噸 CO ₂ e/ 百萬營收	19.15	18.70	14.87	18.16	較去年上升 3.29 
 GHG 排放密集度 - 市場基礎（範疇一 + 二）	公噸 CO ₂ e/ 百萬營收	19.15	18.55	14.74	17.96	較去年上升 3.22 

範疇三排放統計

精材公司自 2023 年起自行進行範疇三溫室氣體盤查，涵蓋 5 個重要排放類別，計算排放係數引用台灣環境部碳足跡資料庫及美國 GZA Scope 3 Calculator（美國環境投入產出模型）。2025 年範疇三合計排放量為 38,506 公噸 CO₂e，較 2024 年增加 30.2%，增加主因為 2025 年與能源相關活動的排放（類別 3，27,866 公噸 CO₂e）增加。目前範疇三盤查尚未進行第三方查驗，公司計畫在累積更完整的數據後，逐步強化查驗範圍。

類 別	排放類別說明	2024 年 (公噸 CO ₂ e)	2025 年 (公噸 CO ₂ e)	排放係數來源
 類別 1	購買商品或服務產生的排放	9,741	9,583	美國 GZA Scope 3 Calculator
 類別 3	與燃料和能源相關活動的排放	18,934	27,866	台灣環境部碳足跡資料庫
 類別 5	營運產生廢棄物的處置排放	238	308	台灣環境部碳足跡資料庫
 類別 7	員工通勤產生的排放	609	692	台灣環境部碳足跡資料庫
 類別 9	下游運輸和配送產生的排放	52	57	台灣環境部碳足跡資料庫
合 計	2024 年 (公噸 CO ₂ e) 29,574	2025 年 (公噸 CO ₂ e) 38,506	尚未進行 外部第三方查驗	

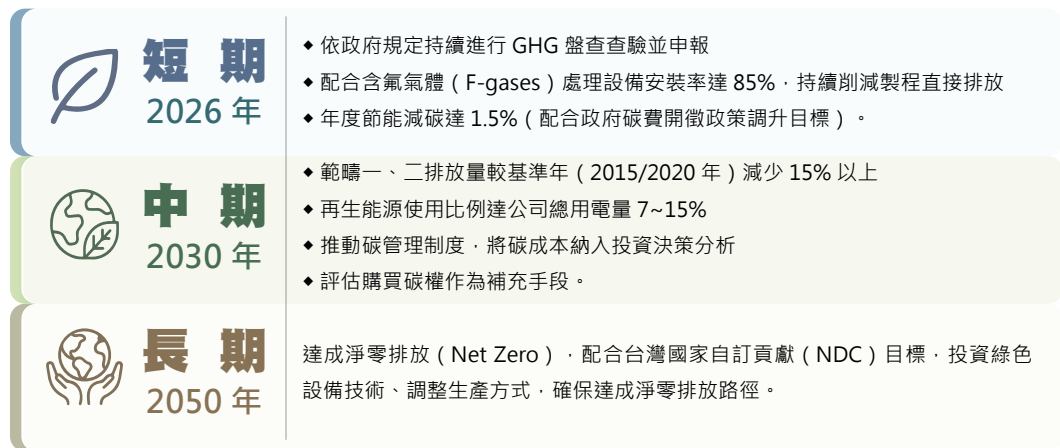
2025 年節能減碳成效

2025 年各項節能措施共計節電 3.314 百萬度，相當於間接減少溫室氣體排放約 1,571 公噸 CO₂e。此一減碳成效係透過製程改善、設備升級及系統優化等不涉及碳抵換的實質減碳行動所達成，充分體現精材公司在能源效率提升上的持續投入與成效。

精材於 2025 年採購太陽能再生能源憑證，採購近三百萬度再生能源，可減少約 1,416 tons-CO₂e 碳排放量

備 註 | 以 2024 年度台電電力排碳係數 0.474 kg CO₂e / 度估算

減碳目標與實現路徑



廢氣排放與環境共榮管理

本公司一向重視營運過程對周遭環境與空氣品質的影響，各廠區皆設有密閉式廢氣收集系統與高效能防制設備（如蓄熱式焚化爐、洗滌塔）。所有排放管道均定期委託第三方公正機構檢測，確保各項空氣污染物排放濃度 100% 低於法定固定污染源空氣污染物排放標準。本年度未發生任何因空污引起的裁罰或環境違規事件。

為深化落實 ESG 資訊透明度並擴大資訊揭露範疇，本公司於本年度（2025 年）報告書中「首度對外公開」揭露 NOx、SOx 及 VOCs 之年排放總量。為了讓利害關係人能更客觀評估本公司的環境管理績效，我們一併回溯並完整呈現過去三年（2023-2025 年）的歷史排放數據，並持續追蹤。

空氣污染物種類之年度排放量



計算方法

1. 公告之排放係數及控制效率，計算污染物排放量。
2. 質量平衡法。

7.5 水資源管理

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 6 淨水與衛生】【SDG 12 責任消費與生產】

半導體封裝製程需使用大量超純水（UPW）進行晶圓清洗，這是確保產品品質不可或缺的關鍵資源。水資源管理因此成為精材公司環境永續管理的核心議題之一，公司為此投入大量人力與物力，致力於提升每一滴水的使用效率。公司主要水源為石門水庫供應之自來水（佔 2025 年取水量 88.61%），廠區並非位於國際認定之高水壓或極度缺水地區（依 WRI Aqueduct 評估工具），然而考量台灣近年氣候變遷下旱澇不均的風險日益上升，包括石門水庫集水區降雨變異性增加、極端乾旱事件頻率提高等，公司依然積極強化水資源管理，自 2012 年起持續參與經濟部工業局「產業用水效能提升計畫」。各廠區放流水均納管至中壢工業區污水處理廠，水質均依污水處理廠進廠標準管控：水溫 42℃ 以下，氫離子濃度 (pH)：5.0~9.0，生化需氧量 (BOD) 小於 320mg/L，化學需氧量 (COD) 小於 480mg/L，懸浮固體 (SS) 小於 320mg/L，每月由污水處理廠派員進廠取水樣化驗兩次。廠內並自設監測儀器有：pH sensor、氟離子 sensor、懸浮固體 (SS) sensor 監控水質。

2025 年新廠二期試運轉期間，總取水量提升至 1,006.383 百萬公升，較 2024 年增加 16.2%，主要反映了新廠產線啟動的實際需求。然而，節水工程師團隊並未因此放棄節水努力，透過廢水回收系統優化、製程參數調整及設備升級等 3 項具體方案，實際節水 4.452 萬噸，佔 2024 年總取水量的 5.14%（係以 2024 年用水量為基準，計算 2025 年節水措施的節水比例），不僅超越年度目標 3%，更展現了在規模擴張過程中仍能有效管控水資源使用效率的組織能力。

年度取水量統計



地下水

單位：公噸

2023 年	2024 年	2025 年
122,709	72,356	114,621

佔比：8.36% → 11.39%



合計取水量

單位：公噸

2023 年	2024 年	2025 年
910,011	865,885	1,006,383

較 2024 年增加 16.2%。主因 Line C 新廠二期試運轉。年度增量主要來自地下水 (+58.4%) 及自來水 (+12.4%) 。



用水密集度

單位：公噸 / 百萬營收

2023 年	2024 年	2025 年
274.3488	246.3515	262.5900

(自來水 + 井水 + 廠內回收水產水量)/ 百萬營收



第三方取水（自來水）

單位：公噸

2023 年	2024 年	2025 年
787,302	793,529	891,762

石門水庫供水；非高水壓區



廠內回收水產水量

單位：公噸

2023 年	2024 年	2025 年
842,255	873,357	894,506

廠內自行設置回收水系統將製程廢水再利用

2025 年節水措施成效

節水工作小組將節水工作分解為廠務（Reclaim+Reduction）、製程（Reduction）及設備（Reclaim）三大執行面向，廠務端重點在於減少廠務系統排水損失及增加廢水回收；製程端透過機台用水量流量盤查及製程參數最佳化；設備端則聚焦機台廢水採樣分析與再利用。三面向協同推進，確保水資源效率管理覆蓋廠區所有用水環節。

節水方案	廠區	節水量 (萬噸)	機制說明
Line-B AWR ROR 廢水回收系統優化	Line B	3.739	廢水回收再利用，減少新取水需求
Line-C UPW DMF 過濾單元運轉參數優化 (產水時間從19hrs延長至24hrs)	Line C	0.153	製程參數調整，提高水資源產出效率
Line-C 回收水系統濾材 (活性碳、RO膜管) 更換後運轉優化，節省冷卻水	Line C	0.560	設備升級帶動系統效率提升
合計節水量	全廠	4.452	以2024年用水量為基準，占比5.14%

7.6 廢棄物管理

對應聯合國永續發展目標 | 【SDG 12 責任消費與生產】

精材公司的廢棄物主要產生於晶圓封裝製程中，涵蓋含化學品之有害廢棄物（如有機廢液、含重金屬廢液等）及一般事業廢棄物（如廢容器、廢包材等）。公司建立涵蓋廢棄物「識別、分類、收集、儲存、運輸、處置」全流程的標準作業程序（SOP），嚴格落實有害廢棄物合規管理。廢棄物管理策略以「源頭減量→循環再利用→合規處置」為優先順序，持續推動循環經濟，降低廢棄物對環境的衝擊。

2025 年因新廠二期試運轉，廢棄物總量較 2024 年增加至 1,145.07 公噸；在量增的挑戰下，減廢工程師透過製程優化與廢水再利用轉化，共計減廢 30.1 公噸（佔 2024 年廢棄物量 2.85%），節廢成效超越年度目標 2%，達成率 143%。

值得特別說明的是，有害廢棄物產生量已從 2022 年的 573.1 公噸降至 2025 年的 395.29 公噸，顯示長期製程改善與 F-gases 削減措施帶來的持續性效益。2025 年廢棄物再利用量達 712.41 公噸，透過精細的分類回收與廠商協作，最大化資源價值的循環再利用。

類別	單位	2022 年	2023 年	2024 年	2025 年	說明
 有害廢棄物	公噸	573.1	440.73	404.02	395.29	持續下降，GRI 306-3
 一般廢棄物（無害）	公噸	551.8	605.04	651.93	749.78	新廠試運轉致增加
 廢棄物合計	公噸	1,124.9	1,045.77	1,055.95	1,145.07	全數委外合法處理
 廢棄物密集度	公噸 / 百萬營收	0.145	0.1637	0.1496	0.1582	YoY：+5.75%（含新廠）

▲ 年度廢棄物統計

2025 年廢棄物處理方式明細



2025 年減廢方案成效



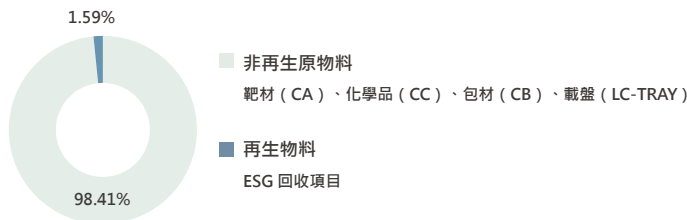
7.7 物料管理與有害物質管理

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 3 良好健康與福祉】【SDG 12 責任消費與生產】

精材公司的晶圓封裝製程需使用多種靶材、化學品、包材及載盤等物料，物料管理的良窳不僅直接影響產品品質，更關係到製程對環境與人體健康的潛在影響。公司建立完整的物料管理體系，在採購、使用、追蹤到廢棄的全生命週期中，確保每一項物料都符合國際環保法規要求，並積極推動再生物料的使用比例。

2025 年物料消耗統計

物料類別	原物料品項	2025 年用量 (公噸)	佔比 (%)	GRI 指標
非再生 原物料	靶材 (CA)、化學品 (CC)、 包材 (CB)、載盤 (LC-TRAY)	9,227.98	98.41%	GRI 301-1
再生物料	ESG 回收項目	148.64	1.59%	GRI 301-2
物料合計	靶材 CA / 化學品 CC / 包材 CB / LC-TRAY	9,376.62	100.00%	全廠區統計



2025 年度，精材公司全廠物料總用量為 9,376.62 公噸，其中再生物料（ESG 回收項目）148.64 公噸，佔比 1.59%。公司設定再生物料比例逐年提升的中長期目標，積極評估各類原物料的可回收替代方案，並與供應商協作開發更環保的物料選項，以實現製程對環境衝擊的系統性降低。

有害物質管理制度

管理政策與法規遵循

為降低製程與產品對環境及生態系統的影響，並響應國際環保法規與利害關係人對企業永續責任的期待，精材公司持續強化有害物質管理制度。每年依據最新國際法規（包含歐盟 RoHS 指令、REACH 法規等）、客戶要求與產業趨勢，定期檢視並更新《綠色產品有害物質管理規定》，確保公司在產品開發、製造及供應鏈管理中全面落实環境友善的原則。2025 年，無任何有害物質違規事件，所有產品均符合客戶規範要求。

採購端管控：供應商環境管制物質保證書制度

在原材料與零件採購階段，精材公司要求所有供應商提供「環境管制物質保證書」，以確認所採購材料符合歐盟 RoHS、REACH 等國際環保規範的要求。此一制度要求採購前完成材料成分確認，從交易的源頭建立起有害物質管控的第一道防線。同時，公司亦持續更新禁用物質清單，確保管控標準與國際法規保持同步，並對於新開發的供應商或新物料品項，執行嚴格的導入審查程序。

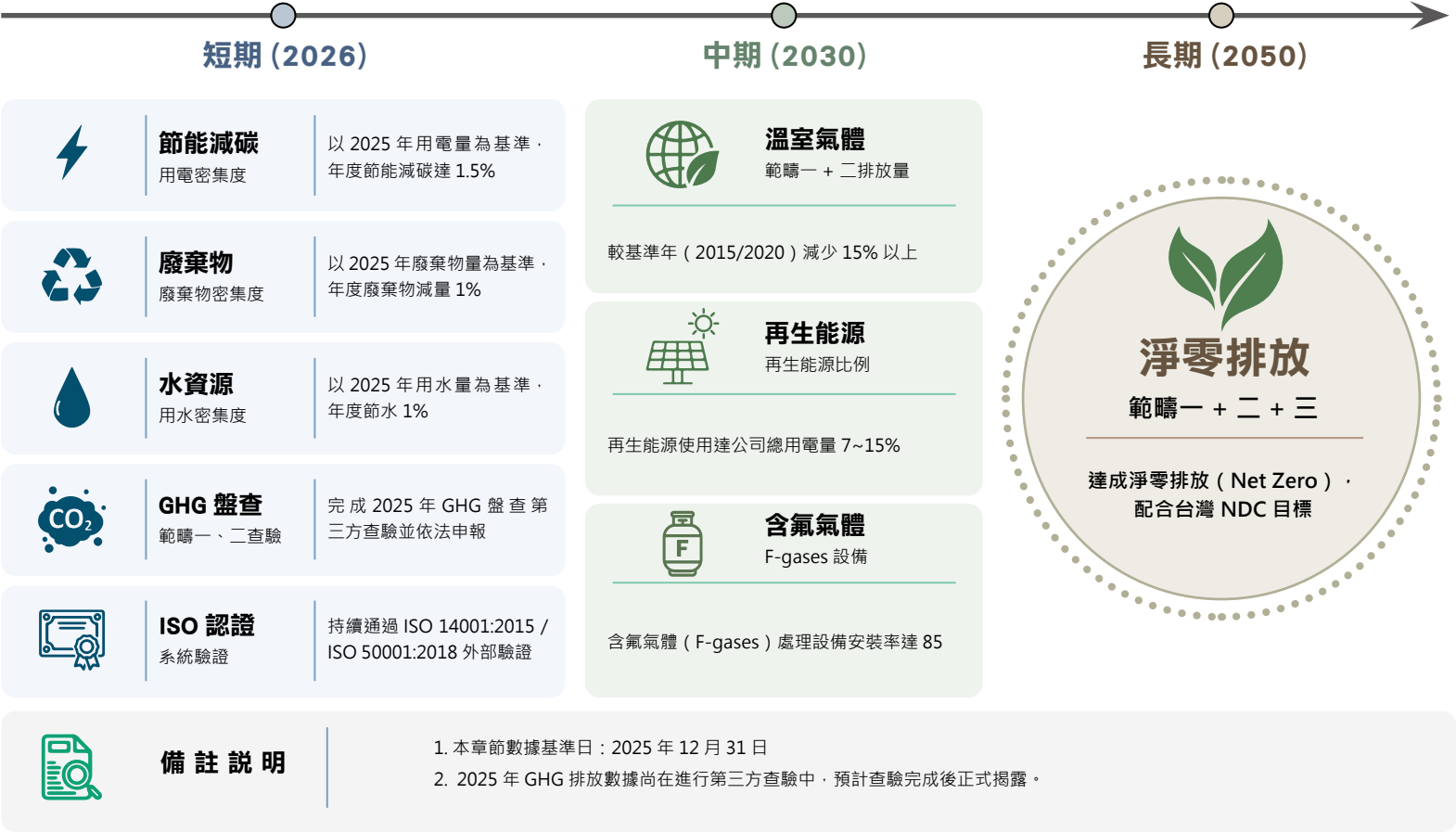
供應商管理制度

精材公司制定完整的供應商管理規範，明確規範其所提供的原物料、零件與包裝材料須符合本公司採購準則與客戶要求，落實源頭控管，有效防範污染與危害。公司推動與供應商的協作關係，不僅要求符合現行法規，更鼓勵供應商主動開發更環保的替代方案，攜手共同建構覆蓋整個供應鏈的綠色管理體系。透過年度供應商環保績效評核，公司能夠持續掌握供應鏈的有害物質管控成熟度，並提供改善輔導建議，共同保護土壤、空氣與水資源不受有害物質污染，實踐企業對地球環境的守護承諾。

2025 年，公司持續執行定期供應商有害物質合規稽核，確保所有進料符合 RoHS 及 REACH 規範要求。透過建立完善的供應商材料數據庫，實現有害物質追蹤的數位化管理，進一步提升管控效率與可靠性。

7.8 環境永續短中長期目標

精材公司依循 GRI 準則及 TCFD/IFRS S2 框架，建立可量化、可追蹤的環境永續目標體系。2025 年三大環境目標均超標達成後，公司已依據政府碳費開徵政策及內部審慎評估，調整 2026 年節能目標至 1.5%、廢棄物及節水目標調整至 1%。以下為 2026 至 2050 年完整分項目標：





CHAP. 08

員工關懷與人才發展

- 8.0 重大主題管理方針
- 8.1 人力資本結構與多元共融
- 8.2 人才招聘、流動與育嬰友善
- 8.3 員工幸福：薪酬、福利與日常關懷
- 8.4 人才培育與學習發展
- 8.5 勞資關係、人權與申訴機制
- 8.6 短中長期目標展望

精材公司成立二十餘年，走過半導體封裝技術的每一個關鍵轉折，我們深知這一切的背後，是數千位員工日復一日的努力與堅持每一次客戶好評背後，是品保工程師反覆確認的眼神與職業堅持。正因如此，精材公司始終將「以人為本」視為最根本的經營哲學——不是口號，而是日常每一個決策的起點。

2025 年，公司持續推動平等的職場文化，深化學習型組織建設，並盡所在員工福利、薪酬制度與溝通機制上持續精進。面對新廠區（Line C）擴建帶來的組織成長，我們更加意識到：唯有讓每位員工感到被重視、被支持、被看見，企業才能穩健前行、邁向永續。

對應聯合國永續發展目標

【SDG 4 優質教育】 【SDG 5 性別平權】
【SDG 8 就業與經濟成長】

透過完善的教育訓練體系、具競爭力的薪酬福利、多元共融的用人哲學，以及暢通的勞資溝通機制，讓每位員工在安全、受尊重的環境中成長，共同實現企業永續發展。

8.0 重大主題管理方針

精材公司依循 GRI 3-3 要求，針對本章涵蓋的「人才發展與留任」及「勞資關係與人權」兩大社會類重大主題，建立以下標準化管理方針架構。每項方針均明確界定議題範疇、潛在風險與機會、管理政策依據、年度目標、成果達成情形，以及短中長期目標，確保揭露具備一致性、可比較性與完整性。

人才發展與留任 負責單位：人力資源部門



議題範疇

教育訓練體系規劃與執行、績效考核制度、晉升管道建立、薪酬福利競爭力、員工流動率管理。



潛在機會

完善的人才培育計畫可提升員工專業技能與企業競爭力，促進生產效率與創新研發，強化組織韌性與長期人力資本價值。



潛在風險

人才流失削弱技術傳承能力；培育計畫未能滿足員工需求，增加關鍵職位空缺風險；證照管理疏失引發法規違規風險。



管理政策依據

- 教育訓練管理程序（內部辦法）
- RBA 責任商業聯盟行為準則
- 績效考核辦法（涵蓋全體正職員工）



2025 年度目標

✓ 年度員工人均
教育訓練時數 ≥ 11 小時

✓ 由人資單位統籌規劃新進、
在職、管理與依公司策略
整合資源辦理

✓ 定期進行
員工知識技能盤點



2025 年度成果

✓ 年度總訓練時數 24,625.6 小時，人均 15.99 小時，超越目標 45.4%（目標 11 小時）

✓ 管理職內部晉升比率維持 100%；年度訓練總
費用 859,669 元，人均 558 元

✓ 全員績效考核完成率 100%，涵蓋所有通過試
用期正式員工



短期目標 (2026)

✓ 人均訓練時數 ≥ 12 小時



RBA 相關課程參與率 ≥ 80%；新人訓練完訓率 100%



中期目標

中期 2030



每年定期員工知識
技能盤點



RBA 課程參與率 ≥ 90%



對應 SDGs



SDG 4
優質教育



SDG 8
就業與經濟成長

2025 年度人才關懷績效亮點

● 期末正職員工	● 人均年度訓練時數
1,540 人	15.99 小時
● 績效考核覆蓋率	● 人權申訴案件
100%	0 件
● 年度新進員工	● 整體離職率
262 人 新進率17.6%	11.0% 自願10.4%
● 勞資會議	● 員工意見件數
4 次 每季一次	27 件 全數處理完畢



議題範疇

勞資會議制度、員工申訴管道、結社自由保障、人權盡職調查 (依 RBA VAP 標準) 禁止強迫勞動及童工。



潛在機會

建立和諧勞資關係可提升組織凝聚力、降低流動率；完善的人權治理有助通過客戶 ESG 稽核。



2025 年度目標

- ✓ 每季舉辦勞資會議 1 次 (全年 4 次)
- ✓ 員工申訴意見即時回饋與處理處理率 ≥ 95%
- ✓ 每季進行法規鑑別 1 次
- ✓ 職場性別平等零歧視零騷擾



2025 年度成果

- ✓ 全年勞資會議共舉辦 4 次 (人次：75)，員工溝通大會 8 場次 (人次：2,215)，議題涵蓋班時班制、福利活動及工作環境改善
- ✓ 接獲員工意見 27 件 (管理溝通 15 件、環境溝通 8 件、團膳 3 件、鼓勵 1 件)，全數依辦法處理完畢；無人權申訴案件
- ✓ 法規列管共 113 條，無違規事件；職場不法侵害問卷調查完成率 100%，申訴個案 0 件



短期目標 (2026)



勞資會議每年 4 次



溝通管道暢通



法規符合率 100%



中期目標

中期 2030



維持零人權申訴案件



對應 SDGs



SDG 5
性別平權



SDG 8
就業與經濟成長



SDG 16
制度的正義與和平

勞資關係與人權



潛在風險

若勞資溝通機制不暢，可能引發勞動爭議與法規違規；人權政策執行不足將影響客戶信任度及 RBA 稽核結果；缺乏有效申訴管道可能造成員工不滿累積。



管理政策依據

- 人權政策聲明
- 工作規則 (含禁止強迫勞動及童工條款)
- 招聘僱管理辦法
- 員工意見反應與申訴辦法
- 禁止工作場所性騷擾聲明
- 禁止職務遭受不法侵害聲明

8.1 人力資本結構與多元共融

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 5 性別平權】 【SDG 10 減少不平等】

精材公司致力於多元 (Diversity)、公平 (Equity)、共融 (Inclusion) 的職場環境，從人力組成到日常管理，確保每位員工平等受到重視與尊重。

截至 2025 年 12 月 31 日，精材公司全職員工共計 1,540 人，較 2024 年底淨增 95 名，體現公司業務穩健擴展，特別是 Line C 新廠區的逐步投入運作。員工組成以工程與製造職能為主，工程師與技術員佔整體超過七成，充分反映晶圓級封裝服務產業對專業能力的高度要求。在性別組成方面，男性 754 人 (48.96%)、女性 786 人 (51.04%)，呈現相當均衡的性別比例，這也是精材公司長期推動性別友善職場的具體成果。

分類	細 項	男 性 (人)	女 性 (人)	合 計 (人)
 年齡分布	● 18-30 歲	169	145	314 (20.4%)
	● 31-50 歲 (核心)	507	534	1,041 (67.6%)
	● 51 歲以上	78	107	185 (12.0%)
 學歷分布	● 博士	17	2	19 (1.2%)
	● 碩士	201	82	283 (18.4%)
	● 學士 / 專科	463	443	906 (58.8%)
	● 高中職及以下	73	259	332 (21.6%)
 國籍分布	● 本國籍	621	506	1,127 (73.2%)
	● 外國籍 (移工)	133	280	413 (26.8%)
 合約類型	● 不定期契約 (正職)	751	785	1,536 (99.7%)
	● 定期契約 (約聘)	3	1	4 (0.3%)
 身心障礙	達成法定配額	—	—	16 名 (達標)

基準日：2025/12/31

管理職多元化結構

2025 年度，公司管理職（副理級以上）共計 151 人，佔全體員工 9.8%。

層級	定義	男性 (人)	女性 (人)	說明
高階管理層	JG38 以上	7	0	7 人，均為本國籍；性別多元化提升為中期目標
中階主管	JG35-37	57	15	72 人，女性佔 20.8%
基層主管	JG33-34	58	14	72 人，女性佔 19.4%
合計		122	29	151 人，女性管理職比例 19.2%

育嬰友善措施與育嬰假統計

除正職員工外，廠區內另有駐廠承攬人員提供餐飲、清潔及保全等支援服務，非駐廠承攬人員皆為施工類廠商。

2025 年度，非員工工作者（承攬商）年度總工時估計達 153,168 小時（數據來源：各廠區申報職業災害統計彙總表之非屬受僱勞工之其他工作者全年度工時加總）。公司將承攬商納入職業安全衛生管理範疇，並在每季 RBA 查核中涵蓋承攬商勞動人權事項，確保工作場所內所有人員均受到同等程度的安全保障。



1. 總數 (人)、總日數、總工時：計算方式為各廠區申報職業災害統計彙總表中非屬受僱勞工之其他工作者全年度數據加總
2. 平均人數 (月)：總數 (人) / 12 個月 (每日不重複計算)
3. 平均工時 (日)：總工時 / 總日數

8.2 人才招募、流動與育嬰友善

對應聯合國永續發展目標【SDG 8 就業與經濟成長】

精材公司持續打造有吸引力的職場環境，以多元招募管道延攬人才，並以完善的職涯成長路徑留住優秀員工，同時提供合於法規的育嬰友善措施，支持員工兼顧家庭與職場。

2025 年，隨 Line C 新廠區逐步啟動，公司積極招募人才，全年新進 262 人，新進率 17.6%。整體離職率 11.0%，其中自願離職 10.4%（155 人），非自願（資遣及連續曠職）僅 9 人（0.6%），整體勞資關係穩健。公司深入分析離職原因，發現新廠區大量新進人員在試用期及上線階段的適應磨合為主因，並已針對「薪資期望落差」及「工作環境適應」等核心因素，啟動優化措施。

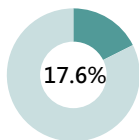


新進

新進員工總數

262 人

新進率



男性 (人/率)

154 人 / 10.3%

女性 (人/率)

108 人 / 7.2%



18-30 歲

159 人 / 10.7%

31-50 歲

101 人 / 6.8%

51 歲以上

2 人 / 0.1%

◆ 新進員工總數：Line C 擴廠帶動需求

◆ 新進率：分母為期間平均員工數 = [(期初人數 + 期末人數) / 2] × 100%



離職

離職員工總數

164 人

男性 (人/率)

91 人 / 6.10%

女性 (人/率)

73 人 / 4.9%



18-30 歲

44 人 / 2.9%

31-50 歲

106 人 / 7.1%

51 歲以上

14 人 / 0.9%

◆ 離職員工總數：不含工讀生及契約工



整體離職率

11.0 %

◆ 整體離職率

自願 10.4% (155 人)

非自願 0.6% (9 人)



男性離職率 (人/率)
91 人 / 6.1%



女性離職率 (人/率)
73 人 / 4.9%



員工平均年資 (2025)

9.1 年

◆ 員工平均年資 (2025)

平均服務年資：2024 年度 9.1 年

育嬰友善措施與育嬰假統計

精材公司全面遵守《性別工作平等法》相關規定，提供育嬰留職停薪、陪產假、家庭照顧假等完整假勤制度，並設置哺乳室。哺乳時間視同工作時間計算，讓有照顧需求的員工能安心在職、無後顧之憂地回歸工作崗位。對於育嬰留停期滿復職的員工，公司優先安排其返回原部門及職位，以最大程度地滿足員工需求，展現對員工生涯連續性的真誠尊重與支持。

公司已就未復職個案進行了解，主因多為個人生涯規劃調整。公司持續推動合於法規之相關政策，包括彈性工時申請、育嬰期間定期關懷聯繫，以提升未來復職意願。

	2024 年		2025 年		- 說明 -
	男	女	男	女	
 符合申請資格人數	52 人	25 人	48 人	22 人	  任職滿 6 個月即可申請  整體復職率約 72.7%
 實際申請育嬰留停	7 人	7 人	8 人	5 人	
 應復職人數 (A)	11 人	6 人	4 人	7 人	
 實際復職人數 (B)	10 人	5 人	3 人	5 人	
 復職率 (B/A)	90.9%	83.3%	75%	71.4%	
 復職後 12 個月留任率	100%	100%	66.7%	80.8%	

應復職人數 (A)：期滿應復職人員

8.3 員工幸福：薪酬、福利與日常關懷

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 8 就業與經濟成長】 【SDG 5 性別平權】

「幸福職場不是配套，而是文化。」精材公司從薪酬公平、健康照顧到日常生活的細微關懷，讓員工感受到這份工作值得全力投入。精材公司相信，當員工在生活中感到被照顧，在工作中感到被看見，他們就會把最好的自己帶進廠房、帶進每一個製程決策。這不是福利政策的理性計算，而是我們作為一個大家庭，對每位成員最真誠的承諾。

公司每年 4 月進行年度調薪，依據「個人績效、職務重要性與市場行情」三大核心要素決定調幅，確保薪資分配公平且具競爭力，讓每一分貢獻都能獲得合理的回饋。

薪酬競爭力與公平性

性別薪酬差距說明：目前管理職薪酬比（男：女）為 1:0.9，主因係高階管理層 7 人均為男性所致，並非同工不同酬。專業人員差距為 1:0.9，技術人員差距為 1:0.98，顯示基層薪酬公平性持續改善。





員工福利一覽

精材公司全職員工的福利享有以下項目：

#	福利項目	補充說明
1	 壽險 (團體壽險)	
2	 年度健康檢查 (優於法規 51 項)	全體適用；金額依職級設定級距
3	 意外險 / 傷殘險 (優於法規補償)	兼職同享意外險保障
4	 育嬰留停 / 陪產假 (任職滿 6 月可申請)	
5	 退休金 (勞退 6% 提撥 + 久任獎金)	
6	 員工旅遊補助 三節禮金 / 生育補助	
7	 FUN 鬆小站 (視障按摩服務)	廠區設置，與視障按摩合作，兼顧舒壓與公益
8	 員工社團 (5 個活動性社團)	愛心志工社、籃球社、羽球社、環保志工社、上山下海社
9	 「百元愛延續」 助養計畫	共同關懷桃園地區育幼院 109 位孩童

走近員工的日常：關懷的細節決定溫度

每年歲末，廠區的愛心義賣現場總是熱鬧非凡一手工皂、環保袋、庇護農場的農產品，一攤接著一攤。員工們在選購心儀物品的同時，也用行動支持了路得啟智學園、睦祥育幼院、喜憨兒社福基金會等十餘個公益團體。這不只是一場義賣，更是精材公司大家庭表達善意、傳遞溫暖的年度時刻。相關公益活動善款超過新台幣 130.2 萬元，讓愛走進社會已是同仁熱心參與公益的日常。

廠區內的「FUN 鬆小站」是另一個讓員工感受到被照顧的溫暖空間。與視障按摩服務機構的合作，讓員工在繁忙的工作之餘可以喘一口氣、舒緩身心，同時也為視障朋友提供了穩定的就業機會。2025 年服務人次再創新高，成為員工最喜愛的廠區設施之一，充分體現精材公司「商業與公益並行」的永續理念。

公司設有多元社團供員工自由加入，從體育競技（羽球社）到自然探索（上山下海社）、從公益志工（愛心志工社）到環境守護（環保志工社），讓每位員工都能在工作之外找到自己的熱情所在，在同伴中找到歸屬感。「百元愛延續」助養計畫則凝聚了全體員工的愛心，共同關懷楊梅、新屋、大園等地育幼院 109 位孩童，用小小的力量，匯聚成一份長期而穩定的關愛。

8.4 人才培育與學習發展

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 4 優質教育】【SDG 8 就業與經濟成長】

精材公司建立以職能為核心的系統性培訓體系，從入職第一天起，每位員工就踏上一條持續學習、持續成長的旅程。2025 年人均訓練時數達 15.99 小時，超越年度目標 45.4%，充分彰顯公司對人才投資的持續承諾。

精材公司視人才為企業永續發展的核心資產。人力資源部門依據各職務與職等需求，建立職能導向的訓練藍圖與追蹤管理機制，不只是「辦訓練」，更是在打造一個讓每個人都能持續成長的學習型組織。

2025 年度，公司共辦理實體教育訓練總人次達 868 人次，線上與實體課程訓練總時數 24,625.6 小時，投入訓練費用 859,669 元，充分展現公司對人才投資的長期承諾。

勞資溝通機制

精材公司建立完整的績效管理制度，每年至少執行一次正式考核，對象為所有通過試用期的正式員工，採員工自我評估與主管評核雙軌機制，確保回饋公平且雙向。考核指標涵蓋年度 KPI 達成與未來發展重點，結果直接連結薪資調整、晉升決策與訓練發展計畫。

訓練指標	2024 年	2025 年	說明
 年度訓練總時數	19,458.1 小時	24,625.6 小時	+26.6% YoY
 員工人均訓練時數	13.47 小時	15.99 小時	超越目標 11 小時 (+45.4%)
 管理職人均時數	16.56 小時 (150 人)	15.20 小時	
 非管理職人均時數	13.11 小時 (1295 人)	16.08 小時	
 男性人均時數	16.54 小時	18.31 小時	工程師職務訓練需求較高
 女性人均時數	10.62 小時	13.77 小時	現場操作訓練型態不同
 年度訓練總費用	—	859,669 元	人均 558 元 / 人
 反貪腐 / 誠信訓練參與率	100%	100%	全員納入管理

系統化培訓架構

精材公司依循「新進引導→專業深化→管理精進→永續素養」四層次架構，設計完整的職涯學習路徑。

層次	訓練類別	2025 年度代表課程與成效	培訓說明
第一層	 新進人員引導訓練	- 公司簡介 - 環安衛介紹 - 品質與環境限用物質管理 - 機密保護 - RBA 責任商業聯盟行為準則新人訓練 完訓率：100%（57 場次）	所有新進員工在試用期內完成。確保每位新人從第一天起建立正確安全意識、品質觀念與人權認知，快速融入組織文化。
第二層	 專業技術訓練	- OJT 在職訓練（部門執行）設備操作 - 化學品安全（SDS） - ISO 管理系統	涵蓋技術員、工程師及設備人員。推動部門執行 OJT 訓練，加速新進人員學習，提升在職人員的技術深度，並鼓勵至外部專業機構接受訓練。
第三層	 管理職能發展訓練	- 非人資主管的識「人」術（2 堂 /56 人次 /6H） - 非人資主管的識「能」術（1 堂 /30 人次 /6H） - 談判謀略講座（1 堂 /31 人次 /3H） - 領班組長管理課程 - 出勤管理與常見勞動法令解析（2 堂 /41 人次 /2H）	透過實際案例演練，協助主管掌握溝通、指導與激勵技能，強化第一線主管對產線管理與異常處理能力。
第四層	 永續素養跨域課程	- RBA 稽核標準宣導（持續辦理） - 資訊安全意識訓練（ISO 27001） - 個人效能提升（簡報技巧、溝通技巧） - 外籍同仁基礎中文會話培育	面向全體員工，特別是部門主管與供應鏈相關職能。以提升永續素養、資安意識為核心。

績效考核制度

精材公司建立完整的績效管理制度，每年至少執行一次正式考核，對象為所有通過試用期的正式員工，採員工自我評估與主管評核雙軌機制，確保回饋公平且雙向。考核指標涵蓋年度 KPI 達成與未來發展重點，結果直接連結薪資調整、晉升決策與訓練發展計畫。

績效指標（GRI 404-3）	2025 年	說明
 接受績效與職涯考核之員工比例	100%	全體正職員工（通過試用期者）
 管理職內部晉升比率	80%	精材公司 99.3% 由內部晉升
 男性接受考核比例	100%	GRI 404-3 要求按性別揭露
 女性接受考核比例	100%	



8.5 勞資關係、人權與申訴機制

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 8 就業與經濟成長】 【SDG 16 制度的正義與和平】

面對半導體產業快速變動的挑戰與高壓的工作節奏，我們深刻體認到，打造一個免於恐懼的職場，是企業不可妥協的底線。有鑑於近年科技業界對於職場霸凌與不當管教議題的高度關注，精材公司在此重申『反歧視與反霸凌』的零容忍政策。我們堅決反對任何基於性別、年齡、國籍、宗教或階級的歧視行為，並嚴格禁止任何形式的職場霸凌或權勢壓迫。

為落實這項承諾，我們致力於打破無形的邊界，確保每一位同仁在招募、培訓、考核與晉升的每一個節點上，都能擁有立足點平等的機會（Equity）。同時，我們持續強化申訴管道的獨立性與保密性，積極營造具備高度心理安全感的共融環境（Inclusion），讓不同的聲音都能被傾聽、被尊重，且不需擔憂遭受報復。精材公司承諾，我們將持續消弭職場中的潛在偏見與不當行為，讓每一位『精材人』都能在健康、安心的環境中發揮潛能，真正實現員工價值與企業發展的共好永續。

勞資溝通機制

精材公司雖未成立工會，但依法設立勞資會議，以制度化方式保障員工集體溝通權利。2025 年全年共辦理 4 次勞資會議（勞資雙方代表各 5 人，全年參與人次 75 人），並舉辦 8 場員工溝通大會（參與人次達 2,215 人），讓每一位員工的聲音都能被聽見、被認真對待。2025 年共接獲員工意見 27 件，按類別分析：管理溝通 15 件（55.6%）、環境溝通 8 件（29.6%）、團膳溝通 3 件（11.1%）、鼓勵同仁 1 件（3.7%），無薪資福利申訴及人權申訴案件，顯示現行薪酬制度與人權保障獲得員工高度認可。

全數意見均依《員工意見反應與申訴辦法》完成處理並回報主管進度。公司嚴格禁止對申訴者、通報者或協助調查者有任何報復行為，若發現違反將視情節輕重進行懲處，確保員工發聲的安全與尊嚴不受侵害。



溝通與人權指標	2025 年	說明
 勞資會議次數（法定）	4 次	每季一次；議題含班時班制、福利活動、工作環境改善
 勞資會議參與人次	75 人次	勞資雙方代表各 5 人組成
 員工溝通大會場次/人次	8 場 / 2,215 人次	每季舉辦，說明公司營運狀況與政策方向
 員工意見件數	27 件	管理溝通 15 件、環境 8 件、團膳 3 件、鼓勵 1 件，全數處理完畢
 重大營運變更預告期	5 週 / 30 天	依勞基法規定，嚴重影響員工權利前提前通知
 溝通機制涵蓋員工比例	100%	全體員工均受勞資會議決議保障；無簽署團體協約
 人權申訴案件	0 件	無重大歧視、童工、強迫勞動等人權風險發生
 性騷擾申訴成立案件	0 件	依《性騷擾防治法》設申訴與懲戒辦法
 違反勞動法規事件	0 件	每季進行人力資源法規查核，涵蓋 RBA 勞動人權查核重點
 移工政策執行 （不扣留證件 / 不收仲介費）	執行中	符合 RBA 移工保護標準；外籍員工 413 人（佔 26.8%）

人權管理框架

精材公司依循聯合國《世界人權宣言》、ILO 工作基本原則及 RBA 行為準則，建立完整的人權管理體系，涵蓋以下核心政策文件：



人權政策聲明

明確宣示公司對人權保障的承諾與原則



員工意見反應與申訴辦法

提供匿名、保密的申訴管道



工作規則

含禁止強迫勞動及童工條款，適用於所有員工及合作夥伴



禁止工作場所性騷擾聲明

依《性騷擾防治法》建立申訴與懲戒辦法



招募聘僱管理辦法

確保招募過程公平、透明，杜絕任何歧視性條款



禁止職務遭受不法侵害聲明

落實職場不法侵害預防，全員教育訓練完成率 100%，申訴個案 0 件

公司每季依最新版 RBA VAP 標準，執行勞工與道德主題風險分析，鑑別範圍涵蓋全體員工、駐廠廠商（餐飲、清潔、保全）、身心障礙人士及孕婦等特殊群體，確保人權保障不留死角。在供應商管理方面，新建供應商審核流程中已納入 RBA 各主題自評問卷，對新供應商先進行各大面向的盡職調查，並提供改善建議與未來稽核方向，將人權保障延伸至整個價值鏈。2025 年度 RBA 責任商業聯盟行為守則訓練（含誠信經營、法律和客戶要求、勞動人權、無不正當利益、公平交易、禁止內線交易等相關宣導），共完成 1,603 人次，合計 1,442.7 人時，新進員工訓練完訓率 100%。

8.6 短中長期目標展望

展望未來，精材公司深知人才是企業最核心的競爭優勢，也是永續發展最重要的基石。我們承諾持續在人才發展、員工幸福、多元共融及勞資關係四大面向精進，不僅要達成量化指標，更要讓每一位員工在精材公司的職涯旅程中，都能感受到被看見、被尊重、被支持的溫暖。以下為具體量化目標：

面 向	關鍵指標	短 期（2026）	中 期（2030）	長 期（2050）
 人才培育	人均訓練時數	≥ 12 小時	◆ 每年知識技能盤點 ◆ 數位化訓練管理 ◆ RBA 課程 ≥ 90%	學習型組織
 勞資關係	人權稽核	每季 RBA 查核 維持 0 重大違規	通過 RBA 第三方外部稽核	供應鏈人權盡職調查全面覆蓋


備註說明

- 1. 本章節數據基準日：2025 年 12 月 31 日。
- 2. 訓練、意見件數等流量數據統計期間：2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。
- 3. 所有員工數據均以期末在職正式員工為基準，工讀生及定期契約工讀生不計入。
- 4. 非擔任主管職務之全時員工薪資資訊依臺灣證券交易所規定申報。並經勤業眾信聯合會計師事務所於 2026 年 4 月查核通過。

從每一個工作崗位的守護，到每一個生命階段的陪伴；從新進員工的第一堂課，到老員工的退休規劃；從公平透明的薪酬制度，到永不妥協的人權保障——這就是精材公司對「以人為本」最真實的詮釋。我們相信，當員工感到幸福，企業就能走得更遠；當組織充滿多元的聲音，創新就能源源不絕。在邁向 2030 年永續目標的道路上，精材公司將繼續與每一位同仁攜手前行，共同書寫屬於我們的永續故事。



CHAP. 09

社會參與與公益共好

- 9.1 社會參與理念與政策
- 9.2 2025 年度社會公益績效總覽
- 9.3 各項公益作為詳述
- 9.4 展望：讓善意持續流動
- 結語：在變局中堅定前行，共創永續新局

精材公司走過二十餘年，我們深信，一家好的企業不能只活在廠房裡 – 它的溫度，應該滲透到所在社區的每一個角落。半導體的製程可以精確到奈米等級，但我們對社會的關懷，從來沒有辦法、也不應該被量化成冰冷的數字。每一袋捐出的血、每一位接受助養的孩童、每一個在義賣攤位前流連的員工身影，都是精材公司大家庭對這片土地最真實的愛與承諾。

透過多元公益行動，助養弱勢兒少、鼓勵向學、守護健康、支持庇護就業，精材公司將企業資源化為社區溫暖，與員工、機構共同編織一張覆蓋更廣的社會安全網。

對應聯合國永續發展目標 |
【SDG 3 良好健康與福祉】
【SDG 4 優質教育】
【SDG 17 永續發展夥伴關係】

9.1 社會參與理念與政策

精材公司的社會參與，不是年度報告裡的例行勾選，而是全體同仁主動選擇的生活方式。公司以「以回饋社會為目標」為核心承諾，積極落實企業社會責任，將溫暖延伸到廠區圍牆之外的每一個需要被看見的角落。

我們相信「企業、員工、社區三贏共好」，當員工因為參與公益而感到有意義，當社區因為有精材公司的存在而變得更好，當公司的成長與周遭弱勢族群的生活一同提升，這才是永續發展最真實的樣貌。

精材公司的社會參與策略，以三個核心方向推動：



扎根在地

深耕大桃園社區，優先支持鄰近社福機構



凝聚員工

號召同仁以行動力參與，讓公益成為日常工作的一部分



投資未來

以獎助學金支持弱勢學生向學，為社會下一代注入希望

9.2 2025 年度社會公益績效總覽

2025 年度，精材公司為社會共好投入總價值約新台幣 1,302,850 元，觸及超過 14 個社會福利機構，惠及逾百位弱勢族群，涵蓋兒少助養、健康守護、教育鼓勵、庇護就業、生命救援等多元面向。
以下為各項公益作為的完整統計：



公益項目	投入金額	受益對象/規模	說明
1 百元愛延續助養計畫	\$798,900	助養孩童 109 名	凝聚全體員工每人每月百元愛心，長期穩定支持睦祥家園、少年之家、育德兒童之家
2 廠內愛心義賣 (4 場)	\$352,950	14 家公益團體設攤義賣	邀請庇護工場、社福機構入廠設攤，讓員工消費即公益
3 精材公司獎助學金	\$127,000	35 位學生 (113 學年度)	成績優異學生，每人約 \$3,629，獎勵向學、肯定努力
4 公益捐贈 (耳溫槍、食品)	\$24,000	16 支耳溫槍；食品 5 項	守護弱勢家庭健康，捐贈米、麵條、泡麵、餅乾、罐頭至家扶中心及睦祥家園
5 捐血活動 (2 場)	-	248 袋 / 62,000 c.c.	每袋 250c.c.，讓我們守護更多生命的延續
6 志工服務 (路得學園)	-	16 人次	陪伴院童蘭陽共學之旅及路得 30 週年公益園遊會
7 發票捐贈	-	765 張發票	設置創世社會福利基金會發票捐贈箱，累積未對獎發票，小動作大公益
2025 年度社會公益投入總價值	\$1,302,850	觸及 14 家社福機構，惠及逾百位弱勢族群	

9.3 各項公益作為詳述

2025 年度，精材公司為社會共好投入總價值約新台幣 1,302,850 元，觸及超過 14 個社會福利機構，惠及逾百位弱勢族群，涵蓋兒少助養、健康守護、教育鼓勵、庇護就業、生命救援等多元面向。以下為各項公益作為的完整統計：

志工服務 - 用時間陪伴，用行動傳遞溫暖

有些善意，無法用金額計算。公司愛心志工社的夥伴們，在假日放下工作，走出廠區，用自己的時間陪伴那些需要被看見的孩子們。

蘭陽共學之旅

路得啟智學園舉辦的「蘭陽共學之旅」，精材公司志工們全程陪伴院童，一起搭車、一起看海、一起笑，那一天的行程或許很快就結束，但對孩子們來說，有人願意特地來陪他們，本身就是最珍貴的禮物。

翻轉生命點亮愛，陪伴路得走三十

路得啟智學園迎來 30 週年的重要時刻，精材公司志工出席「翻轉生命點亮愛」公益園遊會，用實際的行動為這個走過三十年的機構加油打氣。三十年，是一段多麼深厚的陪伴；而精材公司，希望成為其中不缺席的那一份支持。

2025 年度，愛心志工社共投入 **16** 人次

每一個人次背後，都是一位員工主動選擇將休假時光獻給需要陪伴的人。

百元愛延續助養計畫

每個月，廠區的公佈欄上都會張貼一份小小的名單——那是被精材公司大家庭共同守護著的孩子們的笑臉。「百元愛延續助養計畫」從一個簡單的想法出發：如果每位同仁每個月貢獻一百元，那些在育幼院長大的孩子，就能多一份穩定的支持，多一點安心成長的力量。

2025 年度，精材公司全體員工凝聚愛心，
助養桃園在地三個機構的孩童共

109 名

助養總金額達新台幣

798,900 元

這份溫暖流向了：

大園區 財團法人桃園市私立睦祥家園

八德區 財團法人基督教更生團契桃園市私立少年之家

楊梅區 育德兒童之家

這些孩子或許不知道「精材公司」這個名字，但他們感受得到每個月準時到來的溫暖。一百元，在都市裡或許只是一杯飲料的價格，但匯聚成流，卻能讓一個孩子在成長路上走得更穩、更有底氣。這就是精材公司相信的：小行動，大改變。

精材公司獎助學金 - 為努力向學的孩子，打開一扇門

教育，是改變命運最有力的工具。精材公司深知許多在社福機構成長的孩子，面對的不只是生活的艱辛，還有那份「不確定自己是否值得被看見」的怯懦。「精材公司獎助學金」正是為了告訴他們：你的努力，我們看見了。

113 學年度，公司特別表彰三個合作機構中
成績優異的學生，共

35 名

獲得總計

127,000 元 獎助學金

受惠機構包括：大園區財團法人桃園市私立睦祥家園、楊梅區育德兒童之家，以及中壢區桃園家扶中心。這份獎勵不只是金錢，更是一份真誠的鼓勵：「繼續努力，精材公司會陪著你。」

廠內愛心義賣 - 每一筆消費，都是一份善意

廠區走廊每隔一段時間就會飄來一陣香氣，或是烘焙的甜味，或是農產品的清新氣息 - 那是義賣日的味道。2025 年度，精材公司在廠區內舉辦了 4 場愛心義賣，邀請 14 家公益團體設攤。員工們趁著午休，在攤位間流連駐足，拿起手工皂聞一聞、嚐一口庇護工場的餅乾 - 每一筆消費，都讓這些機構的夥伴多了一份收入，也多了一份被社會看見的尊嚴。



4 場義賣累計
義賣所得共計
352,950 元

14 家參與機構涵蓋庇護工場、啟智學園、兒童發展協會、社福基金會等不同類型，讓員工的每一次消費都能同時支持到多元的社會議題。

2025 年義賣參與機構 (14 家)

路得啟智學園 (中壢)

微光庇護工場 (蘆竹)

脊髓損傷潛能發展中心 (楊梅)

自閉症協進會 (桃園)

樂芽潤米庇護工場 (桃園)

心燈啟智教養院 (觀音)

築夢家族社區兒童發展協會 (桃園)

美好社會福利基金會 (龍潭)

綠線發芽希望工坊 (龜山)

創世社會福利基金會 (桃園分院)

沁心小站庇護餐坊 (龍潭)

中華善愛社福協會 (新北)

集賢庇護工場 (新北)

喜憨兒社會福利基金會 (八德)

捐血助人 - 最直接的生命禮物

捐血，是一種不需要什麼理由的善意。2025 年度，公司舉辦了 2 場捐血活動，全體員工共捐出

248 袋血

總捐血量達

62,000 c.c.

每袋 250 c.c. 的血液，經過分離處理後最多可以幫助 3 位患者。這意味著，精材公司員工這次的捐血，有機會守護生命。從捲起袖子的那一刻起，員工不再只是一位半導體製程的工作者——他是某位手術室裡的陌生人希望。

公益捐贈 - 用物資傳遞日常溫度

公益不只是金錢，有時候是一袋白米、一罐罐頭、或是一支小小的耳溫槍。精材公司 2025 年度的物資捐贈，從日常的視角出發，把員工生活中熟悉的物品，化為弱勢家庭餐桌上的溫暖與身體健康的守護。

食品捐贈

- 填滿餐桌，守護溫飽

公司定期購買民生食品，捐贈給大園區睦祥家園及中壢區桃園家扶中心，讓機構的孩子們不必擔心食物匱乏。本年度食品捐贈品項與數量如下：

品項	白米	麵條	泡麵	餅乾	罐頭
數量	236 公斤	45 包	104 碗	161 包	27 罐

耳溫槍捐贈

- 守護健康，從量體溫開始

響應中壢區桃園家扶中心發起的「耳溫一測，守護在側」公益活動，精材公司募集 16 支耳溫槍，總價值 24,000 元，捐贈給弱勢家庭，讓孩子生病時不再只能「摸摸額頭猜溫度」。小小一支耳溫槍，裝的是一份讓家長安心的踏實感。

發票捐贈

- 隨手一動，積善成流

廠區設置創世社會福利基金會發票捐贈箱，員工將日常消費後的未對獎發票投入捐贈，2025 年度共募集 765 張發票。這個小小的動作，積沙成塔，讓每一張平日容易被遺忘的發票，都有機會轉化為公益資源。

這些時刻，是精材公司存在的意義之一。我們相信，一家企業的永續，不能只靠技術領先或財務增長，更需要它在它所扎根的土地上，持續播下善意的種子。

9.4 展望：讓善意持續流動

回望 2025 年的公益足跡，我們看到的不只是一串數字，而是無數個真實發生的溫暖時刻，一個孩子拿到獎助學金時靦腆的笑容、一位院童在蘭陽之旅中第一次看海的驚喜眼神、一位員工在義賣攤位前停下腳步、掏出錢包的那一份平靜而確定的善意。



在變局中堅定前行，共創永續新局

本報告書完整紀錄了精材公司在 2025 年的永續足跡。從走出廠區、投入鄰里社區的公益共好，到廠內的綠色製造、人才培育與穩健治理，這份報告不僅是績效數字的總結，更是全體同仁在每一個工作天裡，共同寫下的行動紀實。

回首 2025 年，面對全球地緣政治洗牌、供應鏈重組與氣候法規收緊的嚴峻考驗，我們並未因為大環境的逆風而放慢永續的腳步。相反地，我們以數度進入公司治理評鑑前 5% 的自律、成長超過 57% 的再生能源採購量，證明了精材科技將 ESG 內化為核心競爭力的決心。我們深知，唯有將對環境的責任與對人的關懷扛在肩上，企業的每一步才能走得踏實。

展望 2026 年，在各項國際永續準則逐步、歐盟 CBAM 啟動與供應鏈減碳要求加速的趨勢下，精材公司將以馬不停蹄的務實態度迎接下一個挑戰。我們將持續推進 SBTi 科學基礎減碳目標的實踐路徑，並確保共好精神能持續在組織內深化。

永續發展是一場沒有終點的旅程，而我們深知自己並不孤單。感謝每一位利害關係人，無論是堅守崗位的同仁、一路相伴的客戶與供應商夥伴、給予信任的投資人，以及始終包容我們的在地社區。因為有您的督促與期許，精材科技才能在變動的時代中站穩腳步。未來，我們將繼續秉持透明、誠信與共好的初心，與您攜手邁向更具韌性的永續明天。





附 錄

- 附表一 GRI 準則對照索引 / GRI 合規聲明
- 附表二 SASB 半導體業資訊揭露清單
- 附表三 產業別加強揭露永續指標
- 附表四 BSI 獨立確信聲明書

附表一 GRI 準則對照索引

■ GRI Content Index – 依 GRI Standards 2021 編製
■ GRI 行業準則應用：無

精材科技 2025 年度永續報告書依循全球永續性報告協會（Global Reporting Initiative, GRI）GRI 準則 2021 年版編製，揭露範圍涵蓋 GRI 2 通用揭露（General Disclosures）、GRI 3 重大主題（Material Topics）及各項重大主題對應之主題準則（Topic Standards）。以下對照索引依序列示各揭露項目、對應報告書章節頁次及揭露狀態，以利利害關係人查閱。

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁數	補充說明	GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁數	補充說明
GRI 2 一般揭露 2021	GRI 2-1 組織詳細資訊	Chap. 1. 1 / Chap. 2. 1	P.11 P.23		GRI 2 一般揭露 2021	GRI-2-12 最高治理單位於監督衝擊管理的角色	Chap. 2. 3 / Chap. 3. 1	P.25 P.40	
	GRI 2-2 組織永續報導中包含的實體	報告書前言：報告範疇與邊界	P.1	涵蓋精材科技股份有限公司所有營運據點		GRI-2-13 衝擊管理的負責人	Chap. 1. 2	P.12	
	GRI 2-3 報導期間、頻率與聯絡人	報告書前言：基本資訊	P.1-2	2025年1月1日至12月31日；年度發行；ESG 窗口聯絡資訊		GRI-2-14 最高治理單位於永續報導的角色	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-4 資訊重編	報告書前言：報告範疇	P.1	若有重編將於相關章節說明，本期無重大重編項目		GRI-2-15 利益衝突	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-5 外部保證 / 確信	報告書前言 附錄：BSI 確信聲明書	P.2 P.123	BSI 英國標準協會執行獨立保證		GRI-2-16 溝通關鍵重大事件	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-6 活動、價值鏈和其他商業關係	Chap. 1. 1 / Chap. 2. 1	P.11 P.23	晶圓級封裝代工		GRI-2-17 最高治理單位的群體智識	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-7 員工	Chap. 8. 1	P.95	正職 / 約聘 / 兼職 / 性別 / 地區分類揭露		GRI-2-18 最高治理單位的績效評估	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-8 非員工的工作者	Chap. 8. 1	P.95	承攬商 / 派遣人力統計揭露		GRI-2-19 薪酬政策	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-9 治理結構及組成	Chap. 2. 3	P.25	董事會6席（含4席獨立董事）		GRI-2-20 薪酬決定流程	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-10 最高治理單位的提名與遴選	Chap. 2. 3	P.25			GRI 2-21 年度總薪酬比率	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI 2-11 最高治理單位的主席	Chap. 2. 3	P.25			GRI 2-22 永續發展策略的聲明	董事長致詞 / Chap. 3. 0	P.5 P.36	

GRI 準則		揭露項目		對應章節	頁數	補充說明	GRI 準則		揭露項目		對應章節	頁數	補充說明
GRI 2 一般揭露 2021	GRI 2-23	政策承諾	Chap. 2. 4	P.29			永續發展與公司治理（自訂重大主題）						
	GRI 2-24	納入政策承諾	Chap. 2. 4	P.29			GRI 3： 重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 3	P.36		
	GRI 2-25	補救負面衝擊的程序	Chap. 2. 4	P.29			創新研發（自訂重大主題）						
	GRI 2-26	尋求建議合提出疑慮的機制	Chap. 2. 4	P.29			GRI 3： 重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 6	P.69		
	GRI 2-27	法規遵循	Chap. 2. 7	P.34			氣候變遷與能源						
	GRI 2-28	公協會的會員資格	Chap. 2. 8	P.34			GRI 3： 重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 7	P.69		
	GRI 2-29	利害關係人議合方針	Chap. 1. 3	P.13			GRI-302：能源 2016	GRI-302-1	組織內部的能源消耗量	Chap. 7. 3	P.82		
	GRI 2-30	團體協約		-	因未成立工會，故無簽署團體協約	GRI-302-3		能源密集度	Chap. 7. 3	P.82	能源密集度 125.5 GJ/ 百萬元營收		
GRI 3： 重大主題揭露 2021	GRI-3-1	決定重大主題的流程	Chap1. 5	P.18			GRI-305：排放 2016	GRI-302-4	減少能源消耗	Chap. 7. 3	P.82	2025節能措施揭露；LED換裝、空壓機汰換等年度節能成效	
	GRI-3-2	重大主題列表	Chap1. 5	P.18		GRI-305-1		直接溫室氣體排放（範疇一）	Chap. 7. 4	P.84			
	GRI-3-3	重大主題管理	Chap1. 5	P.18		GRI-305-2		能源間接溫室氣體排放量（範疇二）	Chap. 7. 4	P.84			
營運績效						GRI-305-4		溫室氣體排放強度	Chap. 7. 4	P.84			
GRI 3： 重大主題 2021	GRI 3-3	決定重大主題的流程	Chap. 3	P.36		GRI-305-5		溫室氣體排放減量	Chap. 7. 4	P.84			
GRI 201： 經濟績效 2016	GRI 201-1	組織所產生及分配的直接經濟價值	Chap. 3. 1	P.40		GRI-305-7		氮氧化物（NOx）、硫氧化物（SOx），及其它顯著的氣體排放	Chap. 7. 4	P.84			

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁數	補充說明
--------	------	------	----	------

職業安全衛生

GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3 重大主題管理	Chap. 4	P.49	
GRI-403：職業安全衛生 2018	GRI-403-1 職業安全衛生管理系統	Chap. 4. 1	P.50	通過 ISO 45001：2018 及 TOSHMS 驗證
	GRI-403-2 危害辨識、風險評估、及事故調查	Chap. 4. 2	P.51	危害辨識；風險矩陣分級；事故調查與通報機制
	GRI-403-3 職業健康服務	Chap. 4. 3	P.52	職業醫學專業人員配置；定期健康檢查；職業病預防方案
	GRI-403-4 有關職業安全衛生之工作者參與諮商與溝通	Chap. 4. 4	P.53	職業安全衛生委員會運作
	GRI-403-5 有關職業安全衛生之工作者訓練	Chap. 4. 5	P.54	訓練類別、人次、時數；危害化學品訓練覆蓋率
	GRI-403-6 工作者健康促進	Chap. 4. 3	P.52	健康促進計畫；健康檢查項目；EAP 員工協助方案
	GRI-403-7 預防和建清與業務關係直接關聯之職業安全衛生的衝擊	Chap. 4. 6	P.56	製程安全、化學品替代方案、防護設備
	GRI-403-8 職業安全衛生管理系統所涵蓋之工作者	Chap. 4. 8	P.57	正職員工 + 承攬商全覆蓋
	GRI-403-9 職業傷害	Chap. 4. 9	P.58	職業傷害 0 件（員工）；承攬商 0 件；TRIR=0.00；通勤事故另行揭露
	GRI-403-10 職業病	Chap. 4. 9	P.58	職業病件數 0 件

風險管理（自訂重大主題）

GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3 重大主題管理	Chap. 3. 4	P.43	
-----------------	----------------	------------	------	--

GRI 準則	揭露項目	對應章節	頁數	補充說明
--------	------	------	----	------

人才發展與留任

GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3 重大主題管理	Chap. 8	P.93	
GRI-404：2016 訓練與教育	GRI 404-1 每名員工每年接受訓練的平均時數	Chap. 8. 3	P.99	
	GRI 404-3 定期接受績效及職業發展檢核的員工百分比	Chap. 8. 4	P.101	
GRI-405：2016 員工多元化與平等機會	GRI 405-1 治理單位與員工的多元化	Chap. 2. 3	P.25	
	GRI-405-2 女性對男性基本薪資加薪酬的比率	Chap. 8. 6	P.105	

勞資關係與人權

GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3 重大主題管理	Chap. 8	P.93	
GRI-401：2016 勞雇關係	GRI-401-1 新進員工和離職員工	Chap. 8. 2	P.97	新進員工人數及比率；離職率
	GRI-401-2 提供給全職員工（不包含臨時或兼職員工）的福利	Chap. 8. 3	P.99	
GRI-401：2016 勞雇關係	GRI-401-3 育嬰假	Chap. 8. 5	P.103	育嬰假申請率、復職率；按性別揭露
GRI-402：2016 勞 / 資關係	GRI-402-1 關於營運變化的最短預告期	Chap. 8. 5	P.103	重大組織變動提前通知程序；符合勞基法最低要求

水資源與廢棄物

GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3 重大主題管理	Chap. 7	P.73	
-----------------	----------------	---------	------	--

GRI 準則		揭露項目		對應章節	頁數	補充說明	GRI 準則		揭露項目		對應章節	頁數	補充說明
GRI-303：2018 水與流放水	GRI 303-3	取水量	Chap. 7. 5	P.87			GRI-418 隱私管理	GRI-418-1	經證實與侵犯顧客隱私權或遺失顧客資料有關的投訴	Chap. 3. 6	P.46	重大資安事件 0 件；個資外洩投訴 0 件；ISO 27001:2022	
	GRI 303-4	排水量	Chap. 7. 5	P.87			永續供應鏈管理						
	GRI 303-5	耗水量	Chap. 7. 5	P.87			GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 5	P.60		
GRI-306：廢棄物 2020	GRI-306-3	廢棄物的產生	Chap. 7. 6	P.88			GRI-308：2016 供應商環境評估	GRI 308-1	採用環境標準篩選新供應商	Chap. 5. 3	P.63	新供應商環境面向審查；QCDSS 評鑑含環境面向	
	GRI-306-4	廢棄物的處置移轉	Chap. 7. 6	P.88		GRI 308-2		供應商環境評估	Chap. 5. 4	P.63	高風險供應商現場稽查；環境不合規項目改善追蹤		
	GRI-306-5	廢棄物的直接處置	Chap. 7. 6	P.88			GRI-414：2016 供應商社會評估	GRI 414-1	使用社會標準篩選之新供應商	Chap. 5. 3	P.63	供應商 ESG 問卷覆蓋率 100%；RBA 行為準則要求	
誠信經營與反貪腐						GRI 414-2		供應鏈中的負面社會衝擊及採取之行動	Chap. 5. 4	P.63	高風險供應商現場稽查；人權 / 勞工標準不合規改善追蹤		
GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 2	P.22			環境永續與資源循環						
GRI-205：2016 反貪腐	GRI-205-1	已進行貪腐風險評估的營運據點	Chap. 2. 4	P.29			GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 7	P.73		
	GRI-205-2	有關反貪腐政策和程序的溝通及訓練	Chap. 2. 4	P.29	員工訓練覆蓋率 100%；供應商誠信宣導		GRI 301：物料 2016	GRI 301-1	所用物料的重量或體積	Chap. 7. 7	P.90		
	GRI-205-3	已確認的貪腐事件及採取的行動	Chap. 2. 4	P.29	確認貪腐事件 0 件；違規申訴 0 件	GRI 301-2		使用回收再利用的物料	Chap. 7. 7	P.90			
GRI-206：2016 反競爭行為	GRI-206-1	反競爭行為、反托拉斯和壟斷行為的法律行動	Chap. 3. 4	P.43									
資訊安全與隱私													
GRI 3：重大主題 2021	GRI 3-3	重大主題管理	Chap. 3	P.36									

附表二 SASB 半導體業資訊揭露清單

精材科技 2025 年度 - SASB 半導體業資訊揭露清單

指標代碼	揭露主題	揭露指標描述	計量單位	資料類型	計算說明 / 注意事項	精材科技 2025 年度實際數值
一、溫室氣體排放 (Greenhouse Gas Emissions)						
TC-SC-110a.1	溫室氣體排放	(1) 範疇一 (Scope 1) 溫室氣體排放總量	公噸 CO ₂ e	【定量】	- 依 ISO 14064-1 及 GHG Protocol - 含製程冷媒逸散、含氟氣體 (F-gases) - 查驗機構：立恩威驗證股份有限公司	2025 年範疇一排放總量為 12,021 公噸 CO ₂ e，包含製程冷媒逸散、含氟氣體 (F-gases)、空污防治設備、汽柴油使用
TC-SC-110a.1 (續)		(2) 受排放限制法規涵蓋之排放量百分比	百分比 (%)	【定量】	- 台灣《溫室氣體減量及管理法》 - 精材目前排放量是否達管制門檻需確認 (依法 2.5 萬噸 CO₂e / 年門檻)	依台灣《氣候變遷因應法》，精材科技屬主管機關 (環境部) 公告應盤查登錄年度溫室氣體排放量之事業單位 (2025 年：129,976 公噸 CO ₂ e)，每年依法完成盤查及申報義務。台灣目前尚未設定特定排放量上限 (Cap)，故列管比例以 100% 計 (受盤查義務法規涵蓋)，惟無數量型排放上限限制。
TC-SC-110a.1 PFCs		(3) 全氟化碳 (PFCs) 排放量 (範疇一中之重要子項)	公噸 CO ₂ e	【定量】	- 精材製程含氟蝕刻 (CxFy 等) - 精材已大幅安裝含氟氣體處理設備	精材使用 C4F8、CF4 與 C5F8 等 PFCs 已大量安裝含氟氣體處理設備，範疇一排放量自 2022 年 55,077 公噸 CO ₂ e 降至 2025 年 12,021 公噸 CO ₂ e，降幅 78.2%。
TC-SC-110a.2	溫室氣體排放	範疇一排放管理策略或計畫討論，含減排目標及績效分析	定性說明	【定量】	- TCFD 四大支柱架構揭露 - 含 ISO 14001、ISO 50001 等 - 說明 SBTi / 科學減碳路徑	【減排策略要點】 - 安裝含氟氣體處理設備，Scope1 降 78.2% (2022 → 2025) 【中期目標 (2030)】 - Scope1+2 較基準年減少 15% 以上 - 再生能源佔比達 7~15% 【查驗機構】 - 立恩威驗證股份有限公司

指標代碼	揭露主題	揭露指標描述	計量單位	資料類型	計算說明 / 注意事項	精材科技 2025 年度實際數值
二、製造之能源管理 (Energy Management in Manufacturing)						
TC-SC-130a.1	製造之能源管理	(1) 製造活動消耗總能源量	百萬焦耳 (GJ)	【定量】	- 含所有外購電力（一般 + 綠電） - 另購買少量柴油供緊急發電機使用，換算發電量已計入外購電力內 1 度電 = 0.0036 GJ 2024 年：693, 821. 37GJ (參考)	908, 501. 49 GJ
TC-SC-130a.1 (續)		(2) 電網電力佔總能源消耗之百分比	百分比 (%)	【定量】	- 分子：外購一般電力（台電） - 分母：總用電量 249, 367, 906 ÷ 252, 361, 525	98. 81% 外購一般電力（台電）：249, 367, 906 度 外購柴油供緊急發電：5, 524 度 外購再生能源（綠電）：2, 988, 095 度 總用電量：252, 361, 525 度
TC-SC-130a.1 (續)		(3) 再生能源佔總能源消耗之百分比	百分比 (%)	【定量】	- 分子：再生能源（T-REC 綠電憑證） - 分母：總用電量 2, 988, 095 ÷ 252, 361, 525 - 中期目標：2030 年達 7~15%	1. 18% 再生能源採購量：2, 988, 095 度（綠電） YoY: +57. 3% （2024: 1, 900, 000 度） 2030 目標：7~15%
三、水管理 (Water Management)						
TC-SC-140a.1	水管理	(1) 總取水量，及位於高度 / 極高度缺水壓力地區之取水百分比	千立方公尺 (千 m³) 及 %	【定量】	- 取水來源：自來水 + 地下水 - 高壓地區：WRI Aqueduct 判定 - 桃園中壢：非高 / 極高壓地區	總取水量：1, 006. 383 千 m³ (1, 006, 383 m³) 來源明細： - 自來水（第三方）：891. 762 千 m³ (88. 61%) - 地下水：114. 621 千 m³ (11. 39%) 高壓地區取水 %：0% (桃園中壢非高壓區)
TC-SC-140a.1 (續)		(2) 總耗水量，及位於高度 / 極高度缺水壓力地區之耗水百分比	千立方公尺 (千 m³) 及 %	【定量】	- 耗水 = 取水 - 排水 - 需汙水廠帳單（排水量） 2025 年排水量資料尚未填入	耗水量 393. 169 千 m³ 耗水量 = 取水量 (1, 006. 383 千 m³) - 廢水排放量 (613. 214 千 m³)

指標代碼	揭露主題	揭露指標描述	計量單位	資料類型	計算說明 / 注意事項	精材科技 2025 年度實際數值
四、產品生命週期管理 (Product Lifecycle Management)						
TC-SC-410a.1	產品生命週期管理	含 IEC 62474 須申報物質之產品收入佔比	百分比 (%)	【定量】	・ 分子：須申報物質之產品收入 ・ 分母：總收入	・ 0% ・ 無任何 IEC62474 須申報物質之產品 ・ 2025 年無違規事件
TC-SC-410a.2		伺服器、桌電、筆電之處理器能源效率	依產品類別 (見說明)	【定量】	N/A (不適用)	N/A (不適用)
五、活動指標 (Activity Metrics)						
TC-SC-000.A	活動指標	總生產數量 (由公司定義計量單位)	晶圓片數 (wafers)	【定量】	・ 晶圓片數 (wafers) 為單位	・ 封裝：約當八吋晶圓 285 千片 ・ 測試：約當十二吋晶圓 1,311 千片
TC-SC-000.B		自有設施之生產數量百分比	百分比 (%)	【定量】	・ 所有生產線均為自有廠房	100%

附表三 產業別加強揭露永續指標

臺灣證券交易所「上市公司編製與申報永續報告書作業辦法」，產業別加強揭露永續指標

永續揭露指標 - 半導體業

指 標	指標種類	年度揭露情形 (2025 年度實際數值)	單 位	備 註
消耗能源總量、外購電力百分比及再生能源使用率	量化	◆ 消耗能源總量：908,501.49 GJ (= 252,361,525 kWh × 0.0036) ◆ 外購電力百分比：100.00% (外購電力 252,361,525 kWh) ◆ 再生能源使用率：1.18% (再生能源 2,988,095 kWh；+57.3% YoY) 註：精材 2025 年全數使用外購電力，另購買少量柴油供緊急發電機使用，換算發電量已計入外購電力內	GJ (十億焦耳) 百分比 (%)	
總取水量及總耗水量	量化	◆ 總取水量：1,006.383 千 m³ · 自來水 (第三方)：891.762 千 m³ (88.61%) · 地下水：114.621 千 m³ (11.39%) ◆ 總排水量：613.214 千 m³ ◆ 廠內回收水產水量：894.506 千 m³ ◆ 總用水量：1,900.889 千 m³ = 總取水量 + 廠內回收水產水量 ◆ 總耗水量：393.169 千 m³ = 總取水量 - 總排水量	千立方公尺 (1,000 m³)	
所產生有害廢棄物之重量及回收百分比	量化	◆ 有害廢棄物產生總量：395.29 公噸 · 焚化處理 (含能源回收)：162.24 公噸 (41.04%) · 化學處理：40.61 公噸 (10.27%) · 物理處理：再利用 / 資源化產品：183.98 公噸 (46.54%)；掩埋 (非直接)：8.46 公噸 (2.14%) ◆ 有害廢棄物回收 / 再利用百分比：46.54% (183.98 ÷ 395.29 × 100%) ◆ 全數委外合規處理，零非法棄置 (一般廢棄物另計：749.78 公噸)	公噸 (t) 百分比 (%)	
與使用關鍵材料相關的風險管理之描述	質化描述	◆ 精材關鍵材料類別：矽晶圓、銅 / 鋁 / 金屬導線材料、光阻、蝕刻化學品、封裝樹脂及特殊製程氣體 (含氟系氣體) ◆ 主要風險管理措施： 1. 單一來源風險：推動雙源 / 多源採購策略，建立合格替代供應商備案，維持安全庫存 2. 供應商評鑑：QCDS 五維度年度評鑑 (67 家)，0 家重大負面環境 / 社會影響 3. 衝突礦物管理：CMRT/EMRT 100% 合規申報 (3TG+Co+ 石墨 + 鎢 + 銅 + 鎳) 4. 有害物質管控：RoHS/REACH，進料 100% 檢驗 5. 地緣政治風險：在地採購比例達八成以上 (2025 年) 6. 供應鏈 ESG 稽核：書面 + 現場稽核並行	不適用 (質化說明)	關鍵材料風險 已納入 TCFD 風險管理框架 在地採購比例：2025 年維持 80%

指 標	指標種類	年度揭露情形 (2025 年度實際數值)	單 位	備 註
說明職業災害類別、 人數及比率	量化	◆ 總工作時數： · 員工：2,939,448 小時 · 承攬商：153,168 小時 ◆ 廠內職務執行傷害（不含通勤） · 死亡人數：0 人 · 嚴重職業傷害人數：0 人 · 可記錄職業傷害人數：0 人 · TRIR（總可記錄傷害率）：0.00 · 職業病人數：0 人 ◆ 上下班通勤事故（另行揭露） · 死亡：1 人（男性，交通事故） · 可記錄傷害：17 人 注：依 GRI 403-9，通勤事故另行揭露，不納入廠內職業傷害 TRIR 計算	人數比率（%）TRIR	TRIR 計算： （傷害件數 × 200,000）÷ 總工時 廠內 TRIR = 0.00 ISO 45001:2018 認證持續有效
產品生命週期管理之揭露： 含報廢產品及電子廢棄物之重量 以及再循環之百分比	量化	◆ 精材為 B2B 晶圓級封裝服務廠（WLCSP/CIS/TSV），非終端消費性電子產品製造商，最終電子廢棄物由下游客戶 / 系統廠依各國法規處理。 ◆ 報廢產品（晶圓、不良品）：依「報廢品管理程序」委外處理 ◆ 有害物質管控：RoHS/REACH 100% 符合 ◆ 2025 年無有害物質違規事件	公噸（t） 百分比（%）	包含下腳料賣出或其他回收 處理，應提供相關說明。 RoHS/REACH 100% 合規
因與反競爭行為條例相關的法律 訴訟而造成的金錢損失總額	量化	◆ 2025 年度反競爭行為相關法律訴訟件數：0 件 ◆ 金錢損失總額：新台幣 0 元 ◆ 反托拉斯 / 壟斷法規相關已結案訴訟：0 件 ◆ 誠信申訴案例：0 件	報導貨幣 （新台幣）	GRI 206-1：反競爭行為訴訟 0 件 GRI 205-3：貪腐事件 0 件
依產品類別之主要產品產量	量化	◆ 精材主要產品類別： · WLCSP 181Kpcs · WLPP1 104Kpcs · Testing 1311Kpcs ◆ 計量單位：晶圓片數（wafers）	依產品類型而不同 （晶圓片 / wafer）	

精材科技股份有限公司
Xintec Inc.

📍 桃園市中壢區吉林路23號9樓

☎ +886-3-4331818

🌐 <https://www.xintec.com.tw/>

✉ ESG@xintec.com.tw

創新科技 · 永續未來

INNOVATION FOR A BETTER SUSTAINABLE FUTURE